

목 차

분 기 보 고 서	1
【대표이사 등의 확인】	2
I. 회사의 개요	3
1. 회사의 개요	3
2. 회사의 연혁	3
3. 자본금 변동사항	3
4. 주식의 총수 등	3
5. 정관에 관한 사항	3
II. 사업의 내용	4
1. 사업의 개요	4
2. 주요 제품 및 서비스	4
3. 원재료 및 생산설비	5
4. 매출 및 수주상황	8
5. 위험관리 및 파생거래	9
6. 주요계약 및 연구개발활동	13
7. 기타 참고사항	16
III. 재무에 관한 사항	28
1. 요약재무정보	28
2. 연결재무제표	30
2-1. 연결 재무상태표	30
2-2. 연결 포괄손익계산서	31
2-3. 연결 자본변동표	32
2-4. 연결 현금흐름표	33
3. 연결재무제표 주식	34
4. 재무제표	84
4-1. 재무상태표	84
4-2. 포괄손익계산서	86
4-3. 자본변동표	86
4-4. 현금흐름표	87
5. 재무제표 주식	88
6. 배당에 관한 사항	135
7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항	136
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적	136
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적	142
8. 기타 재무에 관한 사항	143
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견	153
V. 회계감사인의 감사의견 등	154
1. 외부감사에 관한 사항	154
2. 내부통제에 관한 사항	156
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항	158
1. 이사회에 관한 사항	158
2. 감사제도에 관한 사항	158
3. 주주총회 등에 관한 사항	158
VII. 주주에 관한 사항	159
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항	169

1. 임원 및 직원 등의 현황.....	169
2. 임원의 보수 등	179
IX. 계열회사 등에 관한 사항.....	181
X. 대주주 등과의 거래내용.....	182
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항	185
1. 공시내용 진행 및 변경사항	185
2. 우발부채 등에 관한 사항	185
3. 제재 등과 관련된 사항	186
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항	186
XII. 상세표.....	187
1. 연결대상 종속회사 현황(상세).....	187
2. 계열회사 현황(상세)	187
3. 타법인출자 현황(상세).....	187
【 전문가의 확인 】	187
1. 전문가의 확인.....	187
2. 전문가와의 이해관계	187

분기보고서

(제 76 기)

사업연도 2023년 01월 01일 부터
 2023년 09월 30일 까지

금융위원회

한국거래소 귀중

2023년 11월 14일

제출대상법인 유형 :

주권상장법인

면제사유발생 :

해당사항 없음

회 사 명 :

에스케이하이닉스 주식회사

대 표 이 사 :

박 정 호, 곽 노 정

본 점 소 재 지 :

경기도 이천시 부발읍 경충대로 2091

(전 화) 031-5185-4114

(홈페이지) <https://www.skhynix.com>

작 성 책 임 자 :

(직 책) 재무 담당 (성 명) 김 우 현

(전 화) 031-8093-4801

【 대표이사 등의 확인 】

확 인 서

우리는 당사의 대표이사 및 신고업무담당이사로서 이 공시서류의 기재내용에 대해 상당한 주의를 다하여 직접 확인·검토한 결과, 중요한 기재사항의 기재 또는 표시의 누락이나 허위의 기재 또는 표시가 없고, 이 공시서류에 표시된 내용이 기재 또는 표시사항을 이용하는자의 중대한 오해를 유발하는 내용이 기재 또는 표시되지 아니하였음을 확인합니다.

또한 당사는 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」 제8조의 규정에 따라 내부회계관리제도를 마련하여 운영하고 있음을 확인합니다.

2023. 11. 14

에스케이하이닉스 주식회사

대 표 이 사 곽 노 정 *Kwon*

공시 책임자 김 우 현 *Kim*

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.

2. 회사의 연혁

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.

3. 자본금 변동사항

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.

4. 주식의 총수 등

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.

5. 정관에 관한 사항

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.

II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

당사는 경기도 이천시에 위치한 본사를 거점으로 4개의 생산기지와 4개의 연구개발법인 및 미국, 중국, 싱가포르, 대만, 홍콩 등 판매법인과 사무소를 운영하고 있는 글로벌 반도체 기업입니다.

당사 및 당사의 종속기업의 주력 제품은 DRAM 및 NAND를 중심으로 하는 메모리반도체이며, 일부 Fab(S1, M10 일부)을 활용하여 시스템 반도체인 CIS(CMOS Image Sensor)생산과 파운드리(Foundry)사업도 병행하고 있습니다. 반도체는 메모리 반도체와 시스템 반도체로 구분되고, 메모리 반도체는 정보를 저장하고 기억하는 기능을 하며, 일반적으로 '휘발성(Volatile)'과 '비휘발성(Non-volatile)'으로 분류됩니다. 휘발성 메모리 제품은 전원이 끊어지면 정보가 지워지는 반면, 비휘발성 제품은 전원이 끊겨도 저장된 정보가 계속 남아 있습니다. 당사는 휘발성 메모리인 DRAM과 비휘발성 메모리인 NAND Flash를 주력 생산하고 있습니다.

당사의 생산시설은 국내와 중국에 소재하고 있습니다. 국내에 소재한 Fab은 DRAM을 생산하는 M16, M14, M10(이천)과 NAND를 생산하는 M11, M12, M15(청주) 및 M14(이천)이 있습니다. 이 중 M16은 2021년 2월 준공을 완료한 최신 Fab이며, M14는 DRAM과 NAND를 혼용 생산하고 있습니다. 중국에 소재한 Fab으로는 DRAM을 생산하는 C2, C2F(중국 장쑤성 우시)와 파운드리를 하는 S1이 있습니다. 또한, 인텔의 Non-Volatile Memory Solutions Group의 오프라인 사업부를 제외한 NAND 사업 부문 전체의 인수 1단계 절차를 완료하면서, NAND를 생산하는 중국 다롄에 위치한 Dalian Fab이 있습니다.

당사의 연결 기준 매출액은 2023년 3분기(누계) 21조 4,602억원을 기록하였습니다.

2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황

[제76기 3분기 누계]
만원)

(단위 : 백

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액(비율)
반도체 부문	제품 외	DRAM, NAND Flash, CIS 등	산업용 전자기기	SK하이닉스	21,460,214(100%)
합계					21,460,214(100%)

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

DRAM은 계속되는 DDR5와 HBM에 대한 수요 강세로 서버향 제품 판매가 크게 증가하며 출

하량이 전 분기 대비 약 20% 수준 증가하였으며, ASP는 주요 제품의 가격 상승과 고부가제품의 판매 비중이 확대되며 약 10% 가량 상승하였습니다.

NAND는 고용량 모바일 제품과 SSD 판매 확대로 출하량은 전 분기 대비 한 자릿 수 중반의 성장을 기록하였으며, ASP는 전 분기 대비 소폭 하락하였습니다.

3. 원재료 및 생산설비

당사의 메모리반도체 부문 생산공정에 투입되는 원재료는 크게 웨이퍼(Wafer), Substrate, PCB(Printed Circuit Board) 그리고 기타 재료 등으로 구성됩니다.

웨이퍼는 집적회로(Integrated Circuit, IC)를 제작하기 위해 반도체 물질의 단결정을 성장시킨 기둥 모양의 규소(Ingot)를 얇게 절단하여 원판모양으로 만든 것으로서 반도체 소자를 만드는 데 사용되는 핵심 재료입니다.

Substrate는 Package를 만들기 위한 원재료 중 하나로 전기 신호를 연결하면서 외부의 습기, 충격 등으로부터 칩을 보호하고 지지해주는 골격 역할을 하는 부품입니다.

PCB는 그 위에 저항, 콘덴서, 코일, 트랜지스터, 집적회로, 대규모 집적회로(Large-Scale Integration), 스위치 등의 부품을 고정 및 연결하여 회로기능을 완성시키는 인쇄회로기판입니다.

그 외 가스 및 화학약품, 소자류 등이 반도체 제조 공정에 투입되는 원재료로 소요됩니다.

가. 주요 원재료 등의 현황

[제76기 3분기 누계]

(단위 : 백만원, %)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	투입액	비율	비고
반도체 부문	원재료	Wafer	Fab	641,715	8%	-
		Lead Frame & Substrate	Package	293,693	4%	-
		PCB	Module	197,864	2%	-
		기타	-	4,387,996	54%	-
		소 계		5,521,268	68%	-
	저장품	S/P , 부재료		2,602,837	32%	-
	합 계			8,124,106	100%	-

나. 주요 원재료의 매입처 및 원재료 공급시장과 공급의 안정성

당사는 일본, 한국, 독일, 미국 등에 생산시설을 보유한 5개사로부터 반도체 공정의 주요 원자재인 300mm 웨이퍼 완제품을 공급받고 있습니다. 당사가 거래하고 있는 상기 5개사는 전체 300mm 웨이퍼 시장의 90% 이상 점유율을 차지하고 있습니다.

웨이퍼 가격은 세계 반도체 업계의 수급 동향에 영향을 받습니다. 반도체 산업 경기의 침체가 지속됨에 따라 대부분 Chipmakers의 감산으로 웨이퍼 사용량이 감소하였습니다.

당사는 주요 공급업체와 중장기적 협력관계를 통해 원가 경쟁력 강화를 지속해 나갈 것이며, 급격한 수요 상승으로 인한 웨이퍼 수급 악화에 대비하여 시장 상황을 면밀히 모니터링할 것입니다.

Substrate의 경우 당사는 한국, 일본, 중국 및 말레이시아에 생산시설을 보유한 8개사로부터 Substrate 완제품을 공급받고 있습니다. 전세계 기준 50여개 이상의 Substrate 공급사가 있으며, 당사와 거래하는 8개사는 품질 및 공급 Capacity 측면에서 당사가 요구하는 수준을 만족하는 공급사들입니다.

Substrate 가격은 세계 반도체 업계의 수급 동향에 영향을 받습니다. 특히 Substrate는 다품종 제품으로 당사가 생산하는 반도체의 Type, Density 등에 따라 개별적인 Design이 적용되는 Customized 품목입니다. 전세계적 반도체 경기 침체 여파로 인해 다른 주요 원자재와 마찬가지로 IT 기업들의 투자 축소 및 재고 조정에 따른 원자재 효율화가 진행 중에 있습니다. 시장 변동성을 면밀하게 검토하는 것과 동시에, Substrate 공급사의 지속적인 품질 개선 및 다변화 활동을 통해 Supply Chain 경쟁력 강화 진행 중에 있으며, 건강한 협력 관계를 이어나갈 것입니다.

PCB는 한국 및 중화권(중국, 대만등) 소재 6개사로부터 공급받고 있습니다. 당사와 거래하고 있는 PCB 공급사는 동산업 내 주요 공급업체이며, 품질과 Capacity 등 당사와 산업내 다양한 요구 수준을 만족하고 있습니다.

PCB 가격은 최종 반도체 제품의 수급에 영향을 받을 뿐 아니라 원소재 비중이 높은 제품 특성상 주요 원자재의 거래 가격에 영향을 받습니다. 최근 경기 불확실성에 따라 원소재 가격 변동성이 높고, 최신 신제품의 고신뢰성, 고속도, 고용량에의 요구 추세에 따라 조달 비용에 변동성이 있으나 생산지 다변화와 함께, 제품 설계 최적화, 품질 개선, 재고 조정 등 선제적 활동을 통해 PCB 원가 경쟁력 강화와 품질 안정, 생산 안정성을 동시에 높여나가고 있습니다. 더욱이 올해는 전세계적 반도체 경기 침체 영향으로 반도체 사용처의 투자 축소 및 수요 감소가 진행되었으며, 이로 인한 전반적인 재고 축소로 전년 대비 PCB 비용의 감소가 예상됩니다. 이외에 최근 미-중 무역 분쟁 등 공급 불확실성에 대응하기 위하여 동남아로의 생산 지역 다변화가 진행되고 있습니다.

다. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

1. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

당사는 4조 3교대로 운영되고 있으며, 휴일(공휴일 포함)을 포함하여 2023년 3분기 총 가동일은 273일로, 각 지역별 FAB의 가동인원 및 가동율을 고려하여 계산한 당사의 평균가동시간은 월 21,757,736 시간입니다.

생산능력은 "해당 연간 최대생산 일의 생산량 x 누적일수 x 평균원가"의 방법으로 산출하고 있으며, 2023년 3분기 생산능력은 25,412,880 백만원입니다.

(단위 : 백만원)

사업부문	제76기 3분기	제75기	제74기
반도체	25,412,880	33,326,132	25,626,444

※ 제75기부터 Solidigm 포함

2. 생산실적 및 가동률

당사의 2023년 3분기 생산실적은 25,412,880 백만원으로 집계되었으며, 동 기간의 생산설비의 평균가동률은 100%를 유지하였습니다.

(1) 생산실적

(단위 : 백만원)

사업부문	제76기 3분기	제75기	제74기
반도체	25,412,880	33,326,132	25,626,444

※ 제75기부터 Solidigm 포함

(2) 가동률

(단위 : 시간, %)

사업부문	가동가능시간	실제가동시간	평균가동률
반도체	195,819,624	195,819,624	100%

※ 가동률은 각 지역별 FAB별 가동인원 및 수율을 고려하여 계산함

※ 제76기 반기부터 Solidigm 포함하여 산출

3. 생산설비의 현황

당사의 시설 및 설비의 장부가액은 작성기준일 현재 54,016,964백만원이며, 상세 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	토지	건물	구축물	기계장치	차량운반구	기타의유형자산	건설중인자산	합계
2023.01.01	-	-	-	-	-	-	-	-
취득원가	1,219,204	12,568,297	3,473,214	105,694,014	49,196	2,516,161	6,571,954	132,092,040
감가상각누계액	-	(2,278,869)	(963,741)	(66,584,370)	(14,952)	(1,789,953)	-	(71,631,885)
손상차손누계액	-	(23,226)	(25,010)	(161,875)	-	(14)	-	(210,125)
정보보조금	-	(15,570)	-	(5,928)	(1)	(3)	-	(21,502)
기초순장부가액	1,219,204	10,250,632	2,484,463	38,941,841	34,243	726,191	6,571,954	60,228,528
기중변동액	-	-	-	-	-	-	-	-
취득	48	127,192	168,980	1,075,993	41	43,343	2,782,218	4,197,815
사업결합으로 인한 증가	-	-	-	-	-	-	-	-
감액(손상차손)	-	-	-	-	-	-	-	-
처분 및 폐기	(16,109)	(664,824)	(3,411)	(597,465)	-	(216)	(85)	(1,282,110)

감가상각	-	(395,732)	(141,329)	(8,957,210)	(2,516)	(229,673)	-	(9,726,460)
대체	3,847	774,283	471,329	2,001,094	-	20,406	(3,273,852)	(2,894)
환율변동 등	3,234	119,723	15,712	379,538	14	4,413	79,452	602,085
기말순장부금액	1,210,224	10,211,274	2,995,744	32,843,791	31,782	564,464	6,159,687	54,016,964
2023.09.30	-	-	-	-	-	-	-	-
취득원가	1,210,224	12,784,117	4,116,101	108,264,244	49,101	2,570,340	6,159,687	135,153,814
감가상각누계액	-	(2,533,420)	(1,100,178)	(75,214,065)	(17,318)	(2,005,493)	-	(80,870,475)
손상차손누계액	-	(23,226)	(18,853)	(161,899)	-	(13)	-	(203,992)
정보보조금	-	(16,197)	(1,326)	(44,489)	(1)	(370)	-	(62,383)
순장부금액	1,210,224	10,211,274	2,995,744	32,843,791	31,782	564,464	6,159,687	54,016,964

4. 투자계획(현황)

2023년 3분기, 당사의 투자집행 현황은 다음과 같습니다.

[유형자산 취득 기준]

(단위 : 십억원)

구 분	투자대상자산	투자효과	투자 기간	기투자액(누적)	비 고
보완투자 등	기계장치 외	생산능력증가 등	2023.01.01~2023.09.30	4,198	누적실적
합 계				4,198	-

4. 매출 및 수주상황

가. 매출에 관한 사항

1. 매출실적

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제76기 3분기	제75기	제74기
반도체 부문	제품 외	DRAM, NAND Flash, CIS 등	21,460,214	44,621,568	42,997,792
합 계			21,460,214	44,621,568	42,997,792

※ 한국채택국제회계기준에 따라 연결기준으로 작성되었습니다.

2. 판매경로 및 판매방법 등

(1) 판매 조직

국내에서는 GSM 내 영업 관할 하에 대리점을 운영하고 있습니다. 해외 판매법인인 미국, 중국, 싱가포르, 대만, 홍콩 등의 국가에 소재하고 있으며 산하에 대리점을 두고 있습니다.

(2) 판매 경로

당사의 판매 경로는 크게 직판 거래와 대리점 거래로 나눌 수 있습니다. 직판 거래는 당사에서 일반 기업체 등 실 수요자에게 직접 판매를 하는 것이고, 대리점 거래는 당사가 대리점을 통해서 일반 기업체 등의 실 수요자에게 판매하는 것입니다.

(3) 판매 방법 및 조건

내수 판매는 국내 대리점등의 수주 현황에 의거하여 현금 또는 어음 결제조건으로 납품하고 있으며, 수출은 MASTER L/C 및 LOCAL L/C에 의거하여 신용장 또는 D/A, D/P 거래 등으로 납품하고 있습니다.

(4) 판매 전략

당사 판매 전략은 '비즈니스 포트폴리오 최적화', '수익 구조 개선', '고객 관계 유지', '지역별 포지셔닝' 등 4가지를 근간으로 하고 있습니다.

비즈니스 안정성을 위해서 포트폴리오의 최적화를 추진하고 있으며 매출 확대를 위해 제품 구성을 다양화 하고 있습니다. 수익 구조 개선을 위해서 고부가가치 제품 판매를 확대하고 시장 통찰 능력을 강화하여 미래 시장 발굴을 추진하고 있습니다.

고객 관계 유지를 위해서 고객 가치 제안 활동을 강화하고 특화된 제품을 제공하여 고객 만족 제고를 추진하고 있습니다. 지역별 특성을 고려하여 차별화된 제품 전략으로 지역별 전략 고객 매출 확대를 추진하고 있습니다.

(5) 주요 매출처

DRAM의 경우, 세계 유수의 Mobile 및 Computing 관련 전자 업체에 제품을 공급하고 있습니다. NAND Flash는 IT 컨슈머 제품 전체에 걸쳐 그 수요처가 다양하기 때문에 세계적인 모바일 디바이스 및 IT 제품 제조업체, 그리고 SSD와 같은 대용량 저장장치와 메모리 카드 생산 업체 등을 고객으로 확보하고 있습니다.

나. 수주상황

당사는 주요 고객사들과 월별/분기별 상호 합의에 따른 공급 물량 및 가격을 결정하고 있으며, 장기공급 계약에 따른 수주 현황은 없습니다.

5. 위험관리 및 파생거래

가. 시장위험

(1) 환율변동위험

연결회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 달러화, 유로화, 위안화 및 엔화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채 및 해외사업장에 대한 순투자가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생합니다.

당분기말 현재 연결회사의 화폐성 외화자산 및 외화부채의 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위: 백만원, 외화단위: 외화 백만단위)				
구 분	자 산		부 채	
	현지통화	원화환산	현지통화	원화환산
USD	16,166	21,740,700	22,859	30,740,544
JPY	2,711	24,461	68,613	619,040
CNY	1,869	344,463	341	62,771
EUR	19	26,509	137	194,588

또한, 연결회사는 외화사채 및 차입금의 환위험을 회피하기 위하여 주석 19에서 설명하는 바와 같이 통화스왑계약 및 통화이자율스왑계약을 체결하고 있습니다.

당분기말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율이 10% 변동시, 동 환율변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	10% 상승시	10% 하락시
USD	(678,240)	678,240
JPY	(59,458)	59,458
CNY	28,169	(28,169)
EUR	(16,808)	16,808

(2) 이자율위험

연결회사의 이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 차입금에서 발생하는 이자비용이 변동될 위험으로서, 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금에서 발생하고 있습니다. 변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 연결회사는 이자율위험에 노출되어 있으며 동 이자율위험의 일부는 변동이자부 금융자산 등으로부터의 이자율위험과 상쇄됩니다.

연결회사는 현금흐름 이자율위험을 변동이자수취/고정이자지급 스왑을 이용하여 관리하고 있습니다. 이러한 이자율 스왑은 변동이자부 차입금을 고정이자부 차입금으로 바꾸는 경제적 효과가 있습니다. 일반적으로, 연결회사는 변동이자율로 차입금을 발생시킨 후 고정이자율로 스왑을 하게 됩니다. 스왑계약에 따라 연결회사는 거래상대방과 특정기간(주로 분기)마다, 합의된 원금에 따라 계산된 고정이자와 변동이자의차이를 결제하게 됩니다.

연결회사는 당분기말 현재 이자율 변동에 따라 순이자비용이 변동할 위험에 일부 노출되어 있습니다. 연결회사는 변동금리부 차입금 546,325백만원에 대해 통화이자율스왑 계약, 변동금리부 차입금 100,000백만원에 대해 이자율스왑계약을 체결하고 있습니다. 따라서, 이자율 변동에 따른 해당 차입금에 대한 이자비용 변동으로 인한 당분기 법인세비용차감전순이익은 변동하지 않습니다.

한편, 다른 변동금리부 차입금 및 변동금리부 금융자산에 대하여 당분기말 현재 다른모든 변수가 일정하고 이자율이 100bp 하락 또는 상승시 향후 1년간 연결회사의 변동금리부 차입금 및 금융자산으로부터의 순이자비용으로 인한 법인세비용차감전순이익은 82,374백만원(전 분기: 79,923백만원) 만큼 증가 또는 감소할 것입니다.

(3) 가격위험

연결회사는 유동성관리 및 영업상의 필요 등으로 지분증권 및 채무증권에 투자하고 있습니다. 당분기말 현재 해당 지분증권 및 채무증권은 가격위험에 노출되어 있습니다.

나. 회사의 위험관리 정책

(1) 위험관리의 일반적 전략

[주요 시장위험요소]

당사는 외화표시 자산 및 부채에 대해 환율변동에 의한 리스크를 최소화하여 재무구조의 건전성 및 경영 안정성 제고를 목표로 환 리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. 또한 당사는 영업 측면에서 매출의 90% 이상이 USD로 발생되어 USD 수입이 지출보다 많은 구조를 가지고 있으므로 수입에서 지출을 차감한 잔존 외화 현금흐름을 환리스크 관리의 주 대상으로 하고 있습니다.

[위험관리규정]

당사는 보다 체계적이고 효율적인 환리스크 관리를 위하여 환위험 관리규정 제정 및 환리스크 관리를 위한 별도의 전담 인원을 배정하여 운영하고 있습니다. 그 주요 내용은 ①외환거래는 환 리스크를 회피하고 안정적 경영 수익을 확보하기 위해 실행되어야 하며, ②실수요와 공급에 의한 거래를 원칙으로 하고, ③환위험 관리의 정책은 자연적 헤지(Natural Hedge)를 기본으로 하되 필요시 선물환 등 외부적 관리기법을 일부 시행하고, ④회사의 환위험 관리는 주관부서에서 집중하여 관리하며, 주관부서는 환포지션을 파악하여 필요시 환노출을 최소화 하도록 관리하고 있습니다.

(2) 위험관리조직 및 운영 현황

당사는 외환거래 실행을 주관하는 부서에서 환위험을 관리하고 있으며, 관리부서 주요 업무는 다음과 같습니다.

- ① 외환관리정책 / 전략의 확정
- ② 외환관리규정의 제정 및 개정
- ③ 외환 거래 및 관련 업무
- ④ 외환리스크 측정 및 분석 / 보고
- ⑤ 환 Exposure 및 외환리스크 관리방안 수립 / 시행
- ⑥ 국제금융시장 및 환율 동향 Monitoring
- ⑦ 이사회 또는 감사위원회 지시 사항 이행 및 점검

다. 파생상품 거래 현황

(1) 통화스왑 및 이자율 스왑

① 당분기말 현재 현금흐름위험회피회계를 적용한 통화스왑 및 이자율스왑 거래내역은 다음과 같습니다.

(원화단위: 백만원, 외화단위: 외화 천단위)					
위험회피대상			위험회피수단		
차입일	대상항목	대상위험	계약종류	채결기관	계약기간
2019.09.17	고정금리외화사채 (액면금액 USD 500,000)	환율변동위험	통화스왑계약	국민은행 등 2개은행	2019.09.17 ~ 2024.09.17

2019.10.02	변동금리시설대출 (액면금액 USD 406,250)	환율변동위험 및 이자율위험	통화이자율스왑계약	산업은행	2019.10.02 ~ 2026.10.02
2023.01.17	고정금리외화사채 (액면금액 USD 750,000)	환율변동위험	통화스왑계약	국민은행 등 4개은행	2023.01.17 ~ 2026.01.17
2023.04.04	변동금리시설대출 (액면금액 KRW 100,000)	이자율위험	이자율스왑계약	우리은행	2023.04.04 ~ 2028.04.04

② 연결회사가 보유하고 있는 파생금융자산의 당분기말 공정가치는 연결재무상태표의 기타 금융자산 계정으로 계상되어 있으며, 그 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위: 백만원, 외화단위: 외화 천단위)			
구분	위험회피대상항목	현금흐름위험회피 회계적용	공정가치
통화스왑	고정금리외화사채 (액면금액 USD 1,250,000)	147,275	147,275
통화이자율스왑	변동금리시설대출 (액면금액 USD 406,250)	88,607	88,607
이자율스왑	변동금리시설대출 (액면금액 KRW 100,000)	1,622	1,622
파생금융자산 합계			237,504

당분기말 현재 위험회피수단으로 지정된 파생상품의 공정가치 변동은 모두 위험회피에 효과적이므로 전액 기타포괄손익으로 인식하였습니다.

(2) 내재파생상품

연결회사가 보유하고 있는 파생금융부채의 당분기말 공정가치는 연결재무상태표의 기타금융부채 계정으로 계상되어 있으며, 그 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)			
파생금융부채	당분기말	전기말	공정가치
내재파생상품(*)	637,174	-	637,174

(*) 연결회사가 2023년 4월 11일 발행한 교환사채에 부여된 교환권 및 콜옵션, 풋옵션입니다(연결재무제표 주석 15 참조).

6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 주요 계약

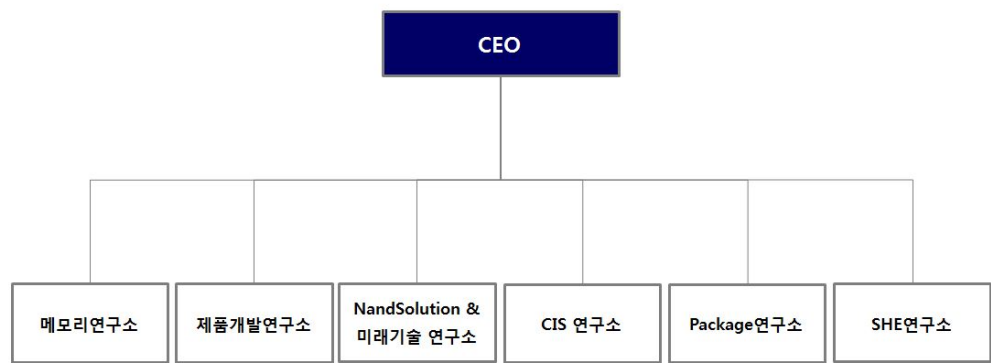
계약 상대방	항목	내용	비고
Rambus Inc.	계약 유형	특허 크로스 라이선스 계약	-
	계약 기간	2013년 7월 1일 ~ 2034년 6월 30일	
	목적 및 내용	라이선스 계약을 통해 반도체 전 제품 기술 관련 램버스 보유 특허에 대한 사용권한을 확보하여 향후 분쟁 가능성 해소	
	기타 주요내용	-	
BCPE Pangea Intermediate Holdings Cayman, LP	계약 유형	특수목적법인(SPC)에 대한 출자 (신규 설립)	-
	계약 기간	2017년 9월 28일 이후	
	목적 및 내용	Bain Capital이 General Partner로서 구성한 특수목적법인(SPC)이 도시바의 반도체 사업 지분을 인수하며, 당사는 이에 대한 Limited Partner로서 투자에 참여	
	기타 주요내용	-	
BCPE Pangea Cayman2 Limited	계약 유형	특수목적법인(SPC)이 발행한 전환사채 취득	-
	계약 기간	2017년 9월 28일 이후	
	목적 및 내용	Bain Capital과의 특수목적법인(SPC)의 전환사채를 취득하고, 향후 적법한 절차를 거쳐 전환 시 최종적으로 도시바 반도체 사업 지분의 15% 확보 가능	
	기타 주요내용	-	
Intel Corporation	계약 유형	영업양수도	-
	계약 체결일	2020년 10월 20일 체결	
	목적 및 내용	Intel의 NAND 사업 영업양수	
	기타 주요내용	계약금액은 US\$90억이며, 2차에 걸쳐 지급될 예정 * 관련 공시 : 2020년 10월 22일 주요사항보고서(영업양수결정)	

※ 최근 5년간의 주요계약 기준

나. 연구개발활동

1. 연구개발 담당조직

당사는 보고서 제출일 현재, 메모리연구소 및 제품개발연구소, Nand Solution & 미래기술 연구소 등에서 연구개발 활동에 주력하고 있습니다.



2. 연구개발비용

(단위:백만원)

과 목		제76기 3분기	제75기	제74기	비 고
연구개발비용	원 재 료 비	75,227	123,839	117,411	-
	인 건 비	648,141	1,332,187	1,330,569	-
	감 가 상 각 비	453,101	572,380	546,128	-
	위 탁 용 역 비	225,063	341,454	266,452	-
	기 타	1,734,049	2,535,473	1,784,235	-
	연구개발비용 합계	3,135,581	4,905,334	4,044,796	-
회계처리	연구개발비(비용)	2,849,539	4,576,383	3,681,932	-
	개발비(무형자산)	286,042	328,951	362,863	-
연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100]		14.6%	11.0%	9.4%	-
매 출 액		21,460,214	44,621,568	42,997,792	-

※ 한국채택국제회계기준에 따라 연결기준으로 작성되었습니다.

다. 연구개발 실적

2023년 중 당사의 주요 연구개발 실적은 다음과 같습니다.

연구과제 등	연구결과 및 기대효과 등
--------	---------------

모바일용 DRAM	<p>[LDPPR5T]</p> <ul style="list-style-type: none"> ·현존 최고속 모바일용 DRAM인 'LPDDR5T*(LPDDR5 Turbo)' 개발 - 작년 양산에 성공한 LPDDR5X의 성능을 업그레이드한 제품으로, 동작속도를 LPDDR5X 대비 13% 빨라진 초당 9.6Gb까지 향상 - 국제반도체표준화기구(JEDEC)가 정한 최저 전압 기준인 1.01~1.12V(볼트)에서 작동하여 속도는 물론, 초저전력 특성도 동시에 구현 <p>[LPDDR5X 24GB 패키지]</p> <ul style="list-style-type: none"> ·LDDR5X에 이어 모바일 DRAM으로는 현존 최초로 24GB까지 용량을 높인 패키지를 양산하여 글로벌 스마트폰 제조사에 공급 - HKMG** 공정을 도입하여 업계 최고 수준의 전력 효율과 성능을 동시에 구현 - JEDEC 최저 전압 기준에서 작동하며, 데이터 처리 속도는 초당 68GB <p>(*) LPDDR(Low Power Double Data Rate): 스마트폰과 태블릿 등 모바일용 제품에 들어가는 DRAM 규격으로, 전력 소모량의 최소화를 목적으로 하고 있어 저전압 동작 특성을 갖고 있음.</p> <p>규격명에 LP(Low Power)가 붙으며, 최신 규격은 LPDDR 7세대(5X)로 1-2-3-4-4X-5-5X 순으로 개발됨</p> <p>(**) HKMG(High-K Metal Gate): 유전율(K)이 높은 물질을 DRAM 트랜지스터 내부의 절연막에 사용해 누설 전류를 막고 정전용량(Capacitance)을 개선한 차세대 공정. 속도를 빠르게 하면서도 소모 전력을 줄일 수 있음. 당사는 지난해 11월 모바일 DRAM에는 세계 최초로 HKMG 공정을 도입해 LPDDR5X 양산에 성공한 바 있음</p>
HBM DRAM	<p>[12단 적층 HBM3]</p> <ul style="list-style-type: none"> ·세계 최초로 DRAM 단품 칩 12개를 수직 적층해 현존 최고 용량인 24GB(기가바이트)를 구현한 HBM3* 신제품 개발 - 기존 HBM3의 최대 용량은 DRAM 단품 칩 8개를 수직 적층한 16GB였으나, 기존 대비 40% 얇은 DRAM 단품 칩 12개를 수직으로 쌓아 16GB 제품과 같은 높이로 제품을 구현 - 어드밴스드(Advanced) MR-MUF**와 TSV*** 기술을 적용한 제품으로, 공정 효율성과 제품 성능 안정성이 강화됨 <p>[HBM3E]</p> <ul style="list-style-type: none"> ·HBM3의 확장(Extended)버전 - 초당 최대 1.15TB(테라바이트) 이상의 데이터를 처리할 수 있음 - 어드밴스드 MR-MUF 최신 기술을 적용해 제품의 열 방출 성능을 기존 대비 10% 수준 향상 - 하위 호환성****을 갖춰, 고객은 HBM3를 염두에 두고 구성한 시스템에서도 설계나 구조 변경 없이 신제품을 적용 가능 <p>(*) HBM(High Bandwidth Memory): 여러 개의 DRAM을 수직으로 연결해 기존 DRAM보다 데이터 처리 속도를 혁신적으로 끌어올린 고부가가치, 고성능 제품</p> <p>(**) MR-MUF: 반도체 칩을 쌓아 올린 뒤 칩과 칩 사이 회로를 보호하기 위해 액체 형태의 보호재를 공간 사이에 주입하고, 굳히는 공정. 칩을 하나씩 쌓을 때마다 필름형 소재를 깔아주는 방식 대비 공정이 효율적이고, 열 방출에도 효과적인 공정으로 평가 받음</p> <p>(*** TSV(Through Silicon Via): DRAM 칩에 수천 개의 미세한 구멍을 뚫어 상층과 하층 칩의 구멍을 수직으로 관통하는 전극으로 연결하는 어드밴스드 패키징(Advanced Packaging) 기술. 이 기술이 적용된 SK하이닉스의 HBM3는 FHD(Full-HD) 영화 163편을 1초에 전송하는, 최대 819GB/s(초당 819기가바이트)의 속도를 구현</p> <p>(****) 하위 호환성(Backward Compatibility): 과거 버전 제품과 호환되도록 구성된 IT/컴퓨팅 시스템 내에서 신제품이 별도로 수정이나 변경 없이 그대로 쓰일 수 있는 것을 의미</p>
서버용 DRAM	<ul style="list-style-type: none"> ·현존 DRAM 중 가장 미세화된 10나노급 5세대(1b) 기술 개발을 완료하고, 해당 기술이 적용된 서버용 DDR5를 인텔에 제공하여 '인텔 데이터센터 메모리 인증 프로그램' 검증 절차에 돌입 - 제공된 DDR5제품은 동작속도가 6.4Gbps로, 현재 시장에 나와 있는 DDR5 중 최고 속도를 구현 - HKMG 공정을 적용해 1a DDR5 대비 전력 소모를 20% 이상 절감
모바일 및 PC용 cSSD 솔루션 제품	<ul style="list-style-type: none"> ·지난 8월 개발에 성공한 238단 4D 낸드플래시 양산 시작 및 이를 기반으로 스마트폰과 PC용 cSSD(Client SSD) 솔루션 제품을 개발해 스마트폰을 생산하는 해외 고객사와 함께 제품 인증 과정 진행 - 238단 낸드는 이전 세대인 176단보다 생산효율이 34% 높아져 원가 경쟁력이 크게 개선됨 - 데이터 전송 속도는 초당 2.4Gb로 이전세대보다 50% 빨라졌으며, 읽기/쓰기 성능 또한 약 20% 개선되어 해당 제품을 사용하는 스마트폰과 PC 고객에게 향상된 성능을 제공할 예정

모바일 UFS	·차량용 반도체 판매를 위해 제품 공급자가 필수로 구축해야하는 프로세스를 차세대 메모리 솔루션 제품인 Mobile UFS로 한국 반도체 기업 최초 ASPICE* 레벨 2 인증 획득 - 독일 최대 전기·전자 기업인 지멘스(Siemens)의 인증 솔루션을 SK하이닉스의 디지털 전환 기술에 접목하여 연평균 20% 이상 성장세가 예상되는 차량용 반도체 시장에 UFS(Universal Flash Memory), SSD(Solid State Drive) 등 당사 낸드 솔루션 제품 공급을 늘리며 수익성을 높여나갈 것으로 기대 (*) ASPICE(Automotive Software Process Improvement & Capability dTermination): 자동차용 부품 생산업체의 소프트웨어 개발 프로세스 신뢰도와 역량을 평가하기 위해 유럽 완성차 업체가 제정한 자동차 소프트웨어 개발 표준
서버용 eSSD	·당사 첫 Datacenter용 16채널 Gen5 eSSD 제품 개발 - Datacenter용 고성능 제품으로 현존하는 16채널 PCIe 5세대 적용 제품 중 가장 뛰어난 성능을 구현하였으며, 미주고객 대상으로 샘플링 진행 중

7. 기타 참고사항

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

반도체는 모든 IT제품의 필수불가결한 핵심 부품으로서, 컴퓨터를 비롯해 통신장비 및 통신 시스템, 자동차, 디지털 가전제품, 산업기계 그리고 컨트롤 시스템 등 그 적용 분야가 매우 광범위합니다. 시장 조사기관인 가트너(Gartner, 2023년 10월, 금액기준)에 따르면, 지난 2022년도 세계 반도체 시장규모는 US\$5,996억에 이르렀으며, 이 중 메모리 제품은 US\$1,432억의 시장규모로 전체 반도체 시장의 약 24% 수준에 달하였습니다. 메모리 제품 중 DRAM은 전체 메모리 반도체 시장의 약 55%를 차지하는 US\$787억을 기록하였으며, 그 뒤를 이어 낸드플래시가 US\$579억으로 약 40%, 기타 메모리가 US\$66억으로 약 5%의 비중을 차지하였습니다.

아래 표에 나타난 바와 같이 반도체 산업은 우리나라 수출에 있어서 18.9%의 비중을 차지하는 매우 중요한 기간 산업 중 하나입니다. 2022년 반도체 수출은 COVID-19 사태 장기화, 중국 시장 봉쇄, 금리 인상 등의 영향으로 수요 및 ASP가 크게 하락하여, 1.0%로 작년 상승률 대비 큰 성장을 이루지 못했습니다.

※ 전체 수출 중 반도체 비중

(단위: 백만 USD, %)

구분	2022	2021	2020	2019	2018	2017
총수출	683,585	644,400	512,498	542,233	604,860	573,694
반도체	129,229	127,980	99,177	93,930	126,706	97,937
전년비 증감률	1.0%	29.0%	5.6%	-25.9%	29.4%	57.4%
비중	18.9%	19.9%	19.4%	17.3%	20.9%	17.1%

* 출처 : 한국무역협회, 2023년 10월

이러한 반도체는 메모리 반도체와 시스템 반도체로 구분됩니다.

(가) 메모리 반도체

정보를 저장하고 기억하는 기능을 하는 메모리 반도체는 일반적으로 '휘발성(Volatile)' 과

'비휘발성(Non-volatile)'으로 분류됩니다. 휘발성 메모리 제품은 전원이 끊어지면 정보가 지워지는 반면, 비휘발성 제품은 휴대전화에 전화번호가 저장되는 것처럼 전원이 끊겨도 저장된 정보가 계속 남아 있습니다. 당사는 휘발성 메모리인 DRAM과 비휘발성 메모리인 플래시메모리를 생산하고 있습니다.

메모리 반도체 산업은 제품 설계 기술, 공정 미세화 및 투자효율성 제고에 의한 원가 경쟁력 확보가 매우 중요한 산업으로서 기술력 및 원가경쟁력을 갖춘 소수의 IDM(Integrated Device Manufacturer)업체 중심으로 점차 과점화되고 있는 추세입니다.

[DRAM(Dynamic Random Access Memory)]

DRAM은 전원이 켜져 있는 동안에만 정보가 저장되는 휘발성(Volatile) 메모리로 주로 컴퓨터의 메인 메모리(Main Memory), 동영상 및 3D 게임 구현을 위한 그래픽 메모리(Graphics Memory)로 사용되고 있으며, 가전제품의 디지털화에 따라 스마트 TV, 스마트 냉장고 그리고 프린터 등에도 사용이 확대되고 있습니다. 또한, 각종 이동통신 기기의 폭발적 성장에 따라 스마트폰 및 태블릿 PC 등에도 모바일용 DRAM의 채용량이 급증하고 있으며, 4차 산업 혁명으로 급격하게 Data 수요가 증가하고 글로벌 데이터센터 투자가 가속화 됨에 따라 Server용 DRAM의 수요도 급증하고 있습니다.

[플래시메모리(Flash Memory)]

플래시메모리는 전원이 공급되지 않아도 저장된 데이터가 지워지지 않는 비휘발성 메모리로 크게 노어(NOR)형(Code저장형)과 낸드(NAND)형(Data저장형)으로 나눌 수 있습니다. 이 중 당사가 생산하는 낸드플래시는 순차적(Sequential) 정보 접근이 가능한 비휘발성 메모리 칩으로서, 디지털 비디오나 디지털 사진과 같은 대용량 정보를 저장하는데 매우 적합합니다. 낸드플래시 제품이 적용되는 분야는 디지털 카메라, USB드라이브, 차량용 내비게이션, SSD(Solid State Drive), Flash Array 그리고 스마트폰, 태블릿 PC와 같은 모바일 기기 등입니다. 한편, 최근 플래시 메모리는 일반적인 범용 메모리 보다는 고객지향적인 제품의 수요가 늘어나고 있어 이런 추세에 부합하는 적극적인 응용 제품개발 및 철저한 고객 대응의 중요성이 커지고 있습니다.

(나) 시스템 반도체

시스템 반도체는 정보 처리를 목적으로 제작되는 반도체로 특성에 따라, 아날로그, 로직, 마이크로, 디스크리트, 센서로 분류가 되며, 당사는 이중 CMOS 이미지 센서를 생산하고 있습니다.

[CIS(CMOS Image Sensor)]

계산과 추론 등 정보처리기능을 담당하는 시스템 반도체 중에서도, 이미지 센서는 빛 에너지를 감지하여 그 세기의 정도를 영상 데이터로 변환해 주는 반도체 소자로서 디지털 촬영 기기에서 필름 역할을 하고 있습니다. 이미지센서는 제조 과정과 신호를 읽는 방법에 따라 CCD(Charge Coupled Device)와 CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor) 두 가지 타입으로 나뉘며 최근에는 디지털 촬영 기기가 소형화됨에 따라 당사가 사업 영위 중인 크기가 작고 전력 소모가 적은 CMOS 이미지 센서(CIS)가 시장의 99.9%를 차지하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

반도체 산업을 둘러싼 환경은 디지털 기기가 모바일화, 스마트화되고 자동차, 의료기기, 산업

기기 등이 인터넷을 기반으로 발전함에 따라 우호적인 시장 여건이 지속되었으며, Big Data, AI, 5G 산업의 확장은 반도체 산업의 성장에 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상됩니다.

2017년, 2018년 간 전체 반도체 시장은 데이터센터 주도의 높은 성장을 달성하였습니다. 한편, 2019년 메모리 반도체 시장은 글로벌 경기 침체, 스마트폰 판매량 감소, CPU 부족으로 인한 PC수요 감소, 공급 과잉 등의 영향으로 Downturn에 돌입한 이후 한동안 재고증가, 가격 하락 등 악재 영향으로 전체 반도체 시장의 성장률은 약 -11%, 메모리 반도체는 약 -33%로 하락세를 보였습니다. 2020년은 COVID-19 사태에 따른 글로벌 팬데믹과 미-중 무역 갈등의 격화로 인해 글로벌 금융위기 이후 처음으로 세계 경제 성장률이 마이너스로 전환되며 메모리 시장 환경도 당초 기대 대비 부진했습니다. 고객의 보수적인 재고 운영이 지속되며 예상 대비 수요 증가율이 둔화되었으며 가격도 약세 전환되었으나, 공급업체들이 보수적인 투자 및 생산 기조를 유지함에 따라 연말로 갈수록 업계 재고가 정상화되고 수급도 안정을 찾아가기 시작했습니다. 2020년 반도체 시장은 +10.4%, 메모리 시장은 +13.5%의 상승을 기록했습니다. 2021년 반도체 시장은 오미크론 확산으로 인한 글로벌 공급망 불안과 확산세가 여전히 꺾이지 않은 팬데믹 상황 등 불확실한 시장 환경이 지속되었습니다. 이에 따른 2020년의 연장선상에서 Server, PC, 모바일 수요가 크게 증가하여, 반도체 시장은 +25.0%, 메모리 시장은 +33.2%의 성장을 보였습니다. 2022년 상반기에는 COVID-19 사태가 안정화 되고 일상이 회복 되면서 수요, 공급도 안정화 단계로 접어드는 것처럼 보였으나, 지정학적 위기와 글로벌 공급망 이슈, 글로벌 금리 인상에 따른 경기 침체에 대한 우려로 하반기부터 상황이 악화됨에 따라 반도체 시장은 +1.1% 성장에 그쳤고, 메모리 시장은 -13.7%로 규모가 감소한 모습을 보였습니다. 2023년은 메모리 업황의 Downturn이 지속되는 가운데, 고객사들의 재고 정상화와 구매 재개 시점에 따라 시기에 따라 업황 반등 시기가 결정될 것으로 전망됩니다. (Gartner, 2023년 10월, 금액기준)

[DRAM]

시장 조사기관인 가트너(Gartner, 2023년 10월, 금액기준)에 따르면, DRAM 시장 규모는 2019년 글로벌 경기 침체, CPU 공급 부족으로 인한 수요감소와 가격하락, 중국과 미국 스마트폰 판매량 감소로 인한 모바일용 일시적 공급 과잉 등의 영향으로 \$622억(-37.7%)을 기록하며 큰 폭으로 하락하였습니다. 2020년에는 COVID-19의 확산에 따른 시장의 혼란과 붕괴, 국가별 봉쇄 조치 등의 영향으로 많은 산업들이 타격을 입었고 반도체 산업 또한 영향을 받았습니다. 중국 내수 부진, 글로벌 시장 불확실성 증대에 따른 신제품 출시 시기 조정 등으로 Mobile 수요가 약화 되었으나, 비대면 경제 활성화, Cloud Service 이용 증가로 PC 및 Server 수요가 Mobile 부진을 상쇄하여 \$659억(+5.9%)을 기록했습니다. 2021년은 COVID-19 회복 및 5G 전환 확대와 고사양 스마트폰 출시, 데이터센터 업체의 투자 재개로 인해 모바일과 Server 수요가 크게 증가하였으며, COVID-19 이후 WFH(Working From Home), 재택교육 등과 같은 근무 환경 및 교육 문화의 변화로 PC 수요도 증가하여 \$929억(+40.9%)을 기록했습니다. 2022년은 중국 Lock-down으로 인한 모바일 수요 감소, Server 업체들의 재고 정리로 인한 Server 수요 약세, PC 시장 포화 등 수요 감소로 인해 \$787억(-15.4%)을 기록하며 역성장을 기록했습니다. 2023년은 공급사의 감산 기조가 지속됨과 더불어 AI 발전에 따른 HBM 등 신규 수요가 성장하고 있어 점진적으로 상황이 회복될 것으로 전망됩니다.

[낸드플래시(NAND Flash)]

낸드플래시는 디지털 미디어의 성장과 더불어 스마트폰, 태블릿 PC, 디지털 카메라, MP3 플레이어 그리고 기타 멀티미디어 가전에 사용되는 플래시카드와 USB드라이브, SSD와 같은 정보저장장치(Storage Devices)등에 널리 사용되고 있습니다.

가트너(Gartner, 2023년 10월, 금액기준)의 전망에 따르면, 낸드플래시 시장은 모바일 및 SSD 등 스토리지 분야 적용 확대를 통해 꾸준한 성장을 이어가고 있었으나, 2019년에는 DRAM과 마찬가지로 글로벌 경기 침체, 과잉 공급과 스마트폰 판매 부진으로 NAND 가격이 큰 폭으로 하락하며 -26.4%(\$426억)의 성장률을 보였습니다. 2020년은 Mobile의 수요는 감소했으나, Corporate PC 수요, Cloud 도입 확산에 힘입은 SSD 수요의 강세가 이를 상쇄하여 25.2%(\$534억)의 성장을 기록했습니다. 2021년에는 고용량 스마트폰의 출시로 데이터 저장소 역할을 하는 NAND 콘텐츠 수요가 증가했으며, PC와 게임 콘솔 수요의 증가, 데이터센터 고객들의 투자 확대로 eSSD 수요도 크게 증가 하여 +24.0%(\$661억)의 성장을 기록했습니다. 2022년은 매크로 악화 및 IT 제품 수요 감소로 전 응용 제품의 수요가 약세를 보이며 -12.4%(\$579억)로 역성장했습니다. 2023년 NAND 시장은 AI 시장 성장에 따른 수요가 다소 제한적으로, DRAM 대비 시황회복이 더딜 것으로 예상됩니다.

[CIS (CMOS Image Sensor)]

이미지센서는 1990년대 중반 디지털 카메라에 장착되어 일반 소비자에게 선보인 이후 PC 카메라, 자동차 블랙박스, 휴대폰카메라, 감시카메라뿐 아니라 스마트TV, AR, VR, 자율주행 자동차 등 4차 산업혁명 기술의 핵심 부품으로도 활용되어 시장 규모도 크게 증가하는 추세입니다. 특히 스마트폰, 태블릿 PC의 카메라 시장의 수요 증가로 시장이 지속 성장할 것으로 보입니다. 가트너(Gartner, 2023년 10월, 금액기준)의 전망에 따르면 이미지센서 시장은 2022년 US\$186억에서 2026년 US\$265억 규모로 연평균 9.2%의 성장이 예상되며, 특히 당사가 생산 중인 CMOS 이미지센서 시장은 다양한 응용기기로의 확대 적용과 수요 증가로 전체 이미지센서 시장에서의 비중이 2022년 97.8%에서 2026년 98.8%까지 확대되며 연평균 9.5% 성장할 것으로 전망했습니다.

(3) 경기변동의 특성

세계 반도체 시장은 제품 수명 주기가 짧으며, 새로운 제품의 생산을 위해서는 대규모 투자가 필요한 장치 산업의 특성을 가지고 있습니다. 아울러, 과거에는 실리콘 사이클의 순환에 따라 호황과 불황을 반복해 왔으며, 이는 주요 수요처인 미구주의 거시경제 순환 사이클(Business Cycle)과의 연관성이 매우 컸습니다. 최근에는 중국 및 인도 등 신흥시장의 비중이 확대되고 경쟁력이 부족한 업체들이 일부 구조조정 되어 반도체 산업 경기 변동 폭은 전과 비교하여 많이 줄었으나, 동시에 시장이 확대되고 고객층이 넓어짐에 따라 팬데믹, 지정학적 요인 등 시황 변화에 따른 수요 변동이 커지고 있습니다.

[DRAM]

DRAM은 PC 수요에 상당 부분 의존하여 기업의 PC교체 사이클의 영향을 크게 받아왔습니다. 이후 스마트폰 및 태블릿 PC 등 모바일 기기의 폭발적 성장과 AI, 5G 시장의 등장에 따라 DRAM의 주요 수요처가 PC에서 Server와 모바일로 분산되고, 경기 변동성이 과거에 비해 약화되는 모습을 보이고 있습니다.

한편, 수요의 계절성으로서는 미구주 지역의 신학기, 크리스마스 특수 등 하반기 수요 증가가 뚜렷했으나, 최근에는 아시아 시장의 성장과 스마트폰 신제품 출시 시기의 분산으로 인한 판매시장의 다변화로 이 같은 전통적인 수요의 계절성이 일부 약화되는 모습도 나타나고 있습니다. PC는 COVID-19 팬데믹 이후 재택근무, 화상회의 등의 문화가 정착되면서 일시적 수요 급증이 나타나기도 했습니다. Server는 지속적인 투자와 성장으로 GDP나 국제시황에 따른 소폭의 변동에도 불구하고 꾸준한 수요를 나타내고 있습니다. 또한 AI, GPT 등에 사용되는 HBM(High Bandwidth Memory)이라는 새로운 수요가 생기면서 시장 확대에 기여할 것으로 기대됩니다.

[낸드플래시(NAND Flash)]

낸드플래시는 과거 MP3플레이어, 메모리카드 등의 수요증가에 힘입어 급속한 성장을 해왔습니다. 또한 최근에는 IT 기기가 스마트화되고 고성능화 됨에 따라 낸드플래시의 주 소비형태가 Controller와 Raw NAND가 결합되는 eMMC와 UFS, SSD 등으로 바뀌었으며 보다 높은 부가가치를 가지게 되었습니다. 아울러, 이들 eMMC와 SSD 제품도 DRAM과 같이 스마트폰, 태블릿 PC, 노트북, PC, Server, Storage, Flash Array 등의 다양한 제품에 장착되기 시작하며, 과거에 비해 경기 변동성은 줄어들 것으로 예상됩니다. 2017년까지 모바일이 가장 높은 점유율을 차지하고 있었으나 모바일 대비 대용량을 요구하는 클라우드 서버의 등장으로 eSSD(enterprise-Solid-State-Drive)가 점유율을 역전하고 NAND 시장의 성장을 견인하는 추세입니다. 다만 HDD라는 대체제와 다수의 경쟁사가 존재하고, 신규 시장의 부재로 가격탄력성이 떨어져 단기적인 시장 성장률은 둔화될 것으로 예상되나, 이후 시장의 Paradigm 변화를 가져올 수요처의 성장에 따라 시장이 확대될 것으로 예상됩니다.

[CIS (CMOS Image Sensor)]

CIS 시장은 스마트폰과 노트북, 태블릿 분야가 출하량과 매출 모두 70% 이상 높은 비중을 차지하고 있으며 이들 소비재의 특성상 경기변동과 기술변화에 민감할 뿐만 아니라 라이프 사이클이 짧은 특징을 가지고 있습니다.

(4) 경쟁요소

반도체 사업의 핵심 경쟁력은 1.기술 및 원가 경쟁력, 2.시장 대응 능력(고객 확보, 제품 포트폴리오), 3.설비투자 능력 등이 있습니다.

최근 대량생산이 용이한 표준제품 위주에서 응용분야가 점차 다양화, 융복합화 됨에 따라 시설투자와 생산성 향상을 통한 원가경쟁력 중심에서 제품 가치 증대를 통한 수익성 중심으로 경쟁의 패러다임이 빠르게 전환되고 있습니다.

지금까지는 적극적 투자에 의한 생산능력 확대와 생산원가 절감이 핵심 경쟁 요소였지만, 공정 미세화의 난이도 증가와 투자 대비 수익에 대한 불확실성 증대 등 사업환경이 변화하였습니다. 따라서, 앞으로는 생산기술의 고도화를 통한 투자 절감과 제품의 부가가치 증대를 위해 다양한 선행기술 및 응용기술 개발, 메모리 컨트롤러와 펌웨어가 결합된 응용복합제품의 개발이 중요한 사업 경쟁력이 될 것입니다. 아울러 DRAM 분야에서의 TSV(Through Silicon Via) 및 New Memory의 원활한 초기시장 진입과 eMMC나 SSD 제품의 시장확대를 위해서는 관련 기술업체와의 협업과 더불어 고객 만족도가 중요해짐에 따라 마케팅 및 고객 지원 활동도 핵심 경쟁 요소로 부각되고 있습니다.

이외에도 적기에 시장요구에 부합하는 제품을 출시(Time to Market)할 수 있는 시장 대응력 및 재무 건전성 확보 등이 요구되고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

IT 수요의 전반적으로 완만한 회복세가 지속되면서, 지난 분기에 이어 AI 서버향 고용량 DDR5와 HBM의 수요 강세가 이어졌으며, 신제품 출시와 함께 스마트폰 플래그십 모델의 고성능화 추세로 고성능/고용량 모바일 메모리 수요가 두드러졌습니다.

당사는 기술 및 제품 리더십을 바탕으로 DDR5와 고성능/고용량 모바일 제품, 그리고 HBM 등 프리미엄 제품의 판매 확대를 통해 전 분기 대비 24% 증가한 9.07조원의 3분기 매출을 기록하였습니다.

매출이 전 분기 대비 증가하고 DRAM 가격 상승에 따라 기 인식한 재고평가손실 충당금의 일부가 환입되면서 당사의 3분기 영업적자는 전 분기 대비 약 1조원 수준 개선된 1.79조원, 영업손실률은 20%를 기록하였습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제76기 3분기 (2023년 3분기)	제76기 2분기 (2023년 2분기)	전분기 대비 증감율	제75기 3분기 (2022년 3분기)	전년 동기 대비 증감율
매출액	9,066,171	7,305,933	+24.1%	10,982,883	-17.5%
누계실적	21,460,214	12,394,044	-	36,949,537	-
영업이익	-1,791,961	-2,882,084	+37.8%	1,660,523	적자전환
누계실적	-8,076,347	-6,284,386	-	8,721,646	-
당기순이익	-2,184,699	-2,987,907	+34.8%	1,107,617	적자전환
누계실적	-7,758,097	-5,573,398	-	5,976,256	-

※ 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 연결기준 실적입니다.
 ※ 상기 직전사업연도 재무 수치의 경우, 인텔 NAND 사업부문 취득일에 인식했던 사업결합 회계처리 잠정 금액을 최종 회계처리를 반영하여 소급 조정한 수치입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

[제76기 3분기 누계] (단위: 백만원)

구 분	매출액	매출액 비중 (%)	주 요 제 품
반도체 부문	21,460,214	100.0%	DRAM, NAND Flash, CIS 등
합계	21,460,214	100.0%	-

※ 당사는 한국표준산업분류표상의 소분류에 의한 '반도체 및 기타 전자 부품 제조업'에 해당하며, 반도체부문의 매출액이 총매출액의 90%를 초과하므로 반도체부문으로 기재함.

(2) 시장점유율

구 분	2023년 2분기	2023년 1분기	2022년	2021년	2020년	2019년
DRAM	29.1%	26.8%	27.7%	28.3%	28.6%	27.4%
NAND Flash	18.8%	15.6%	19.0%	13.7%	11.7%	11.0%

※ 출처: IDC 2023년 9월, 매출액 기준

(3) 시장 경쟁요소 및 회사의 경쟁력

[DRAM]

PC 메모리는 원격 재택, 사무실을 선택적으로 사용하는 하이브리드 업무 환경이 자리 잡고, Windows 11 출시에 따른 교체 수요 증가가 예상됨에 따라 Commercial PC 중심의 수요 회복이 전망됩니다. 또한, 평균 메모리 탑재량이 높은 울트라북(Ultrabook)과 고사양 게이밍 PC(Gaming PC)가 확고한 제품 지위를 갖고 영역을 넓혀가고 있으며 Intel/AMD CPU 위주의 PC 시장에 성능이 대폭 개선된 ARM CPU를 채용한 PC 시장이 확대되고 있어 지속적인 PC 메모리 수요 증대가 예상됩니다. 최근에는 인공지능 컴퓨터(AI PC) 시대에 발맞추어 신경망처리장치(NPU)를 탑재한 CPU 출시가 발표되기도 하는 등, 향후에는 AI PC로의 세대 교체 및 이에 따른 메모리 수요의 확대가 예상됩니다. 당사는 이러한 시장 변화에 대해 모바일 및 고용량 제품 확대를 통해 적극 대응하고 있습니다.

서버 메모리는 컴퓨팅 서비스 수요 증가에 따라 향후 지속적인 수요 확대가 전망됩니다. 클라우드 컴퓨팅의 도입이 진행되고, 데이터량이 증가함에 따라 보다 크고 고성능인 서버에 대한 요구가 높아지고 있습니다. Hyperscaler 업체 등 인터넷 서비스 사업자들은 빅데이터 분석, IoT 애플리케이션 등 클라우드 관련 서비스 수요 증가에 대응하기 위해 데이터센터 확장에 투자하고 있습니다. 또한, VM(Virtual Machine)의 진전이나 SoC 플랫폼의 업그레이드 흐름도 서버당 메모리 Contents 증가에 기여하고 있습니다. 1대의 서버에서 보다 많은 VM이나 어플리케이션을 지원할 필요성이나, 대용량의 데이터를 처리할 필요성 때문에, 서버 개당 메모리 증설의 요구가 높아지고 있는 것입니다. 나아가 Digital Transformation과 5G 보급에 따라 중장기적으로도 견조한 수요가 예상됩니다. 모바일 Device의 확대와 IoT 기기의 증가로 실시간 및 Low Latency 데이터 처리 요구가 높아져 대용량 메모리를 탑재한 고성능 서버의 수요가 더욱 높아질 것으로 예상됩니다. AI(Artificial Intelligence)와 ML(Machine Learning) 등을 기반으로 한 고차원적인 분석 응용분야(Analytics Application)의 성장도 High-Bandwidth 메모리에 대한 수요를 뒷받침하고 있습니다. 최근 GPT와 같은 대규모 언어 모델(Large Language Models, LLM)에 대한 관심 증가는 서버 메모리 시장의 중요한 성장 요소로 작용할 것으로 예상되며, 이는 다양한 산업 및 Application에서 AI 모델의 Training/Inference 지원을 위해 고용량/성능 메모리 솔루션에 대한 수요 증가에 기인합니다. 최근 GPT의 유저 수 증가와 함께 많은 조직/기업에서 자연어 처리, 코딩, 콘텐츠 생성, 챗봇 개발 등 다양한 Application을 위해 LLM을 도입하고 있습니다. 미래에는 특정 도메인 및 산업에 맞게 LLM을 세부 조정하는 데 대한 관심이 높아질 것으로 보이며, 이에 따라 추가 Training 데이터와 컴퓨팅 자원을 효율적으로 처리할 수 있는 고성능 메모리 시스템에 대한 Needs가 더욱 증가할 것으로 예상됩니다. 더 나아가, LLM이 더욱 복잡하고 정교한 구조로 발전하면서 Text뿐만 아니라 이미지, 오디오 및 비디오를 처리하는 멀티모달 AI로 진화하는 미래에는 더욱 강력한 메모리 솔루션에 대한 Needs가 증가할 것으로 예상됩니다.

한편, 인터넷 시대인 Cloud Era에 이은 Data Era 진입으로 Data가 복잡하고 다양해짐에 따라 효율적인 Data Processing을 위해 xPU 기반의 Heterogeneous Computing Architecture 도입에 대한 시장 Needs가 증가하고 있습니다. 이를 위해 CXL(Compute eXpress Link)이 등장하여 Computing, 가속, 메모리 활용을 극대화할 수 있게 해주고 있으며, 현재 CXL의 Ecosystem이 본격적으로 구축되기 시작하고 있습니다. CXL은 초기에는 2nd Tier 메모리로 사용되기 시작하여 향후에는 Memory Pooling 방식으로 진화할 것으로 예상되며, 이를 통해 비용효율적인 Solution이 보급되면서 시장이 급격하게 팽창하게 될 것

으로 예상됩니다. 따라서 CXL 2.0을 지원하는 CPU(GNR)가 출시되는 2025년경부터 시장이 본격적으로 확대되기 시작할 것으로 전망됩니다.

전반적으로 서버 DRAM시장은 클라우드 컴퓨팅 등 첨단 기술의 수요가 증가함에 따라 앞으로도 지속 견조하게 성장할 것으로 예상되며, 당사는 이러한 시장의 니즈에 부합하는 고대역폭/고용량 서버 모듈(Module) 제품의 선행 개발과 양산 공급을 통해 시장 수요에 적극적으로 대응하고 있습니다.

그래픽스 메모리 시장은 고사양/고화질 게임 증가, 4K/8K 미디어 영상 콘텐츠 확산, 3D 그래픽 기술 발전에 따라 상위 스피드를 지원하는 GDDR6를 채용 중이며 2024년 하반기부터는 이보다 빠른 GDDR7의 채용이 증가할 것으로 예상됩니다. AI / Deep Learning 분야의 Workload 증가로 워크스테이션(Workstation)과 고성능 컴퓨팅(High Performance Computing) 시스템 가속화를 위해 HBM (High Bandwidth Memory) 제품이 탑재된 고사양 Accelerator 수요는 지속 증대될 것으로 전망됩니다. 대표적으로 Generative AI 시장에서 GPT와 같이 연구 단계를 넘어서 산업적 가치를 창출할 수 있는 신기술들이 등장하고 있습니다. 이에 Infrastructure 기업 중 Big-3 Cloud 업체 및 GPU의 시장 영향력이 커질 것으로 전망되며 장기적으로는 차별화된 Generative AI 서비스를 위해 독자적인 추론용 가속기 적용과 시스템 최적화를 추진할 것으로 예상됨에 따라 앞으로 HBM에 대한 수요는 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.

또한 신규 출시된 GPU를 채용하는 그래픽 카드 시장과 신규 콘솔용 게임이 지속적으로 출시되는 게임 콘솔 시장의 견조한 수요가 유지되며, 그래픽스 메모리 시장은 꾸준한 성장세가 지속될 것으로 예상됩니다. 당사는 주요 GPU/PC OEM업체 및 게임 콘솔 업체들과의 전략적 협업과 관계 강화를 통해 PC 그래픽스와 게임 콘솔 시장에 대해 적극적으로 대응하고 있습니다.

컨슈머 메모리는 AI & Connectivity 활용 기반의 Home Appliance 발전/확대 기조를 중심으로 Digital TV/Set-top Box/AI Speaker/VR/Game 등 많은 응용에서의 Tech Level Up 전개 진행이 전망됩니다. 다만, Global 경기 침체 지속 및 이로 인한 소비 심리 위축은 현재 까지도 컨슈머 시장 수요에 영향을 미칠 수 있을 것으로 예상됩니다. 업체는 현재의 상황에 대응하기 위해 고수익 중심의 프리미엄(고화질/대화면) segment 확대, Connectivity를 기반으로 한 AI 기능 추가와 기기 편의성 제고를 통하여 고객의 구매를 꾀하고 있습니다.

Digital TV의 Computing Performance 상향 지원과 In-Home Activity (ex. 게임), NFT 거래 플랫폼 등의 탑재로 확장성을 도모 중이며, 화면 회전, 공간 효율성 제고를 통하여 차별화된 가치 제공으로 편의성을 추구하고 있습니다. OTT/AI Speaker 등은 Home connectivity를 기반으로 Media 시장의 발전/확대를 추구하고 있습니다. Metaverse 활용에 필수 접속 기기인 AR/VR의 Reality 고도화는 채용 메모리 Contents 확대가 요구되며 이는 중장기 메모리 수요의 주요 견인 요인으로 작용하고 있습니다. 아울러 AR/VR, AI Speaker, Home Security 등 성장 분야로 Big Tech 기업들의 참여와 대중화는 컨슈머 시장 규모 확장을 이끌고 있습니다. 또한, 차량 내 계기판의 Integrated Digital Cluster화 및 Infotainment System의 고사양화에 따라 고성능 SoC 적용과 함께 메모리의 중요성이 확대되고 있으며, ADAS 적용 가속화와 자율주행 기술/환경 발전은 중장기 고용량/고품질 메모리 시장을 확대 견인할 것으로 예상됩니다. 당사는 범용 제품(DDR3/4)과 저전압/고속 제품(LPDDR4/5)은 물론, Specialty 제품(Industrial Temp, Automotive Grade & HBM) 등 다양한 Portfolio와 Longevity 정책 제시 등 시장에서의 입지를 공고히 하며 사업을 확대해 나가고 있습니다.

모바일 메모리는 Low-power 및 High bandwidth를 필요로 하는 Mobile device인 스마트폰 등을 중심으로 채용되고 있습니다. 2023년 스마트폰 출하량은 전년에 이어 역성장을 지

속할 것으로 예상되나, 내년에는 잠재적 교체수요를 기반으로 다소 성장할 것으로 기대됩니다. 이러한 성장은 양극화된 플래그십과 Low-end 모델을 중심으로 이루어질 것으로 예상됩니다. 다소 제한적인 출하량 성장에도 불구하고 채용량 증가 위주의 모바일 메모리 TAM 성장은 지속 전망됩니다. 특히 최근 플래그십향 16GB 이상 LPD5X/T를 필두로 고용량 제품 채용이 늘어나는 추세이며 플래그십을 중심으로 초고용량/초고속 메모리 채용은 지속 확대될 것으로 전망됩니다. 아울러 중장기적으로 AI 관련 기능의 고도화/지능화가 요구되며 초연결 AI 사회 핵심 Hub 역할을 하는 기기로 점점 더 고성능 Computing Power가 요구될 것입니다. 당사는 최신 기술력을 바탕으로 한 다양한 Mobile 제품 Line up을 구축하여 고용량/고성능/저전력 구현을 위한 미래 제품 개발에 최선을 다하고 있습니다.

[낸드플래시(NAND Flash)]

낸드플래시는 데이터 저장 용도로 쓰이는 대표적인 메모리 반도체로서, 기술 산업의 빠른 진화로 매년 높은 성장률을 기록하고 있습니다. 특히 최첨단 IT 기기 및 다양한 생활가전에서의 제품 채용률 및 채용량 증가가 지속되는 추세입니다.

과거에는 스마트폰, 태블릿 PC 등 모바일 분야가 주 사용처였으나, 현재는 서버, PC향 수요의 괄목할만한 성장으로 SSD가 낸드플래시 주요 활용처 중 하나로 자리 잡았습니다. 최근에는 폴더블폰 등 플래그십 스마트폰의 확장과 클라우드 컴퓨팅 강세에 따른 고용량 낸드플래시 채용 증가 등이 성장을 이끌고 있으며, 게임 콘솔 기기의 낸드플래시 채용으로 신규 수요가 증가하고 있는 추세입니다. 전기차/자율주행차량의 도입 및 확산, 그리고 생성형 AI의 개화 또한 미래 성장동력으로 주목받고 있습니다.

이와 같은 낸드플래시 시장에서 당사는 저용량부터 고용량까지 다양한 응용 복합 제품을 기반으로 고객의 수요에 보다 적극적으로 대응하고 있으며, 응용 분야별 선택과 집중을 통해 낸드플래시 경쟁력을 확보하고 시장에서의 위상을 굳건히 하고 있습니다.

[CIS(CMOS Image Sensor)]

CIS는 모바일 폰, 노트북, 태블릿, 디지털 카메라 등 다양한 디지털 기기에서 필름 역할을 하는 반도체 소자이며, 2022년부터 2027년까지 연평균 약 3%의 성장률을 보일 것으로 예상하고 있습니다. (출처: Techno-Systems Research 2023.1H, 출하량 기준)

현재 CIS 화질과 기능이 크게 향상되면서 자동차, 보안, VR/AR, 의료 등으로 응용 범위가 점차 확대되고 있습니다. 수량 및 매출 비중이 가장 큰 모바일의 경우, 전후면에 이미지센서가 장착되고 있으며, 2016년부터는 광학줌 및 포커싱(보케) 등의 카메라 기능 확대를 위해 후면에는 듀얼 카메라가 채용되기 시작했습니다. 2018년 이후에는 초광각, 폴디드줌 등으로 카메라 기능이 더욱 확장되면서 트리플, 쿼드러플 카메라가 상용화되기 시작했으며 이로 인해 기기당 탑재량이 지속 증가하는 추세입니다. 최근 스마트폰 카메라 시장은 멀티 카메라 및 48Mp 이상 고화소 채용 증가로 카메라 성능이 어느 때보다도 중요한 마케팅 요소가 되고 있습니다.

당사는 이미지센서 시장 중 가장 많은 비중을 차지하고 있는 모바일 시장과 이와 유사한 성능을 요구하고 있는 노트북 시장에 집중하고 있습니다. 2017년부터 고화소 시장으로 진입하기 위해 300mm 공정을 구축하여 1.0um Pixel을 우수한 성능으로 개발하였고, 2019년 하반기에는 1.0um Pixel 기반의 제품을 고객에 인증 받아 고화소 시장 확대를 위한 발판을 마련하였습니다. 2021년 0.7um Pixel 제품 출시에 이어 2022년에는 0.64um Pixel 제품을 출시하며 미세 Pixel 기반의 다양한 제품 Line up 구축을 통한 경쟁력을 강화하고 있습니다.

향후 점유율 확대를 위하여 시장의 니즈에 맞추어 제품을 개발하는 것 이외에도, 보안 카메라와 바이오 등과 같이 새로운 시장 진입을 통한 애플리케이션 다양화로 CIS시장에서의 입지를 더욱 강화해 나갈 계획입니다.

다. 회사의 고객관리 정책

당사는 IT 산업을 대표하는 글로벌 기업으로서 매출기여도가 높고 당사 판매 전략에 부합하는 각 응용 분야별 전략 고객 관리를 통하여 안정적인 매출 기반을 확보함은 물론, 제품 구성을 다양화하여 수익성을 극대화하고 있습니다.

라. 지식재산권 보유현황

작성기준일 현재 당사는 총 19,462건의 지식재산권을 보유하고 있습니다. 통상적으로 등록권리는 해마다 증가하나, 기 등록된 권리를 평가하여 등록 유지 또는 포기 여부를 결정하고 있어 포기된 권리로 인해 그 수치가 다소 변동할 수 있습니다.

당사 지식재산권은 전문인력으로 구성된 전담 조직에 의해 관리되고 있으며, 당해 전문인력은 지식재산권 기획, 개발 및 관리, 출원/등록, 사후관리 및 분쟁 대응을 포함한 관련업무 전반을 담당하고 있습니다.

특허권 및 상표권은 각국 특허법 및 상표법에 근거하여 보호됩니다. 특허권의 존속기간은 출원일로부터 20년이고, 상표권은 등록일로부터 10년이며 상표권은 갱신등록절차를 통해 존속기간이 연장될 수 있습니다.

마. 정부나 지방자치단체의 법률 규정 등에 의한 규제사항

산업 기술의 유출 방지 및 보호에 관한 법률 제11조에 의하여 국가 핵심기술로 지정되거나, 국가첨단 전략산업 경쟁력 강화 및 보호에 관한 특별 조치법 제12조에 의해 전략기술로 지정된 반도체 제조기술을 해외로 이전하는 경우, 수출자는 산업통상자원부의 승인을 받거나, 산업통상자원부에 신고할 의무를 지니고 있습니다. 이에 당사는 제품개발 경쟁력 강화를 위한 해외 생산공장 및 기술센터에 반도체 기술 이전 시 관련 법 및 절차를 준수 이행하고 있습니다.

바. 환경보호 정책 및 현황

(1) SHE(Safety, Health, Environment) 경영시스템 인증

당사는 국제 인증규격인 ISO45001(안전보건경영시스템), ISO14001(환경경영시스템)과 국내 인증규격인 KOSHA MS (안전보건경영시스템)을 취득하여 유지관리하고 있으며, 이를 위해 SHE경영활동의 객관성 확보 및 효과를 극대화하기 위한 활동들을 수행하고 있습니다. SHE담당 조직에서는 내부심사원을 양성하여 기업활동으로 인해 발생하는 안전보건환경 영향요인을 모니터링하고, 국내외 인증규격에 따라 선행적/체계적인 SHE경영 관리를 실시하고 있습니다. 당사는 안전보건 및 환경 분야의 지속적인개선을 추구하며, 환경영향을 최소화하고 건강하고 안전한 사업장을 구축하기 위한 노력을 지속적으로 수행해 나갈 것입니다.

(2) 기후변화 협약 대응

당사는 기후변화와 관련된 유무형의 위험과 기회 관리를 위해 기후변화 관련 규제를 준수하며 적극적으로 대응하고 있습니다. 또한, 기후변화로 인해 발생할 수 있는 비용 및 제품 품질 관리를 위한 전략을 마련하고 고객 및 정부의 신뢰도를 지속적으로 확보하여 환경에 대한 새로운 가치를 창출할 수 있도록 전사적 수준의 대응을 하고 있습니다.

[Net Zero 달성을 위한 노력]

당사는 2050년 Net Zero 달성을 기후변화 대응 목표의 방향으로 삼고 온실가스 배출량 (Scope1 & Scope2)과 집약도 배출량 저감 목표를 수립했습니다. 또한, 2050년까지 글로벌 사업장 전체 전력 사용량의 100%를 재생에너지로 조달할 계획입니다. 향후 RE100 및 Net Zero 달성을 위한 이행 방안을 지속적으로 업데이트하여 기후변화 대응을 위한 당사의 노력과 세부 실천 방안을 공개해 나갈 예정입니다.

[RE100(Renewable Energy 100) 선언]

당사는 기후변화 문제의 심각성을 인지하고 친환경 에너지 사용 확대를 위한 장기적인 계획을 수립하고 있습니다. 2020년 RE100 선언을 통해 2050년까지 글로벌 사업장 재생에너지 100% 사용을 약속하였으며, 이를 위한 중간 목표로 2030년 재생에너지 33% 사용을 공표한 바 있습니다. 성공적인 재생에너지 조달을 위해서는 국가별 정책/제도 및 조달 인프라에 대한 심도 있는 이해가 필요하며, 이에 기반한 국가별 맞춤형 전략 수립이 필요합니다. 이를 위해 SK하이닉스는 탄소관리위원회를 운영하여 2050 Net Zero 계획 및 정부 전력수급기본계획과 연계한 재생에너지 조달 방안을 검토하고 있습니다. 또한, 재생에너지 생태계 내 다양한 이해관계자와 협력 체계를 공고히 하여 RE100 이행 수단을 점진적으로 다변화하는 등 재생에너지 전환 실행력을 높여 나갈 예정입니다.

※ RE100: 사용하는 전력을 100% 재생에너지(Renewable Energy)로 조달하겠다는 선언

[CDP(탄소정보 공개 프로젝트) 탄소경영 최우수기업 명예의 전당 10년차 유지]

당사는 탄소정보 공개 프로젝트(CDP: Carbon Disclosure Project) 한국위원회가 선정하는 탄소경영최우수 그룹인 '탄소경영 글로벌 리더스 클럽'에 5년 연속 편입되어 국내 최초로 명예의 전당에 입성, 2022년 명예의 전당 10년차를 유지하였습니다.

[온실가스 배출권거래제 대응]

온실가스 배출권거래제는 정부가 각 기업에게 온실가스를 배출할 수 있는 배출권을 부여하고 기업들은 시장원리에 의해 형성된 배출권 가격을 토대로 각 기업별 한계저감비용에 따라 배출권을 매입하거나 매도하는 제도입니다.

당사는 '기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법' 및 '온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률'에 따라 2014년 배출권할당대상업체로 지정되어 2015년부터 온실가스 배출권거래제 참여기업으로 할당된 온실가스 배출량을 달성하기 위해 온실가스 저감장치(스크리버) 성능 개선과 에너지경영시스템(ISO50001) 기반의 체계적인 에너지 감축 활동을 추진하고 있습니다. 온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률 제24조에 따라 정부에 보고하는 명세서 기재 내용을 기준으로 2022년 온실가스 배출량은 최종 4,979,251만톤 CO₂e (tCO₂e)입니다.

[온실가스 배출량 및 에너지 사용량]

당사의 최근 3년 온실가스 배출량 및 에너지 사용량 정보는 다음과 같습니다.

구분	2022년(제75기)	2021년(제74기)	2020년(제73기)
온실가스 배출량(tCO ₂ -eq)	4,979,251	4,388,175	4,951,249

에너지 사용량(TJ)	98,028	87,063	80,759
-------------	--------	--------	--------

※ 대상은 국내 사업장 기준이며, 정부에 신고된 당사 온실가스 배출량 및 에너지 사용량입니다.
 ※ 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 정부의 배출량 적합성 평가에 따라 변동될 수 있습니다.

(3) 친환경 제품 및 사업장 구축을 위한 노력

[화학물질 전과정 평가를 위한 SHE CHEMs 운영]

당사는 국내외 법규 및 협약을 기반으로 자체규제물질을 설정하고 화학물질 입고 관리 시스템 'SHE CHEMs (SHE Chemical Hazard Evaluation Management system)' 을 운영함으로써 유해화학물질에 대한 사전 검토 및 사후 관리를 지속적으로 진행하고 있습니다. MSDS, 화학물질보증서, LoC 와 같은 문서들을 안전/보건/환경 각 분야의 전문가가 검토를 진행하며, 모든 분야의 검토가 완료된 화학물질만 당사 내에서 사용이 가능합니다. 뿐만 아니라, 당사는 협력사와의상생협력을 위하여 당사의 화학물질 정책이 담긴 SK hynix RSC (Regulated Substances for Chemical management)를 발간하였으며, 매년 화학물질공급사 설명회를 진행하고 있습니다.

[전과정 평가(Life Cycle Assessment, LCA)/물발자국/탄소성적/ZWTL(Zero Waste To Landfill)인증/순환자원인정]

당사는 매년 DRAM 및 NAND Flash 메모리의 주요 제품에 대하여 전과정평가를 수행하고 있습니다. 회사는 2013년 환경부로부터 20나노급 4Gb DDR3 제품에 대하여 업계 최초 환경성적표지 인증을 획득함에 이어, 2019년에는 10나노급 8Gb LPDDR4 DRAM 제품에 대하여, 2021년에는 10나노급 6Gb LPDDR4 DRAM 제품과 3D-V4 NAND Flash 256Gb TLC 제품에 대한 물발자국, 탄소발자국 인증을 획득하였습니다. 2022년에는 해외 카본트러스트 인증을 완료하고 저전력 제품 감축 인증을 받는 등 온실가스 감축을 위한 활동을 지속적으로 수행하고 있습니다.

2018년 국내 기업 최초로 '폐기물 매립 제로화(ZWTL)' 인증을 획득하였으며, 2019년에는 중국 사업장을 포함하여, 전사업장 인증 획득을 완료하였습니다. 2021년 국내 사업장 및 우시 사업장의 경우 '폐기물 매립 제로화(ZWTL)' Gold 등급(재활용률 95% 이상), 충칭 사업장은 Silver 등급(재활용률 90% 이상)을 획득하였고, 2022년에는 폐기물 재활용 Item 적용을 통해 국내사업장은 ZWTL 최고 등급인 Platinum 등급(재활용률 100%)을 획득하여 선도적인 폐기물 관리능력을 보유하고 있음을 인정받았습니다.

또한, 정부의 폐기물 정책 패러다임 변화에 맞춰 2019년 '순환자원인정제도'를 대기업 최초로 적용하였으며, 폐기되는 IC-Tray를 자원화하는 선순환 체계를 구축하여 '순환자원인정'을 획득하였습니다. 2023년에는 Module Tray, Wafer Carrier, Target 등 총 5종의 순환자원 인증 품목을 추가하였습니다.

회사는 향후에도 지속적으로 친환경 인증을 확대하고, 이해관계자들에게 친환경 정보를 제공할 계획입니다.

III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보

(단위 :백만원)

구 분	제76기 3분기	제75기	제74기
[유동자산]	30,393,967	28,733,332	26,907,075
· 현금및현금성자산	7,122,306	4,977,007	5,057,982
· 단기금융상품	515,346	415,625	474,637
· 단기투자자산	893,670	1,016,360	3,139,923
· 매출채권	5,515,297	5,186,054	8,267,111
· 재고자산	14,947,895	15,664,707	8,950,087
· 기타	1,399,453	1,473,579	1,017,335
[비유동자산]	71,655,483	75,138,180	69,439,450
· 관계기업 및 공동기업투자	1,416,495	1,352,845	1,410,428
· 장기투자자산	5,485,715	5,733,544	6,665,513
· 유형자산	54,016,964	60,228,528	53,225,667
· 무형자산	3,551,901	3,512,107	4,797,162
· 기타	7,184,408	4,311,156	3,340,680
자산총계	102,049,450	103,871,512	96,346,525
[유동부채]	20,250,122	19,843,696	14,735,395
[비유동부채]	26,567,768	20,737,274	19,420,072
부채총계	46,817,890	40,580,970	34,155,467
[지배기업 소유주지분]	55,202,275	63,266,355	62,157,072
· 자본금	3,657,652	3,657,652	3,657,652
· 자본잉여금	4,346,117	4,336,170	4,334,643
· 기타포괄손익누계액	1,196,594	898,682	675,271
· 기타자본항목	(2,285,868)	(2,311,409)	(2,294,562)
· 이익잉여금	48,287,780	56,685,260	55,784,068
[비지배지분]	29,285	24,187	33,986
자본총계	55,231,560	63,290,542	62,191,058
매출액	21,460,214	44,621,568	42,997,792
영업이익	(8,076,347)	6,809,417	12,410,340
연결총당기순이익	(7,758,097)	2,241,669	9,616,188
지배기업의 소유주지분	(7,755,323)	2,229,560	9,602,316
비지배지분	(2,774)	12,109	13,872

기본주당순이익	(11,272원)	3,242 원	13,989 원
연결에 포함된 회사수	60개사	60개사	56개사

※ 한국채택국제회계기준에 따라 연결기준으로 작성되었습니다.

※ 제76기 3분기의 재무상태표에 해당하는 부분은 2023년 9월 30일 기준이며, 포괄손익계산서에 해당하는 부분은 2023년 9월 30일까지의 누계 기준으로 작성되었습니다.

※ MMT 특정금전신탁은 연결에 포함된 회사수에서 제외하였습니다.

나. 요약 별도재무정보

(단위 :백만원)

구 분	제76기 3분기	제75기	제74기
[유동자산]	17,567,697	17,511,130	16,833,952
· 현금및현금성자산	1,704,678	1,637,350	1,608,456
· 단기금융상품	272,500	272,500	332,500
· 단기투자자산	363,670	505,532	1,752,221
· 매출채권	4,033,199	3,766,707	7,061,546
· 재고자산	10,371,360	10,345,744	5,495,436
· 기타	822,290	983,297	583,793
[비유동자산]	76,628,197	74,289,103	68,138,592
· 종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자	13,221,051	11,873,138	11,689,952
· 장기투자자산	5,142,835	5,421,102	6,441,334
· 유형자산	38,784,655	43,151,324	35,870,163
· 무형자산	2,940,218	2,897,769	2,995,581
· 기타	16,539,438	10,945,770	11,141,562
자산총계	94,195,894	91,800,233	84,972,544
[유동부채]	15,568,486	14,790,337	11,947,187
[비유동부채]	22,840,202	16,847,074	14,287,743
부채총계	38,408,688	31,637,411	26,234,930
[자본금]	3,657,652	3,657,652	3,657,652
[자본잉여금]	4,388,412	4,375,998	4,374,471
[기타포괄손익누계액]	(1,623)	27,370	23,181
[기타자본항목]	(2,285,869)	(2,311,408)	(2,294,562)
[이익잉여금]	50,028,634	54,413,210	52,976,872
자본총계	55,787,206	60,162,822	58,737,614
종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법
매출액	17,906,637	37,878,699	41,557,337
영업이익	(5,111,260)	7,660,947	12,183,360
당기순이익	(3,742,914)	2,790,457	9,567,226
기본주당순이익	(5,440원)	4,058 원	13,938 원

※ 한국채택국제회계기준에 따라 별도기준으로 작성되었습니다.

※ 제76기 3분기의 재무상태표에 해당하는 부분은 2023년 9월 30일 기준이며, 포괄손익계산서에 해당하는 부분은 2023년 9월 30일까지의 누계 기준으로 작성되었습니다.

2. 연결재무제표

2-1. 연결 재무상태표

연결 재무상태표

제 76 기 3분기말 2023.09.30 현재

제 75 기말 2022.12.31 현재

(단위 : 백만원)

	제 76 기 3분기말	제 75 기말
자산		
유동자산	30,393,967	28,733,332
현금및현금성자산	7,122,306	4,977,007
단기금융상품	515,346	415,625
단기투자자산	893,670	1,016,360
매출채권	5,515,297	5,186,054
기타수취채권	362,882	272,512
재고자산	14,947,895	15,664,707
당기법인세자산	43,728	14,523
기타유동자산	876,984	1,186,544
기타금융자산	115,859	
비유동자산	71,655,483	75,138,180
관계기업 및 공동기업투자	1,416,495	1,352,845
장기투자자산	5,485,715	5,733,544
기타수취채권	488,957	354,167
기타금융자산	122,351	115,712
유형자산	54,016,964	60,228,528
사용권자산	2,683,902	1,779,985
무형자산	3,551,901	3,512,107
투자부동산	214	223
이연법인세자산	2,369,320	657,115
종업원급여자산	1,318,135	1,332,253
기타비유동자산	201,529	71,701
자산총계	102,049,450	103,871,512
부채		
유동부채	20,250,122	19,843,696
매입채무	1,916,761	2,186,230
미지급금	2,834,557	5,445,335

기타지급채무	1,802,421	3,024,648
차입금	11,229,878	7,423,247
총당부채	261,666	251,889
당기법인세부채	30,269	696,553
리스부채	600,461	280,873
기타유동부채	936,355	534,335
기타금융부채	637,754	586
비유동부채	26,567,768	20,737,274
장기미지급금	3,268,421	2,958,659
기타지급채무	84,855	28,083
차입금	20,328,737	15,571,357
총당부채	2,774	1,404
확정급여부채	76,702	69,952
이연법인세부채	125,451	382,477
리스부채	2,423,357	1,516,208
기타비유동부채	253,451	204,844
기타금융부채	4,020	4,290
부채총계	46,817,890	40,580,970
자본		
지배기업의 소유지분	55,202,275	63,266,355
자본금	3,657,652	3,657,652
자본잉여금	4,346,117	4,336,170
기타자본	(2,285,868)	(2,311,409)
기타포괄손익누계액	1,196,594	898,682
이익잉여금	48,287,780	56,685,260
비지배지분	29,285	24,187
자본총계	55,231,560	63,290,542
부채및자본총계	102,049,450	103,871,512

2-2. 연결 포괄손익계산서

연결 포괄손익계산서

제 76 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지

제 75 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지

(단위 : 백만원)

	제 76 기 3분기		제 75 기 3분기	
	3개월	누적	3개월	누적
매출액	9,066,171	21,460,214	10,982,883	36,949,537
매출원가	9,002,045	24,219,215	7,117,303	21,345,100
매출총이익(손실)	64,126	(2,759,001)	3,865,580	15,604,437

판매비와관리비	1,856,087	5,317,346	2,205,057	6,882,791
영업이익(손실)	(1,791,961)	(8,076,347)	1,660,523	8,721,646
금융수익	668,230	2,188,565	2,095,629	4,178,889
금융비용	1,141,653	3,656,065	2,064,165	4,615,888
지분법투자 관련 손익	6,011	18,858	26,526	119,245
기타영업외수익	234,157	260,258	30,097	214,249
기타영업외비용	444,441	518,316	60,401	180,065
법인세비용차감전순이익(손실)	(2,469,657)	(9,783,047)	1,688,209	8,438,076
법인세비용(이익)	(284,958)	(2,024,950)	580,592	2,461,820
분기순이익(손실)	(2,184,699)	(7,758,097)	1,107,617	5,976,256
법인세차감후 기타포괄손익	161,644	273,768	1,065,393	2,065,230
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익				
확정급여제도의 재측정요소	(8,119)	(23,017)	(14,480)	(36,758)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익				
해외사업장환산외환차이	155,416	273,057	978,631	1,886,027
파생상품평가손익	(6,449)	(29,827)	(1,448)	9,228
관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	20,796	53,555	102,690	206,733
분기총포괄이익(손실)	(2,023,055)	(7,484,329)	2,173,010	8,041,486
분기순이익(손실)의 귀속				
지배기업의 소유주지분	(2,183,733)	(7,755,323)	1,111,705	5,970,978
비지배지분	(966)	(2,774)	(4,088)	5,278
분기총포괄이익(손실)의 귀속				
지배기업의 소유주지분	(2,022,125)	(7,480,428)	2,168,781	8,023,517
비지배지분	(930)	(3,901)	4,229	17,969
지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익				
기본주당분기순이익(손실) (단위 : 원)	(3,174)	(11,272)	1,617	8,683
희석주당분기순이익(손실) (단위 : 원)	(3,174)	(11,272)	1,616	8,681

2-3. 연결 자본변동표

연결 자본변동표

제 76 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지

제 75 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지

(단위 : 백만원)

	자본							
	지배기업 소유주 귀속분						비지배지분	자본 합계
	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업 소유주 귀속분 합계		
2022.01.01 (기초자본)	3,657,652	4,334,643	(2,294,562)	675,271	55,784,068	62,157,072	33,986	62,191,058
분기순이익(손실)					5,970,978	5,970,978	5,278	5,976,256
확정급여제도의 재측정요소					(36,758)	(36,758)		(36,758)
관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분				206,733		206,733		206,733
파생상품평가손익				9,228		9,228		9,228
해외사업장환산외환차이				1,873,336		1,873,336	12,691	1,886,027
배당금의 지급					(1,471,526)	(1,471,526)	(3,084)	(1,474,610)

주식선택권 부여/행사			4,587			4,587		4,587
주식선택권 조건변경			(26,927)			(26,927)		(26,927)
자기주식처분		1,527	1,731			3,258		3,258
종속회사 지분 추가 취득								
2022.09.30 (기말자본)	3,657,652	4,336,170	(2,315,171)	2,764,568	60,246,762	68,689,981	48,871	68,738,852
2023.01.01 (기초자본)	3,657,652	4,336,170	(2,311,409)	898,682	56,685,260	63,266,355	24,187	63,290,542
분기순이익(손실)					(7,755,323)	(7,755,323)	(2,774)	(7,758,097)
확정급여제도의 재측정요소					(23,017)	(23,017)		(23,017)
관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분				53,555		53,555		53,555
파생상품평가손익				(29,827)		(29,827)		(29,827)
해외사업장환산외환차이				274,184		274,184	(1,127)	273,057
배당금의 지급					(619,140)	(619,140)		(619,140)
주식선택권 부여/행사			(978)			(978)	20,107	19,129
주식선택권 조건변경								
자기주식처분		12,414	26,519			38,933		38,933
종속회사 지분 추가 취득		(2,467)				(2,467)	(11,108)	(13,575)
2023.09.30 (기말자본)	3,657,652	4,346,117	(2,285,868)	1,196,594	48,287,780	55,202,275	29,285	55,231,560

2-4. 연결 현금흐름표

연결 현금흐름표

제 76 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지

제 75 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지

(단위 : 백만원)

	제 76 기 3분기	제 75 기 3분기
영업활동 현금흐름	325,283	13,595,720
영업으로부터 창출된 현금흐름	2,276,472	16,763,330
이자의 수취	135,993	35,371
이자의 지급	(905,531)	(312,697)
배당금의 수취	32,578	19,744
법인세의 납부	(1,214,229)	(2,910,028)
투자활동 현금흐름	(5,694,904)	(14,575,625)
단기금융상품의 감소	984,402	1,549,687
단기금융상품의 증가	(1,083,035)	(1,617,034)
단기투자자산의 순증감	184,378	1,267,232
기타수취채권의 감소	42,147	30,017
기타수취채권의 증가	(225,626)	(63,916)
장기투자자산의 처분	8,560	3,701
장기투자자산의 취득	(28,830)	(97,656)
기타금융자산의 감소		29,350
유형자산의 처분	1,388,014	314,748
유형자산의 취득	(6,599,521)	(14,873,038)
무형자산의 처분	290	1,016
무형자산의 취득	(352,682)	(521,587)
투자부동산의 처분		263,211

관계기업투자의 처분	8,847	201,454
관계기업투자의 취득	(21,848)	(35,147)
사업결합으로 인한 순현금유출		(1,027,663)
재무활동 현금흐름	7,398,402	102,806
차입금의 차입	17,747,887	6,392,515
차입금의 상환	(9,446,375)	(4,611,893)
배당금의 지급	(619,140)	(1,474,610)
주식선택권의 행사	53	3
리스부채의 상환	(283,185)	(212,727)
자기주식의 처분	12,737	9,518
종속회사 지분 추가취득	(13,575)	
현금및현금성자산의 환율변동효과	116,518	538,334
현금및현금성자산의 순증감	2,145,299	(338,765)
기초 현금및현금성자산	4,977,007	5,057,982
분기말 현금및현금성자산	7,122,306	4,719,217

3. 연결재무제표 주석

제 76 기 3분기 2023년 9월 30일 현재

제 75 기 3분기 2022년 9월 30일 현재

에스케이하이닉스 주식회사와 그 종속기업

1. 회사의 개요

(1) 지배기업의 개요

에스케이하이닉스 주식회사(이하 "지배기업")는 1996년에 주식을 한국거래소에 상장한 공개법인으로, 1949년 10월 15일에 설립되어 메모리반도체의 제조 및 판매업을 주업으로 하고 있습니다. 지배기업은 경기도 이천시 부발읍 경춘대로 2091에 본사와 경기도 성남시 등에 사무소를 두고 있습니다. 지배기업과 그 종속기업(이하 "연결회사")은 경기도 이천시와 충청북도 청주시, 중국 우시(Wuxi)와 충칭(Chongqing), 다롄(Dalian)에 생산공장을 설치·가동하고 있습니다.

2023년 9월 30일 현재 지배기업의 주주현황은 다음과 같습니다.

구 분	소유주식수(주)	지분율(%)
SK스퀘어	146,100,000	20.07
기타주주	542,016,189	74.45
자기주식	39,886,176	5.48
합 계	728,002,365	100.00

당분기말 현재 지배기업의 주식은 한국거래소가 개설하는 유가증권시장에, 주식예탁증서는

룩셈부르크 증권거래소에 상장되어 있습니다.

(2) 당분기말과 전기말 현재 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

종속기업명	소재지	주요영업활동	결산월	소유지분율(%)	
				당분기말	전기말
에스케이하이엔지㈜	국 내	건설공사 및 서비스	12월	100	100
에스케이하이텍㈜	국 내	사업지원 및 서비스	12월	100	100
행복나래㈜	국 내	산업자재 유통	12월	100	100
행복모아㈜	국 내	반도체 의류 제조, 제빵 및 서비스	12월	100	100
에스케이하이닉스시스템아이씨㈜	국 내	반도체 연구개발 및 사업 지원	12월	100	100
SK hynix America Inc. (*14)	미 국	반도체 판매	12월	100	97.74
SK hynix Deutschland GmbH	독 일	반도체 판매	12월	100	100
SK hynix Asia Pte.Ltd.	싱가포르	반도체 판매	12월	100	100
SK hynix Semiconductor Hong Kong Ltd.	홍 콩	반도체 판매	12월	100	100
SK hynix Japan Inc.	일 본	반도체 판매	12월	100	100
SK hynix U.K. Ltd.	영 국	반도체 판매	12월	100	100
SK hynix Semiconductor India Private Ltd. (*1)	인 도	반도체 판매	12월	100	100
SK hynix Semiconductor (Shanghai) Co.,Ltd.	중 국	반도체 판매	12월	100	100
SK hynix(Wuxi) Semiconductor Sales Ltd.	중 국	반도체 판매	12월	100	100
SK hynix Semiconductor Taiwan Inc.	대 만	반도체 판매	12월	100	100
SK hynix Semiconductor (China) Ltd.	중 국	반도체 제조	12월	100	100
SK hynix Semiconductor (Chongqing) Ltd. (*2)	중 국	반도체 제조	12월	100	100
SK APTECH Ltd.	홍 콩	해외투자법인	12월	100	100
SK hynix Ventures Hong Kong Ltd.	홍 콩	해외투자법인	12월	100	100
SK hynix Italy S.r.l (*15)	이탈리아	반도체 연구개발	12월	100	100
SK hynix memory solutions America Inc. (*12)	미 국	반도체 연구개발	12월	99.47	99.89
SK hynix memory solutions Taiwan Ltd.	대 만	반도체 연구개발	12월	100	100
SK hynix memory solutions Eastern Europe, LLC. (*15)	벨라루스	반도체 연구개발	12월	100	100
SK hynix (Wuxi) Investment Ltd. (*3)	중 국	해외투자법인	12월	100	100
SK hynix (Wuxi) Industry Development Ltd. (*4)	중 국	해외병원자산법인	12월	100	100
SK hynix Happiness (Wuxi) Hospital Management Ltd. (*4)	중 국	해외병원운영법인	12월	70	70
SK hynix cleaning (Wuxi) Ltd. (*4)	중 국	기업 건물 관리 등	12월	100	100
SK hynix system ic (wuxi) Co., Ltd. (*5)	중 국	반도체 제조 및 판매	12월	100	100
SUZHOU HAPPYNARAE Co., Ltd. (*6)	중 국	해외 산업자재유통	12월	100	100
CHONGQING HAPPYNARAE Co. Ltd. (*7)	중 국	해외 산업자재유통	12월	100	100
SK hynix (Wuxi) Education Technology Co.,Ltd (*4)	중 국	교육법인	12월	100	100
SkyHigh Memory Limited (*5)	홍 콩	반도체 제조 및 판매	12월	60	60
Gauss Labs Inc. (*16)	미 국	정보통신업	12월	99.94	100
SkyHigh Memory China Limited (*9)	중 국	반도체 판매지원	12월	60	60
SkyHigh Memory Limited Japan (*9)	일 본	반도체 판매지원	12월	60	60
HappyNarae America LLC (*6)	미 국	해외 산업자재유통	12월	100	100
HappyNarae Hungary Kft (*6)	헝가리	해외 산업자재유통	12월	100	100
SK hynix Ventures America LLC	미 국	해외투자법인	12월	100	100
SK Hynix (Wuxi) Education Service Development Co., Ltd. (*10)	중 국	교육법인	12월	100	100
SK hynix NAND Product Solutions Corp.	미 국	반도체 판매, 연구개발 등	12월	99.47	99.89
SK hynix NAND Product Solutions Taiwan Co., Ltd. (*8),(12)	대 만	반도체 연구개발 및 판매	12월	99.47	99.89

SK hynix NAND Product Solutions Canada Ltd. (*8),(12)	캐나다	반도체 연구개발	12월	99.47	99.89
SK hynix NAND Product Solutions Mexico, S. DE R.L. DE C.V. (*8),(12)	멕시코	반도체 연구개발	12월	99.47	99.89
SK hynix Semiconductor (Dalian) Co., Ltd.	중 국	반도체 제조	12월	100	100
SK hynix NAND Product Solutions UK Limited (*8),(12)	영 국	반도체 판매	12월	99.47	99.89
SK hynix NAND Product Solutions Israel Ltd. (*8),(12)	이스라엘	반도체 판매	12월	99.47	99.89
SK hynix NAND Product Solutions Japan G.K. (*8),(12)	일 본	반도체 판매	12월	99.47	99.89
SK hynix NAND Product Solutions International LLC (*8),(12)	미 국	반도체 판매	12월	99.47	99.89
SK hynix NAND Product Solutions Asia Pacific LLC (*8),(12)	미 국	반도체 판매	12월	99.47	99.89
SK hynix NAND Product Solutions Singapore Pte. Ltd. (*8),(12)	싱가포르	반도체 판매	12월	99.47	99.89
SK hynix NAND Product Solutions Malaysia Sdn. Bhd. (*8),(12)	말레이시아	반도체 판매	12월	99.47	99.89
SK HYNIX NAND PRODUCT SOLUTIONS POLAND sp. z o.o. (*8),(12)	폴란드	반도체 연구개발	12월	99.47	99.89
SK hynix NAND Product Solutions (Beijing) Co., Ltd. (*8),(12)	중 국	반도체 판매	12월	99.47	99.89
SK Hynix NAND Product Solutions (Shanghai) Co., Ltd. (*8),(12)	중 국	반도체 연구개발	12월	99.47	99.89
주식회사 키파운드리	한 국	반도체 판매 및 생산 등	12월	100	100
KEY FOUNDRY, INC. (*13)	미 국	반도체 판매	12월	100	100
KEY FOUNDRY SHANGHAI CO.,LTD. (*13)	중 국	반도체 판매	12월	100	100
KEY FOUNDRY LTD. (*13),(15)	대 만	반도체 판매	12월	100	100
Intel NDTM US LLC (*11)	미 국	반도체 연구개발	12월	-	-
Intel Semiconductor Storage Technology (Dalian) Ltd. (*11)	중 국	반도체 생산 지원	12월	-	-
MMT 특정금전신탁	국 내	특정금전신탁	12월	100	100

- (1) 종속기업인 SK hynix Asia Pte. Ltd.의 종속기업입니다.
- (2) 종속기업인 SK APTECH Ltd.의 종속기업입니다.
- (3) 종속기업인 SK hynix Semiconductor (China) Ltd.의 종속기업입니다.
- (4) 종속기업인 SK hynix (Wuxi) Investment Ltd.의 종속기업입니다.
- (5) 종속기업인 에스케이하이닉스시스템아이씨(주)의 종속기업입니다.
- (6) 종속기업인 행복나래(주)의 종속기업입니다.
- (7) 종속기업인 SUZHOU HAPPYNARAE Co., Ltd.의 종속기업입니다.
- (8) 종속기업인 SK hynix NAND Product Solutions Corp.의 종속기업입니다.
- (9) 종속기업인 SkyHigh Memory Limited의 종속기업입니다.
- (10) 종속기업인 SK hynix (Wuxi) Education Technology Co.,Ltd.의 종속기업입니다.
- (11) 당분기말 현재 법적소유권은 인텔에게 있으며 2025년으로 예상되는 인텔 NAND사업 부문 인수 2차 종결을 통하여 소유권을 획득할 예정이나 당분기말 현재 지배기업이 지배력을 보유하고 있다고 판단하여 종속기업으로 편입하였습니다.
- (12) 당분기 중 SK hynix NAND Product Solutions Corp. 및 그 종속기업의 종업원에게 주식선택권을 지급하면서 지분율이 하락하였습니다.
- (13) 종속기업인 주식회사 키파운드리의 종속기업입니다.
- (14) 당분기 중 비지배지분을 취득하면서 지분율이 상승하였습니다.
- (15) 당분기 중 청산절차가 진행중입니다.
- (16) 당분기 중 Gauss Labs Inc.의 종업원이 주식선택권을 행사하면서 지분율이 하락하였습니다.

(3) 당분기 중 연결대상 종속기업은 전기말과 동일합니다.

(4) 당분기말과 전기말 현재 주요 종속기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)						
종속기업명	당분기말			전기말		
	총자산	총부채	총자본	총자산	총부채	총자본
SK hynix America Inc.	3,249,185	2,612,857	636,328	3,407,756	2,820,013	587,743
SK hynix Asia Pte. Ltd.	290,747	172,539	118,208	388,934	281,014	107,920
SK hynix Semiconductor Hong Kong Ltd.	333,483	138,897	194,586	236,723	58,074	178,649
SK hynix U.K. Ltd.	301,684	270,404	31,280	313,691	286,308	27,383
SK hynix Semiconductor Taiwan Inc.	588,442	566,590	21,852	156,135	130,036	26,099
SK hynix (Wuxi) Semiconductor Sales Ltd.	1,394,043	837,905	556,138	871,993	383,653	488,340
SK hynix Semiconductor (China) Ltd.	10,970,221	4,918,726	6,051,495	12,127,232	6,015,062	6,112,170
SK hynix Semiconductor (Chongqing) Ltd.	1,098,877	209,494	889,383	1,033,694	244,180	789,514
SK hynix Japan Inc.	277,387	197,773	79,614	385,040	307,751	77,289
행복나래㈜	125,511	71,803	53,708	205,797	145,968	59,829
SK hynix NAND Product Solutions Corp. 및 종속회사	12,994,311	13,457,894	(463,583)	13,475,178	10,333,565	3,141,614

(5) 당분기와 전분기 중 주요 종속기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)				
종속기업명	당분기		전분기	
	매출액	분기순손익	매출액	분기순손익
SK hynix America Inc.	7,777,536	(27,610)	15,666,175	(207,565)
SK hynix Asia Pte. Ltd.	788,759	3,598	2,245,156	15,195
SK hynix Semiconductor Hong Kong Ltd.	1,084,133	5,412	1,709,419	(3,649)
SK hynix U.K. Ltd.	435,490	2,150	1,021,380	20,754
SK hynix Semiconductor Taiwan Inc.	1,699,456	(2,385)	1,924,888	(17,086)
SK hynix (Wuxi) Semiconductor Sales Ltd.	5,255,706	60,351	8,571,524	32,837
SK hynix Semiconductor (China) Ltd.	3,880,287	(149,684)	4,173,176	(537,085)
SK hynix Semiconductor (Chongqing) Ltd.	812,654	87,802	856,374	64,720
SK hynix Japan Inc.	584,290	6,753	521,601	22,034
행복나래㈜	610,015	(6,120)	645,135	1,896
SK hynix NAND Product Solutions Corp. 및 종속회사	2,085,637	(3,672,435)	3,849,070	(857,838)

(6) 당분기말과 전기말 현재 연결회사에 대한 중요한 비지배지분은 없습니다.

2. 중요한 회계정책

2.1 분기연결재무제표 작성기준

연결회사의 2023년 9월 30일로 종료하는 9개월 보고기간에 대한 분기연결재무제표는 기업 회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 분기연결재무제표는 보고 기간말인 2023년 9월 30일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

2.1.1 연결회사가 채택한 제·개정 기준서 및 해석서

연결회사는 2023년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제·개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.

(1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' - '회계정책'의 공시

중요한 회계정책 정보를 정의하고 이를 공시하도록 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 분기 연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(2) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' - 행사가격 조정 조건이 있는 금융부채 평가 손익 공시

발행자의 주가 변동에 따라 행사가격이 조정되는 조건이 있는 금융상품의 전부나 일부가 금융부채로 분류되는 경우 그 금융부채의 장부금액과 관련 손익을 공시하도록 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 분기연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(3) 기업회계기준서 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' - '회계추정'의 정의 회계추정을 정의하고, 회계정책의 변경과 구별하는 방법을 명확히 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 분기연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(4) 기업회계기준서 제1012호 '법인세' - 단일거래에서 생기는 자산과 부채에 대한 이연법인세

자산 또는 부채가 최초로 인식되는 거래의 최초 인식 예외 요건에 거래시점 동일한 가산할 일시적차이와 차감할 일시적차이를 발생시키지 않는 거래라는 요건을 추가하였습니다. 해당 기준서의 개정이 분기연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(5) 기업회계기준서 제1117호 '보험계약' 제정

기업회계기준서 제1117호 '보험계약'은 기업회계기준서 제1104호 '보험계약'을 대체합니다. 보험계약에 따른 모든 현금흐름을 추정하고 보고시점의 가정과 위험을 반영한 할인율을 사용하여 보험부채를 측정하고, 매 회계연도별로 계약자에게 제공한 서비스(보험보장)를 반영하여 수익을 발생주의로 인식하도록 합니다. 또한, 보험사건과 관계없이 보험계약자에게 지급하는 투자요소(해약/만기환급금)는 보험수익에서 제외하며, 보험손익과 투자손익을 구분 표시하여 정보이용자가 손익의 원천을 확인할 수 있도록 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 분기연결재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

2.1.2 연결회사가 적용하지 않은 제·개정 기준서 및 해석서

제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제·개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.

(1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류

보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된 경우는 제외됩니다. 또한, 기업이 보고기간말 후에 준수해야 하는 약정은 보고기간말에 해당 부채의 분류에 영향을 미치지 않으며, 보고기간 이후 12개월 이내 약정사항을 준수해야 하는 부채가 보고기간말 현재 비유동부채로 분류된 경우 보고기간 이후 12개월 이내 부채가 상환될 수 있는 위험에 관한 정보를 공시해야 합니다. 동 개정사항은 2024년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 연결회사는 동 개정으로 인한 연결재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다.

2.2 회계정책

분기연결재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1.1에서 설명하는 제·개정 기준서 및 해석서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.

2.2.1 법인세비용

중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.

3. 중요한 회계추정 및 가정

연결회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다.

분기연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기 연결재무제표 작성에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.

4. 영업부문

연결회사는 반도체 제품의 제조 및 판매의 단일영업부문으로 구성되어 있습니다. 연결회사의 최고영업의사결정권자는 영업전략을 수립하는 과정에서 검토되는 보고정보에 반도체사업부문의 성과를 검토하고 있습니다.

(1) 당분기말과 전기말 현재 지역별 비유동자산(금융상품, 기타수취채권, 관계기업 및 공동기업투자, 이연법인세자산 제외)의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
국 내	45,668,511	48,935,513
중 국	15,570,363	17,486,061
아시아(중국 제외)	20,803	19,397
미 국	502,452	469,699
유 럽	10,516	14,128
합 계	61,772,645	66,924,798

(2) 당분기 중 단일 외부고객으로부터의 매출액이 연결회사 전체 매출액의 10%를 상회하는 고객은 없으며, 전분기 중 단일 외부고객으로부터의 매출액이 연결회사 전체 매출액의 10%를 상회하는 고객 (가), (나)로부터 발생한 매출액은 각각 4,332,591백만원, 3,985,640백만원입니다.

5. 금융상품의 범주별 분류

(1) 당분기말과 전기말 현재 금융자산의 범주별 분류내역은 다음과 같습니다.

① 당분기말

(단위: 백만원)					
구 분	당기손익-공정가치로 측정하는 금융자산	기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융자산	상각후원가로 측정하는 금융자산	기타금융자산	합 계
현금및현금성자산	-	-	7,122,306	-	7,122,306
단기금융상품	222,500	-	292,846	-	515,346
단기투자자산	893,670	-	-	-	893,670
매출채권(*)	-	332,432	5,182,865	-	5,515,297
기타수취채권	-	-	851,839	-	851,839
기타금융자산	-	-	706	237,504	238,210
장기투자자산	5,485,715	-	-	-	5,485,715
합 계	6,601,885	332,432	13,450,562	237,504	20,622,383

(*) 연결회사는 특정 거래처에 대한 일부 매출채권을 양도하고 위험과 보상의 대부분을 이전하여 매출채권을 양도일에 연결재무제표에서 제거하고 매출채권처분손익을 인식하고 있습니다.

② 전기말

(단위: 백만원)					
구 분	당기손익-공정가치로 측정하는 금융자산	기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융자산	상각후원가로 측정하는 금융자산	기타금융자산	합 계
현금및현금성자산	-	-	4,977,007	-	4,977,007
단기금융상품	222,500	-	193,125	-	415,625
단기투자자산	1,016,360	-	-	-	1,016,360
매출채권(*)	-	207,072	4,978,982	-	5,186,054
기타수취채권	-	-	626,679	-	626,679
기타금융자산	-	-	695	115,017	115,712
장기투자자산	5,733,544	-	-	-	5,733,544
합 계	6,972,404	207,072	10,776,488	115,017	18,070,981

(*) 연결회사는 특정 거래처에 대한 일부 매출채권을 양도하고 위험과 보상의 대부분을 이전하여 매출채권을 양도일에 연결재무제표에서 제거하고 매출채권처분손익을 인식하고 있습니다.

(2) 당분기말과 전기말 현재 금융부채의 범주별 분류내역은 다음과 같습니다.

① 당분기말

(단위: 백만원)			
구 분	당기손익-공정가치로 측정하는 금융부채	상각후원가로 측정하는 금융부채	합 계
매입채무	-	1,916,761	1,916,761
미지급금	-	6,102,978	6,102,978
기타지급채무(*)	-	1,352,420	1,352,420
차입금	-	31,558,615	31,558,615
리스부채	-	3,023,818	3,023,818
기타금융부채	637,174	4,600	641,774
합 계	637,174	43,959,192	44,596,366

(*) 기타지급채무 중 종업원급여제도에 따른 연결회사의 의무에 대응하는 미지급급여 부채는 금융상품 공시 대상이 아니므로 제외되었습니다.

② 전기말

(단위: 백만원)	
구 분	상각후원가로 측정하는 금융부채
매입채무	2,186,230
미지급금	8,403,994
기타지급채무(*)	1,415,197
차입금	22,994,604
리스부채	1,797,081
기타금융부채	4,876
합 계	36,801,982

(*) 기타지급채무 중 종업원급여제도에 따른 연결회사의 의무에 대응하는 미지급급여 부채는 금융상품 공시 대상이 아니므로 제외되었습니다.

6. 금융위험관리

(1) 금융위험관리

연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환율변동위험, 이자율위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 중간연결재무제표는 연차연결재무제표에서 요구되는 모든 재무위험관리와 공시사항을 포함하지 않으므로 2022년 12월 31일의 연차연결재무제표를 참고하시기 바랍니다. 연결회사의 위험관리부서 및 기타 위험관리정책에는 전기말 이후 중요한 변동사항이 없습니다.

① 시장위험

(가) 환율변동위험

연결회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 달러화, 유로화, 위안화 및 엔화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채 및 해외사업장에 대한 순투자가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생합니다.

당분기말 현재 연결회사의 화폐성 외화자산 및 외화부채의 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위: 백만원, 외화단위: 외화 백만단위)				
구 분	자 산		부 채	
	현지통화	원화환산	현지통화	원화환산
USD	16,166	21,740,700	22,859	30,740,544
JPY	2,711	24,461	68,613	619,040
CNY	1,869	344,463	341	62,771
EUR	19	26,509	137	194,588

또한, 연결회사는 외화사채 및 차입금의 환위험을 회피하기 위하여 주석 19에서 설명하는 바와 같이 통화스왑계약 및 통화이자율스왑계약을 체결하고 있습니다.

당분기말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율이 10% 변동시, 동 환율변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	10% 상승시	10% 하락시
USD	(678,240)	678,240
JPY	(59,458)	59,458
CNY	28,169	(28,169)
EUR	(16,808)	16,808

(나) 이자율위험

연결회사의 이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 차입금에서 발생하는 이자비용이 변동될 위험으로서, 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금에서 발생하고 있습니다. 변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 연결회사는 이자율위험에 노출되어 있으며 동 이자율위험의 일부는 변동이자부 금융자산 등으로부터의 이자율위험과 상쇄됩니다.

연결회사는 현금흐름 이자율위험을 변동이자수취/고정이자지급 스왑을 이용하여 관리하고 있습니다. 이러한 이자율 스왑은 변동이자부 차입금을 고정이자부 차입금으로 바꾸는 경제적 효과가 있습니다. 일반적으로, 연결회사는 변동이자율로 차입금을 발생시킨 후 고정이자율로 스왑을 하게 됩니다. 스왑계약에 따라 연결회사는 거래상대방과 특정기간(주로 분기)마다, 합의된 원금에 따라 계산된 고정이자와 변동이자의차이를 결제하게 됩니다.

연결회사는 당분기말 현재 이자율 변동에 따라 순이자비용이 변동할 위험에 일부 노출되어 있습니다. 연결회사는 변동금리부 차입금 546,325백만원에 대해 통화이자율스왑 계약, 변동금리부 차입금 100,000백만원에 대해 이자율스왑계약을 체결하고 있습니다. 따라서, 이자율 변동에 따른 해당 차입금에 대한 이자비용 변동으로 인한 당분기 법인세비용차감전순이익은 변동하지 않습니다.

한편, 다른 변동금리부 차입금 및 변동금리부 금융자산에 대하여 당분기말 현재 다른모든 변수가 일정하고 이자율이 100bp 하락 또는 상승시 향후 1년간 연결회사의 변동금리부 차입금 및 금융자산으로부터의 순이자비용으로 인한 법인세비용차감전순이익은 82,374백만원(전 분기: 79,923백만원) 만큼 증가 또는 감소할 것입니다.

(다) 가격위험

연결회사는 유동성관리 및 영업상의 필요 등으로 지분증권 및 채무증권에 투자하고 있습니다. 당분기말 현재 해당 지분증권 및 채무증권은 가격위험에 노출되어 있습니다.

② 신용위험

신용위험은 연결회사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 연결회사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다.

(가) 매출채권 및 기타수취채권

연결회사는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 연결회사의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하고 담보물을 확보하는 등 매출채권 및 기타수취채권 잔액에 대한 지속적인 관리 업무를 수행하고 있습니다. 연결회사는 매출채권 및 기타수취채권에 대해 매 보고기간말에 개별적으로 손상여부를 검토하고 있으며, 해외 거래처에 대한 신용위험과 관련하여 신용보험계약을 체결하고 있습니다. 연결회사의 신용위험 노출정도는 거래상대방별 매출채권 등의 장부금액과 동일한 금액입니다.

(나) 기타의 자산

현금및현금성자산, 단기금융상품, 장·단기투자자산 및 장·단기대여금 등으로 구성되는 연결회사의 기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 연결회사의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 연결회사는 다수의 금융기관에 현금및현금성자산과 단기금융상품 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.

③ 유동성위험

유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행하기 위한 필요자금을 조달하지 못할 위험입니다. 연결회사는 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다.

연결회사는 상기에서 언급한 예측을 통해 결정된 대로 여유있는 유동성이 확보될 수 있도록 적절한 만기나 충분한 유동성을 제공해주는 이자부 당좌예금, 정기예금, 수시입출금식 예금 등의 금융상품을 선택하여 잉여자금을 투자하고 있습니다.

(2) 자본관리

연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.

자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 연결회사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 차입금 조달 및 상환, 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 부채비율, 순차입금비율은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
부 채 (A)	46,817,890	40,580,970
자 본 (B)	55,231,560	63,290,542
현금및현금성자산 등 (C) (*)	8,531,322	6,408,992
차입금 (D)	31,558,615	22,994,604
부채비율 (A/B)	84.77%	64.12%
순차입금비율 (D-C)/B	41.69%	26.21%

(*) 현금및현금성자산, 단기금융상품 및 단기투자자산의 합계액입니다.

주요 차입금 계약상 연결회사는 일정 수준의 부채비율, 담보채무비율 등을 준수해야 하며, 연결회사는 당분기말 현재 이러한 조건을 준수하였습니다.

(3) 공정가치

공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.

- 수준 1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격
- 수준 2: 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수
- 수준 3: 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수

공정가치 서열체계를 포함한 금융자산과 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

① 당분기말

(단위: 백만원)					
구 분	장부금액	수준 1	수준 2	수준 3	합 계
공정가치로 측정되는 금융자산:					
단기금융상품	222,500	-	-	222,500	222,500
단기투자자산	893,670	-	893,670	-	893,670
매출채권(*1)	332,432	-	332,432	-	332,432
장기투자자산	5,485,715	-	-	5,485,715	5,485,715
기타금융자산	237,504	-	237,504	-	237,504
소 계	7,171,821	-	1,463,606	5,708,215	7,171,821
공정가치로 측정되지 않는 금융자산:					
현금및현금성자산(*2)	7,122,306	-	-	-	-
단기금융상품(*2)	292,846	-	-	-	-
매출채권(*2)	5,182,865	-	-	-	-
기타수취채권(*2)	851,839	-	-	-	-
기타금융자산(*2)	706	-	-	-	-
소 계	13,450,562	-	-	-	-
금융자산 합계	20,622,383	-	1,463,606	5,708,215	7,171,821

공정가치로 측정되는 금융부채:					
기타금융부채	637,174	-	637,174	-	637,174
소 계	637,174	-	637,174	-	637,174
공정가치로 측정되지 않는 금융부채:					
매입채무(*2)	1,916,761	-	-	-	-
미지급금(*2)	6,102,978	-	-	-	-
기타지급채무(*2)	1,352,420	-	-	-	-
차입금	31,558,615	-	30,357,466	-	30,357,466
리스부채(*2)	3,023,818	-	-	-	-
기타금융부채(*2)	4,600	-	-	-	-
소 계	43,959,192	-	30,357,466	-	30,357,466
금융부채 합계	44,596,366	-	30,994,640	-	30,994,640

(*1) 연결회사는 특정 거래처에 대한 일부 매출채권을 양도하고 위험과 보상의 대부분을 이전하여 매출채권을 양도일에 연결재무제표에서 제거하고 매출채권처분손익을 인식하고 있습니다.

(*2) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치를 측정하지 않은금융자산과 금융부채에 대한 공정가치는 포함하고 있지 않습니다.

② 전기말

(단위: 백만원)					
구 분	장부금액	수준 1	수준 2	수준 3	합 계
공정가치로 측정되는 금융자산:					
단기금융상품	222,500	-	-	222,500	222,500
단기투자자산	1,016,360	-	1,016,360	-	1,016,360
매출채권(*1)	207,072	-	207,072	-	207,072
장기투자자산	5,733,544	-	-	5,733,544	5,733,544
기타금융자산	115,017	-	115,017	-	115,017
소 계	7,294,493	-	1,338,449	5,956,044	7,294,493
공정가치로 측정되지 않는 금융자산:					
현금및현금성자산(*2)	4,977,007	-	-	-	-
단기금융상품(*2)	193,125	-	-	-	-
매출채권(*2)	4,978,982	-	-	-	-
기타수취채권(*2)	626,679	-	-	-	-
기타금융자산(*2)	695	-	-	-	-
소 계	10,776,488	-	-	-	-
금융자산 합계	18,070,981	-	1,338,449	5,956,044	7,294,493
공정가치로 측정되지 않는 금융부채:					
매입채무(*2)	2,186,230	-	-	-	-
미지급금(*2)	8,403,994	-	-	-	-
기타지급채무(*2)	1,415,197	-	-	-	-
차입금	22,994,604	-	21,809,209	-	21,809,209
리스부채(*2)	1,797,081	-	-	-	-
기타금융부채(*2)	4,876	-	-	-	-

금융부채 합계	36,801,982	-	21,809,209	-	21,809,209
---------	------------	---	------------	---	------------

(*1) 연결회사는 특정 거래처에 대한 일부 매출채권을 양도하고 위험과 보상의 대부분을 이전하여 매출채권을 양도일에 연결재무제표에서 제거하고 매출채권처분손익을 인식하고 있습니다.

(*2) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치를 측정하지 않은금융자산과 금융부채에 대한 공정가치는 포함하고 있지 않습니다.

③ 가치평가기법

수준 2 및 수준 3의 공정가치 측정을 위해 사용된 평가기법은 전기말과 동일합니다.

④ 당분기 중 수준 1, 수준 2 및 수준 3간의 대체는 없으며, 수준 3 공정가치 측정으로 분류되는 금융자산의 당분기 중 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)						
구 분	기 초	취 득	처 분	평 가	환율변동	분기말
단기금융상품	222,500	-	-	-	-	222,500
장기투자자산	5,733,544	30,149	(3,101)	(741)	(274,136)	5,485,715

7. 매출채권 및 기타수취채권

(1) 당분기말과 전기말 현재 기타수취채권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
유 동:		
미수금	282,752	194,516
미수수익	9,644	5,352
단기대여금	15,770	14,265
단기보증금	54,716	58,379
소 계	362,882	272,512
비유동:		
장기미수금	3	3
장기대여금	274,287	280,639
보증금	214,413	73,286
기타	254	239
소 계	488,957	354,167
합 계	851,839	626,679

(2) 대손충당금의 내역

당분기말과 전기말 현재 대손충당금 차감전 총액 기준에 의한 매출채권 및 기타수취채권과 관련 대손충당금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)						
구 분	당분기말			전기말		
	채권액	대손충당금	장부금액	채권액	대손충당금	장부금액
매출채권	5,523,874	(8,577)	5,515,297	5,187,164	(1,110)	5,186,054
유동성 기타수취채권	364,195	(1,313)	362,882	273,825	(1,313)	272,512
비유동성 기타수취채권	490,077	(1,120)	488,957	355,228	(1,061)	354,167
합 계	6,378,146	(11,010)	6,367,136	5,816,217	(3,484)	5,812,733

8. 재고자산

당분기말과 전기말 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)						
구 분	당분기말			전기말		
	취득원가	평가손실충당금	장부금액	취득원가	평가손실충당금	장부금액
상 품	3,672	(183)	3,489	3,539	(138)	3,401
제 품	5,142,176	(1,229,230)	3,912,946	4,651,604	(812,889)	3,838,715
재공품	10,034,958	(1,492,011)	8,542,947	9,433,873	(339,721)	9,094,152
원재료	1,726,984	(107,252)	1,619,732	1,936,321	(118,945)	1,817,376
저장품	837,281	(80,042)	757,239	849,480	(63,655)	785,825
미착품	111,542	-	111,542	125,238	-	125,238
합 계	17,856,613	(2,908,718)	14,947,895	17,000,055	(1,335,348)	15,664,707

9. 기타유동자산 및 기타비유동자산

당분기말과 전기말 현재 기타유동자산 및 기타비유동자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
유 동:		
선급금	54,397	56,616
선급비용	276,464	241,894
부가세대급금	373,229	795,879
계약자산	98,281	91,905
기타	74,613	250
소 계	876,984	1,186,544
비유동:		
장기선급금	138,369	22,683
장기선급비용	32,946	42,745
기타	30,214	6,273
소 계	201,529	71,701

합 계	1,078,513	1,258,245
-----	-----------	-----------

10. 관계기업 및 공동기업투자

(1) 당분기말과 전기말 현재 관계기업 및 공동기업투자의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)								
구 분	회사명	소재지	주요 영업활동	당분기말			전기말	
				지분율(%)	순자산 지분금액	장부금액	지분율(%)	장부금액
관계기업 및 공동기업	SK China Company Limited(*1)	중국	컨설팅 및 투자	11.87	367,865	420,462	11.87	399,116
	SK South East Asia Investment Pte. Ltd.	싱가포르	컨설팅 및 투자	20.00	377,691	377,691	20.00	352,411
	매그너스사모투자합자회사(*3)	국내	투자	-	-	-	49.76	2,983
	HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.(*2)	중국	반도체 부품 제조	45.00	138,591	140,754	45.00	134,228
	Hystars Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.(*2)	중국	파운드리사업	50.10	222,403	223,994	50.10	220,281
	기타				217,660	253,594		243,826
합 계					1,324,210	1,416,495		1,352,845

(*1) 이사회 등 참여를 통해 유의적인 영향력을 행사할 수 있으므로 관계기업으로 분류하였습니다.

(*2) 계약에 의해 중요사항에 대해 만장일치로 의결되도록 규정되어 있어 공동기업으로 분류하였습니다.

(*3) 당분기 중 청산이 완료되었습니다.

(2) 당분기와 전분기 중 관계기업 및 공동기업투자의 변동내역은 다음과 같습니다.

① 당분기

(단위: 백만원)							
구 분	기 초	취 득	처 분	지분법손익	지분법자본변동	배 당	분기말
SK China Company Limited	399,116	-	-	7,664	13,682	-	420,462
SK South East Asia Investment Pte. Ltd.	352,411	-	-	1,813	23,467	-	377,691
매그너스사모투자합자회사	2,983	-	-	(2,721)	-	(262)	-
HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.	134,228	-	-	14,170	8,219	(15,863)	140,754
Hystars Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.	220,281	-	-	303	3,410	-	223,994
기타	243,826	21,849	(8,847)	(2,371)	4,777	(5,640)	253,594
합 계	1,352,845	21,849	(8,847)	18,858	53,555	(21,765)	1,416,495

② 전분기

(단위: 백만원)							
구 분	기 초	취 득	처 분	지분법손익	지분법자본변동	배 당	분기말
SK China Company Limited	343,987	-	-	616	84,441	-	429,044
SK South East Asia Investment Pte. Ltd.	347,317	-	-	(292)	67,648	-	414,673
우시시산파직접회로산업원유한공사	33,288	1,128	-	(132)	2,461	-	36,745
매그너스사모투자합자회사	183,760	-	(201,228)	99,056	-	-	81,588
SiFive Inc.	43,499	-	-	1,911	4,795	-	50,205
HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.	123,864	-	-	15,288	26,022	(17,383)	147,791

Hystars Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.	226,773	-	-	(158)	16,193	-	242,808
기타	107,940	34,019	(226)	2,956	5,173	(1,085)	148,777
합 계	1,410,428	35,147	(201,454)	119,245	206,733	(18,468)	1,551,631

(3) 당분기말과 전기말 현재 주요 관계기업과 공동기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다.

① 당분기말

(단위: 백만원)				
구 분	유동자산	비유동자산	유동부채	비유동부채
SK China Company Limited	1,343,461	2,072,888	316,212	-
SK South East Asia Investment Pte. Ltd.	253,003	3,141,070	533,302	14,886
HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.	377,997	360,221	202,259	227,979
Hystars Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.	199,034	505,022	12,745	247,392

② 전기말

(단위: 백만원)				
구 분	유동자산	비유동자산	유동부채	비유동부채
SK China Company Limited	1,223,426	2,050,002	353,179	-
SK South East Asia Investment Pte. Ltd.	145,399	3,024,694	487,762	-
매그너스사모투자합자회사	3,014	-	31	-
HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.	252,162	369,578	119,652	203,569
Hystars Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.	175,833	526,041	14,939	250,428

(4) 당분기와 전분기 중 주요 관계기업과 공동기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)				
구 분	당분기		전분기	
	매출액	분기순손익	매출액	분기순손익
SK China Company Limited	34,663	64,589	16,370	5,195
SK South East Asia Investment Pte. Ltd.	51,992	9,064	52,806	(1,460)
매그너스사모투자합자회사	-	(2,721)	154,892	99,056
HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.	548,586	26,446	555,445	30,432
Hystars Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.	26,165	604	46,386	(316)

11. 유형자산

(1) 당분기와 전분기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
기초장부금액	60,228,528	53,225,667
취득	4,197,815	14,543,358
사업결합으로 인한 증가	-	343,923
손상	-	(7,691)
처분 및 폐기	(1,282,110)	(157,133)
대체	(2,894)	(12,662)
감가상각	(9,726,460)	(9,567,757)
환율변동	602,085	2,237,685
기말장부금액	54,016,964	60,605,390

(2) 당분기말 현재 연결회사의 일부 기계장치 등은 차입금과 관련하여 담보로 제공되어 있습니다(주석 30 참조).

12. 리스

(1) 당분기와 전분기 중 사용권자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
기초장부금액	1,779,985	1,597,344
증가	1,150,454	351,878
종료	-	(19,446)
감가상각	(266,464)	(243,009)
환율변동	19,927	71,488
기말장부금액	2,683,902	1,758,255

(2) 당분기와 전분기 중 리스부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
기초장부금액	1,797,081	1,525,762
증가	1,442,637	378,199
이자비용	43,780	27,540
지급	(295,782)	(201,056)
환율변동	36,710	93,807
기타	(608)	(19,446)
기말장부금액	3,023,818	1,804,806

13. 무형자산

당분기와 전분기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
기초장부금액	3,512,107	4,797,162
취득	623,177	599,098
사업결합으로 인한 증가	-	197,186
처분 및 폐기	(6,756)	(4,084)
상각	(429,812)	(622,465)
손상차손 및 환입	(167,050)	(50,107)
대체	(898)	(26,896)
기타(*)	21,133	354,692
기말장부금액	3,551,901	5,244,586

(*) 기타는 환율변동에 의한 증감액 등을 포함하고 있습니다.

14. 투자부동산

(1) 당분기와 전분기 중 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
기초장부금액	223	164,197
감가상각	(9)	(1,011)
처분	-	(161,926)
기말장부금액	214	1,260

(2) 당분기 중 발생한 투자부동산의 감가상각비 9백만원(전분기: 1,011백만원)은 전액 매출 원가에 포함되어 있습니다.

(3) 당분기 중 투자부동산과 관련하여 발생한 임대수익은 7백만원(전분기: 11,162백만원)입니다.

15. 차입금

당분기말과 전기말 현재 차입금 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
유 동:		
단기차입금	5,149,635	3,833,263
유동성장기차입금	2,273,147	2,620,180
유동성사채(*)	3,807,096	969,804
소 계	11,229,878	7,423,247
비유동:		
장기차입금	10,578,787	9,073,567
사채	9,749,950	6,497,790
소 계	20,328,737	15,571,357
합 계	31,558,615	22,994,604

(*) 당분기 중 연결회사가 발행한 교환사채를 포함하고 있으며, 교환사채의 만기는 2030년이나 교환권의 행사가능성으로 인해 유동성사채로 분류하였습니다. 동 교환사채의 발행조건은 다음과 같습니다.

구 분		내 역
1. 사채의 종류		외화 해외교환사채
2. 사채의 권면총액		USD 1,700,000,000
3. 사채의 이율	표면이자율	1.75%
	만기이자율	1.75%
4. 만기일		2030년 04월 11일
5. 원금상환방법		1) 만기상환 : 만기까지 교환권 및 조기상환권의 미행사 에 따른 잔존 사채원리금에 대해 만기 일시상환
		2) 조기상환 : 회사의 조기상환권(Call Option) 및 사채권 자의 조기상환권(Put Option) 존재
6. 교환에 관한사항	교환비율	사채원금의 100%
	교환가액	111,180원
	교환대상	SK하이닉스 주식회사 발행 기명식 보통 주식(자기주식)
	교환청구기간	2023년 5월 22일 ~ 2030년 4월 1일
	교환가액 조정사항	무상증자, 주식분할, 주식병합, 주식의 종류 변경, 주주 에 대한 옵션 또는 워런트의 추가발행, 주식배당, 현금배 당, 기타 자산의 배당, 시가 미만의 신주발행 등과 같은 교환가액 조정사유 발생시 사채조건에서 정한 바에 따라 조정
7. 투자자의 조기상환권(Put Option)		- 납일일로부터 4년 (2027. 04. 11)이 되는 날
		- 당사의 지배권 변동(Change of Control)이 발생하는 경우
		- 당사 발행주식이 상장폐지되거나 20 연속 거래일 이상

	거래정지되는 경우
8. 발행자의 조기상환권(Call Option)	- 2028년 4월 25일 부터 사채만기일 30 영업일 전까지 30 연속거래일 중 20 거래일의 종가가 교환가격의 130% 이상인 경우
	- 미상환사채잔액이 총 발행총액의 10% 미만인 경우 (Clean Up Call)
	- 관련 법령의 개정 등으로 인한 추가 조세부담사유가 발생하는 경우

16. 기타유동부채 및 기타비유동부채

당분기말과 전기말 현재 기타유동부채 및 기타비유동부채의 내역은 다음과 같습니다

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
유 동:		
선수금	441,793	18,433
선수수익	3,504	8,070
예수금	207,554	150,304
계약부채	256,532	345,657
기타	26,972	11,871
소 계	936,355	534,335
비유동:		
기타장기종업원급여부채	186,827	182,425
기타	66,624	22,419
소 계	253,451	204,844
합 계	1,189,806	739,179

17. 충당부채

(1) 당분기와 전분기 중 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

① 당분기

(단위: 백만원)					
구 분	기 초	전 입	사 용	환 입	분기말
판매보증충당부채	249,316	136,599	(123,303)	-	262,612
배출부채	2,150	-	(1,827)	(322)	1
복구충당부채	1,827	-	-	-	1,827
합 계	253,293	136,599	(125,130)	(322)	264,440

② 전분기

(단위: 백만원)					
구 분	기 초	전 입	사 용	환 입	분기말
판매보증충당부채	3,327	485,203	(2,979)	-	485,551
배출부채	6,840	5,307	-	(8,790)	3,357
합 계	10,167	490,510	(2,979)	(8,790)	488,908

(2) 판매보증충당부채

연결회사는 무상 품질보증수리 등과 관련하여 장래에 지출될 것이 예상되는 금액을 과거 경험율 등을 기초로 추정하여 충당부채를 인식하고 있으며, 과거 특정 제품의 품질 저하 현상과 관련하여 제품 교환 등 연결회사가 부담할 것으로 예상되는 금액을 별도로 추정하여 충당부채로 계상하고 있습니다.

(3) 배출부채

연결회사는 '온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률'에 따라 장래에 지출될 것이 예상되는 금액을 추정하여 충당부채로 인식하고 있습니다.

① 당분기말 현재 당기 이행연도에 대한 무상할당 배출권과 온실가스 배출량 추정치는 다음과 같습니다.

(단위: 만tCO ₂ -eq)	
구 분	당분기말
무상할당 배출권	584
배출량 추정치	569

② 당분기 중 배출권 증감 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 만tCO ₂ -eq)	
구 분	2022년도분
기초	9
무상할당	514
매입	17
정부제출	(540)
차입	-
이월	-
매각	-
기말	-

18. 종업원급여

(1) 당분기말과 전기말 현재 확정급여부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
확정급여채무의 현재가치	2,448,518	2,259,125
사외적립자산의 공정가치	(3,689,951)	(3,521,426)
순확정급여부채	(1,241,433)	(1,262,301)
확정급여부채	76,702	69,952
확정급여자산(*)	1,318,135	1,332,253

(*) 당분기말과 전기말 현재 지배회사 및 일부 종속기업들의 확정급여제도의 초과적립액 1,318,135백만원과 1,332,253백만원을 종업원급여자산으로 표시하였습니다.

(2) 당분기와 전분기 중 확정급여채무의 현재가치 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
기초장부금액	2,259,125	2,392,020
당기근무원가	171,935	199,836
이자원가	100,625	70,057
관계사전출입액	13,014	75
퇴직급여지급액	(96,232)	(74,220)
사업결합으로 인한 증가	-	154,948
기타	51	109
기말장부금액	2,448,518	2,742,825

(3) 당분기와 전분기 중 사외적립자산의 공정가치 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
기초장부금액	3,521,426	2,819,782
기여금납입액	133,009	60,314
이자수익	162,240	82,151
관계사전출입액	11,796	815
퇴직급여지급액	(116,044)	(87,073)
재측정요소	(22,471)	(36,758)
사업결합으로 인한 증가	-	45,310
기타	(5)	95
기말장부금액	3,689,951	2,884,636

(4) 당분기와 전분기 중 확정급여제도와 관련하여 손익으로 인식된 비용은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)				
구 분	당분기		전분기	
	3개월	누 적	3개월	누 적
당기근무원가	57,288	171,935	67,809	199,836
순이자원가	(20,544)	(61,615)	(3,505)	(12,094)
합 계	36,744	110,320	64,304	187,742

(5) 당분기 중 확정기여형 연금제도와 관련하여 비용으로 인식한 금액은 7,502백만원(전분기: 4,684백만원)입니다.

19. 파생상품거래

(1) 통화스왑 및 이자율 스왑

① 당분기말 현재 현금흐름위험회피회계를 적용한 통화스왑 및 이자율스왑 거래내역은 다음과 같습니다.

(원화단위: 백만원, 외화단위: 외화 천단위)					
위험회피대상			위험회피수단		
차입일	대상항목	대상위험	계약종류	채결기관	계약기간
2019.09.17	고정금리외화사채 (액면금액 USD 500,000)	환율변동위험	통화스왑계약	국민은행 등 2개은행	2019.09.17 ~ 2024.09.17
2019.10.02	변동금리시설대출 (액면금액 USD 406,250)	환율변동위험 및 이자율위험	통화이자율스왑계약	산업은행	2019.10.02 ~ 2026.10.02
2023.01.17	고정금리외화사채 (액면금액 USD 750,000)	환율변동위험	통화스왑계약	국민은행 등 4개은행	2023.01.17 ~ 2026.01.17
2023.04.04	변동금리시설대출 (액면금액 KRW 100,000)	이자율위험	이자율스왑계약	우리은행	2023.04.04 ~ 2028.04.04

② 연결회사가 보유하고 있는 파생금융자산의 당분기말 공정가치는 연결재무상태표의 기타 금융자산 계정으로 계상되어 있으며, 그 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위: 백만원, 외화단위: 외화 천단위)			
구분	위험회피대상항목	현금흐름위험회피 회계적용	공정가치
통화스왑	고정금리외화사채 (액면금액 USD 1,250,000)	147,275	147,275
통화이자율스왑	변동금리시설대출 (액면금액 USD 406,250)	88,607	88,607
이자율스왑	변동금리시설대출 (액면금액 KRW 100,000)	1,622	1,622
파생금융자산 합계			237,504

당분기말 현재 위험회피수단으로 지정된 파생상품의 공정가치 변동은 모두 위험회피에 효과적이므로 전액 기타포괄손익으로 인식하였습니다.

(2) 내재파생상품

연결회사가 보유하고 있는 파생금융부채의 당분기말 공정가치는 연결재무상태표의 기타금융부채 계정으로 계상되어 있으며, 그 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)			
파생금융부채	당분기말	전기말	공정가치
내재파생상품(*)	637,174	-	637,174

(*) 연결회사가 2023년 4월 11일 발행한 교환사채에 부여된 교환권 및 콜옵션, 풋옵션입니다(주석 15 참조).

20. 자본금, 자본잉여금 및 기타자본

(1) 당분기말 현재 지배기업의 수권주식수는 9,000,000천주이고, 1주당 액면금액은 5,000원입니다. 한편, 당분기말과 전기말 현재 보통주 발행주식수, 보통주자본금, 자본잉여금 및 기타자본의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원, 천주)		
구 분	당분기말	전기말
보통주 발행주식수(*1)	731,530	731,530
보통주자본금	3,657,652	3,657,652
자본잉여금:		
주식발행초과금	3,625,797	3,625,797
기타	720,320	710,373
합 계	4,346,117	4,336,170
기타자본:		
자기주식(*2)	(2,273,870)	(2,300,387)
주식선택권	7,032	8,011
기타	(19,030)	(19,033)
합 계	(2,285,868)	(2,311,409)
자기주식수	39,886	40,351

(*1) 당분기말 현재 과거 이익소각의 영향으로 인하여 상장주식 총수 728,002천주와발행주식 총수에 차이가 있습니다.

(*2) 당분기 중 연결회사는 자기주식 465,149주를 처분하여 자기주식처분이익 12,414백만원이 발생하였습니다.

(2) 당분기말 및 전기말 현재 지배기업의 유통주식수는 다음과 같습니다.

(단위: 주)						
구 분	당분기말			전기말		
	상장주식수	자기주식	유통주식수	상장주식수	자기주식	유통주식수
상장주식수	728,002,365	39,886,176	688,116,189	728,002,365	40,351,325	687,651,040

21. 이익잉여금

당분기말과 전기말 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
법정적립금(*1)	618,395	535,877
임의적립금(*2)	235,506	235,506
미처분이익잉여금(*3)	47,433,879	55,913,877
합 계	48,287,780	56,685,260

(*1) 지배기업은 상법의 규정에 따라, 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 현금에 의한 이익배당금의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하고 있습니다. 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전에 사용가능합니다.

(*2) 임의적립금은 기술개발준비금으로 구성되어 있습니다.

(*3) 2023년 3월 29일자 주주총회에서 결의된 배당금 206,295백만원, 2023년 4월 19일 이사회에서 결의된 배당금 206,418백만원 및 2023년 7월 26일 이사회에서 결의된 배당금 206,427백만원이 전액 지급되었습니다.

22. 매출액

(1) 당분기와 전분기 중 매출액의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)				
구 분	당분기		전분기	
	3개월	누 적	3개월	누 적
제품 등의 판매	9,047,470	21,398,556	10,962,408	36,891,298
용역의 제공	18,701	61,658	20,475	58,239
합 계	9,066,171	21,460,214	10,982,883	36,949,537

(2) 당분기와 전분기 중 매출액의 품목별 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)				
구 분	당분기		전분기	
	3개월	누 적	3개월	누 적
DRAM	6,085,615	13,418,439	6,954,326	23,593,637
NAND Flash	2,426,210	6,354,455	3,388,185	11,819,440
기타	554,346	1,687,320	640,372	1,536,460
합 계	9,066,171	21,460,214	10,982,883	36,949,537

(3) 당분기와 전분기 중 지역별(법인소재지 기준) 매출액의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)				
구 분	당분기		전분기	
	3개월	누 적	3개월	누 적
국 내	600,930	1,462,284	397,823	944,350
미 국	4,268,604	9,735,746	6,167,748	19,248,419
중 국	2,738,825	6,621,007	2,753,335	10,778,218
아시아(국내 및 중국 제외)	1,228,031	3,059,423	1,219,391	4,689,194
유 럽	229,781	581,754	444,586	1,289,356
합 계	9,066,171	21,460,214	10,982,883	36,949,537

(4) 당분기와 전분기 중 매출액의 수익인식시기에 대한 구분내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)				
구 분	당분기		전분기	
	3개월	누 적	3개월	누 적
한 시점에 이행	9,047,470	21,398,556	10,962,408	36,891,298
기간에 걸쳐 이행	18,701	61,658	20,475	58,239
합 계	9,066,171	21,460,214	10,982,883	36,949,537

23. 판매비와관리비

당분기와 전분기 중 발생한 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)				
구 분	당분기		전분기	
	3개월	누 적	3개월	누 적
급여	212,738	613,578	278,882	849,738
퇴직급여	9,199	27,542	12,265	35,437
복리후생비	46,012	160,469	58,789	160,525
지급수수료	179,224	563,626	266,465	761,350
감가상각비	78,834	224,853	66,386	193,048
무형자산상각비	84,373	225,143	85,884	354,175
세금과공과	19,956	66,061	27,863	77,511
광고선전비	25,914	56,756	29,689	75,334
소모품비	33,992	80,706	30,683	85,321
판매촉진비	28,218	82,197	43,677	150,130
품질관리비	79,250	140,553	76,406	493,944
기타	85,246	292,468	113,014	282,823
소 계	882,956	2,533,952	1,090,003	3,519,336
경상개발비:				
연구개발비 총지출액	1,025,682	3,069,433	1,204,215	3,562,639
개발비 자산화	(52,551)	(286,039)	(89,161)	(199,184)
소 계	973,131	2,783,394	1,115,054	3,363,455
합 계	1,856,087	5,317,346	2,205,057	6,882,791

24. 비용의 성격별 분류

당분기와 전분기 중 발생한 비용의 성격별 분류는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)				
구 분	당분기		전분기	
	3개월	누 적	3개월	누 적
제품 및 재공품의 변동	1,335,555	476,974	(2,326,809)	(4,845,153)
원재료, 저장품 및 소모품 사용	2,946,668	7,461,391	2,962,291	8,186,038
종업원급여	1,347,538	3,995,919	1,771,295	5,368,988
감가상각 및 무형자산 상각	3,332,583	10,383,053	3,552,718	10,422,676
지급수수료	783,691	2,452,631	958,353	2,663,187
동력 및 수도광열비	632,675	1,926,015	573,335	1,563,768
수선비	291,641	868,319	401,858	1,151,774
외주가공비	378,229	1,049,251	448,853	1,240,890
기타	(152,060)	1,199,721	1,076,190	2,694,600
대체: 개발비자산화 등	(38,389)	(276,713)	(95,724)	(218,877)
합 계(*)	10,858,131	29,536,561	9,322,360	28,227,891

(*) 분기연결포괄손익계산서 상의 매출원가와 판매비와관리비를 합산한 금액입니다.

25. 금융수익 및 금융비용

당분기와 전분기 중 금융수익 및 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)				
구 분	당분기		전분기	
	3개월	누 적	3개월	누 적
금융수익:				
이자수익	59,866	150,228	27,383	44,424
배당금수익	4,696	10,587	171	1,277
외환차이	585,064	1,951,588	2,044,908	4,079,679
기타	18,604	76,162	23,167	53,509
합 계	668,230	2,188,565	2,095,629	4,178,889
금융비용:				
이자비용	397,100	1,068,155	148,733	332,288
외환차이(*)	744,550	2,528,206	1,912,242	4,275,307
파생상품거래손실	-	58,985	-	-
기타	3	719	3,190	8,293
합 계	1,141,653	3,656,065	2,064,165	4,615,888
순금융수익	(473,423)	(1,467,500)	31,464	(436,999)

(*) 당분기 중 발생한 장기투자자산의 환율변동효과 282,667백만원(전분기: 227,494백만원)이 포함되어 있습니다.

26. 기타영업외수익과 기타영업외비용

(1) 당분기와 전분기 중 기타영업외수익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)				
구 분	당분기		전분기	
	3개월	누 적	3개월	누 적
유형자산처분이익	216,912	222,488	19,927	126,144
투자부동산처분이익	-	-	-	64,418
기타	17,245	37,770	10,170	23,687
합 계	234,157	260,258	30,097	214,249

(2) 당분기와 전분기 중 기타영업외비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)				
구 분	당분기		전분기	
	3개월	누 적	3개월	누 적
무형자산손상차손	167,050	167,050	24,621	50,272
유형자산처분손실	64,146	66,842	471	3,830
기부금	6,731	41,630	16,763	57,293
매출채권처분손실	4,316	10,534	4,253	8,366
기타	202,198	232,260	14,293	60,304
합 계	444,441	518,316	60,401	180,065

27. 법인세비용

법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 경영진의 가중평균연간법인세율에 대한 최선의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 법인세비용에는 과거기간 당기법인세에 대하여 당분기에 인식한 조정사항이 포함되어 있습니다.

28. 주당이익

주당이익은 보통주 및 희석성 잠재적 보통주 1주에 대한 지배기업 소유주지분순이익을 계산한 것으로 그 내역은 다음과 같습니다.

(1) 기본주당이익

(단위: 주, 백만원)				
구 분	당분기		전분기	
	3개월	누 적	3개월	누 적
지배기업소유주지분 분기순이익(손실)	(2,183,733)	(7,755,323)	1,111,705	5,970,978
가중평균유통보통주식수(*)	688,106,870	688,024,496	687,651,040	687,644,127
기본주당이익(손실)	(3,174) 원	(11,272) 원	1,617 원	8,683 원

(*) 주당이익을 계산하기 위한 가중평균유통보통주식수의 산출근거는 다음과 같습니다.

(단위: 주)				
구 분	당분기		전분기	
	3개월	누 적	3개월	누 적
발행주식수	728,002,365	728,002,365	728,002,365	728,002,365
자기주식 효과	(39,895,495)	(39,977,869)	(40,351,325)	(40,358,238)
가중평균유통보통주식수	688,106,870	688,024,496	687,651,040	687,644,127

(2) 희석주당이익

(단위: 백만원, 주)				
구 분	당분기		전분기	
	3개월	누 적	3개월	누 적
보통주희석분기순이익(손실)	(2,183,733)	(7,755,323)	1,111,705	5,970,978
가중평균희석유통보통주식수(*)	688,106,870	688,024,496	687,770,455	687,805,980
희석주당이익(손실)	(3,174) 원	(11,272) 원	1,616 원	8,681 원

(*) 희석주당이익을 계산하기 위한 가중평균희석유통보통주식수의 산출근거는 다음과 같습니다.

(단위: 주)				
구 분	당분기		전분기	
	3개월	누 적	3개월	누 적
가중평균유통보통주식수	688,106,870	688,024,496	687,651,040	687,644,127
주식선택권 효과	-	-	119,415	161,853
가중평균희석유통보통주식수	688,106,870	688,024,496	687,770,455	687,805,980

29. 특수관계자 및 대규모기업집단 소속회사와 거래

(1) 당분기말 현재 특수관계자의 내역은 다음과 같습니다.

구 분	회사명
관계기업(*)	Stratio, Inc., SK China Company Limited, Gemini Partners Pte. Ltd., TCL Fund, SK South East Asia Investment Pte. Ltd., Hushan Xindu (Chengdu) Venture Investment Center(Smartsources) 농업회사법인 푸르메소셜팜㈜, 우시시신파직접회로산업원유한공사, 미래에셋위반도체 제1호창업벤처전문사모투자합 작회사 엘엔에스 10호 Early Stage III 투자조합, SiFive Inc., YD-SK-KDB 소셜밸류 Ningbo Zhongxin Venture Capital Partnership (Limited Partnership), 강소KVTS반도체과학기술유한회사, SAPEON INC.
공동기업	HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd., Hystars Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd. 반도체성장 전문투자형 사모투자신탁, 시스템반도체 상생 전문투자형 사모투자신탁, 반도체 생태계 일반 사모 투자신탁
기타특수관계자	연결회사에 유의적인 영향력을 행사하는 SK스퀘어㈜ 및 그 종속기업과 SK스퀘어㈜의 지배기업인 SK㈜와 그 종속기업

(*) 당분기 중 매그너스사모투자합자회사의 청산절차가 최종 완료되어 제외되었습니다.

(2) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 주요거래 내역은 다음과 같습니다.

① 당분기

(단위: 백만원)							
구 분	회사명	매출 등		매입 등		자산취득	
		3개월	누 적	3개월	누 적	3개월	누 적
관계기업	SK China Company Limited	13	32	3,804	9,741	-	-
	농업회사법인 푸르메소셜팜㈜	-	-	28	84	-	-
공동기업	HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.	1,812	5,034	166,159	495,551	22,149	81,896
	Hystars Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.	-	47	7,445	19,954	-	-
기타특수관계자	SK텔레콤㈜	19,828	49,461	12,007	37,559	4,760	4,827
	SK㈜(*)	4,727	14,615	68,741	213,390	20,184	24,426
	ESSENCECORE Limited	123,516	448,256	-	-	-	-
	SK에코플랜트㈜	8,725	24,672	170	170	131,385	190,167
	SK에너지㈜	15,403	44,342	17,305	111,941	-	18,700
	SK네트웍스㈜	1,734	4,679	1,558	6,375	233	837
	에스케이엔펠스㈜(구, 에스케이솔루션스㈜)	224	790	27,479	101,520	-	28
	충청에너지서비스㈜	3	3	5,762	42,860	-	-
	SK스페셜티㈜(구, SK머티리얼즈㈜)	1,015	3,638	33,099	105,571	-	-
	SK실트론㈜	8,034	26,847	102,271	325,958	-	-
	SK머티리얼즈 에어플러스㈜	107	207	18,256	45,073	-	88,105
	Techdream Co., Ltd.	-	-	28,257	94,507	-	-
	SK트리캠㈜	220	666	23,399	108,437	-	-
	SK쉴더스	1,306	2,798	28,756	73,717	4,030	4,576

	SK이노베이션주	5,505	13,751	14,298	56,346	-	35
	SK스퀘어주	8	26	-	-	-	-
	에스케이위탁관리부동산투자회사주	-	-	2,253	5,430	-	-
	인더스트리얼위탁관리부동산투자회사 주식회사	1,120,315	1,120,315	-	-	-	-
	에프에스케이엘앤에스 주식회사	17	47	10,051	35,039	217	1,690
	SK E&S주	78	144	3,960	12,142	128	1,217
	SK LNG Trading Pte., Ltd.	-	-	88,341	179,172	-	14,143
	기타	64,252	170,996	55,090	166,061	98,086	110,352
	합 계	1,376,842	1,931,366	718,489	2,246,598	281,172	540,999

(*) 당분기 중 발생한 SK브랜드 사용료가 포함되어 있습니다.

② 전분기

(단위: 백만원)							
구 분	회사명	매출 등		매입 등		자산취득	
		3개월	누 적	3개월	누 적	3개월	누 적
관계기업	SK China Company Limited	10	25	4,285	9,194	-	-
	푸르메소셜팜(주)	-	-	9	31	-	-
공동기업	HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.	622	1,769	173,617	495,359	7,824	15,643
	Hystars Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.	55	175	10,023	26,568	-	-
기타특수관계자	SK텔레콤(주)	17,178	60,840	11,328	26,654	5,324	8,951
	SK(주)(*)	5,980	16,146	93,041	263,590	24,815	114,900
	ESSENCORE Limited	185,127	503,927	-	-	-	-
	SK에코플랜트(주)	9,068	30,185	8	8	428,621	1,332,590
	SK에코엔지니어링(주)	-	-	-	-	22,977	111,215
	SK에너지(주)	15,162	37,737	24,085	97,059	-	-
	SK네트웍스(주)	1,531	4,752	2,893	6,964	79	260
	에스케이씨솔믹스(주)	318	1,007	39,244	113,975	85	537
	충청에너지서비스(주)	-	13	6,757	36,527	9	9
	SK머티리얼즈(주)	42	2,261	53,317	143,504	-	-
	SK실트론(주)	11,112	30,981	136,529	332,674	-	-
	SK머티리얼즈 에어플러스(주)	147	654	34,682	98,948	-	5,751
	Techdream Co., Ltd.	-	-	62,330	151,544	-	-
	SK트리켄(주)	425	978	62,434	157,953	-	-
	SK쉴더스	1,546	3,797	23,002	74,238	4,352	7,587
	SK이노베이션(주)	5,197	12,621	15,307	58,760	-	36
	SK스퀘어(주)	-	461	-	-	-	-
	에스케이위탁관리부동산투자회사(주)	-	507,200	1,763	1,763	-	113,377
	에프에스케이엘앤에스 주식회사	22	42	28,904	97,426	10,730	51,213
	기타	41,316	126,228	63,876	174,405	7,321	48,479
합 계		294,858	1,341,799	847,434	2,367,144	512,137	1,810,548

(*) 전분기 중 발생한 SK브랜드 사용료가 포함되어 있습니다.

(3) 당분기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권·채무 내역은 다음과 같습니다.

① 당분기말

(단위: 백만원)			
구 분	회사명	채 권	채 무
		매출채권 등	미지급금 등
관계기업	SK China Company Limited	-	10,335
	농업회사법인 푸르메소셜팜(주)	-	9
공동기업	HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.	634	441,325
	Hystars Semiconductor(Wuxi) Co., Ltd.(*)	-	91,862
기타특수관계자	SK텔레콤(주)	460	10,348
	SK(주)	29,826	140,945
	ESSEN CORE Limited	23,735	-
	SK에코플랜트(주)	5,168	153,920
	SK에너지(주)	1,569	31,020
	SK네트웍스(주)	176	8,249
	에스케이엔펄스(주)(구, 에스케이씨솔믹스(주))	66	31,354
	충청에너지서비스(주)	3	1,798
	SK스페셜티(주)(구, SK머티리얼즈(주))	278	19,449
	SK실트론(주)	141,075	47,056
	SK머티리얼즈 에어플러스(주)	43	519,922
	Techdream Co., Ltd.	-	1,952
	SK트리켄(주)	202	13,242
	SK월더스	459	24,351
	SK이노베이션(주)	577	5,481
	SK스퀘어(주)	3	-
	에스케이위탁관리부동산투자회사(주)	17,330	166,323
	에프에스케이엘앤에스 주식회사	13	3,616
	SK E&S(주)	41,274	-
	SK LNG Trading Pte., Ltd.	-	45,929
	기타	33,298	156,366
합 계		296,189	1,924,852

(*) 미지급금 등에는 차입금 41,319 백만원이 포함되어 있습니다.

② 전기말

(단위: 백만원)			
구 분	회사명	채 권	채 무
		매출채권 등	미지급금 등
관계기업	SK China Company Limited	4	12,144
	농업회사법인 푸르메소셜팜(주)	-	6
공동기업	HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.	341	389,625
	Hystars Semiconductor(Wuxi) Co., Ltd.(*)	15	119,209
기타특수관계자	SK텔레콤(주)	30,681	15,840
	SK(주)	1,716	216,014
	ESSEN CORE Limited	30,587	-
	SK에코플랜트(주)	8,047	1,167,535
	SK에코엔지니어링(주)	-	166,191
	SK에너지(주)	2,560	41,114
	SK네트웍스(주)	674	10,292
	에스케이씨솔믹스(주)	183	40,299
	충청에너지서비스(주)	149	10,540
	SK스페셜티(주)(구, SK머티리얼즈(주))	597	19,560
	SK실트론(주)	4,299	47,185
	SK머티리얼즈 에어플러스(주)	71	457,182
	Techdream Co., Ltd.	-	8,556
	SK트리캄(주)	471	15,441
	SK쉴더스	602	43,261
	SK이노베이션(주)	857	7,217
	SK스퀘어(주)	690	1,175
	에스케이위탁관리부동산투자회사(주)	-	177,311
	에프에스케이엘앤에스 주식회사	2	9,430
	기타	43,959	59,757
합 계		126,505	3,034,884

(*) 미지급금 등에는 차입금 41,399백만원이 포함되어 있습니다.

(4) 주요 경영진에 대한 보상

연결회사는 기업활동의 계획·지휘·통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 등기이사를 주요 경영진으로 판단하였습니다. 당분기와 전분기 중 주요 경영진에 대한 보상금액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)				
구 분	당분기		전분기	
	3개월	누 적	3개월	누 적
급여	1,888	4,987	1,283	4,610
퇴직급여	100	368	75	336
주식보상비용	(6,202)	(970)	2,767	5,646
합 계	(4,214)	4,385	4,125	10,592

(5) 당분기와 전분기 중 기업회계기준서 제1024호 '특수관계자 공시'에 따른 특수관계자 범위에 포함되지 않으나, 독점규제 및 공정거래법에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사와의 주요 거래내역은 다음과 같습니다.

① 당분기

(단위: 백만원)							
구 분	회사명	매출 등		매입 등		자산취득	
		3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적
대규모기업집단소속회사	SK케미칼㈜	1,545	5,808	75	822	-	-
	SK바이오사이언스㈜	630	1,919	5	18	-	-
	㈜에이앤티에스	4	4	5,123	8,709	-	-
	에스엠코어㈜	4	10	200	2,435	705	2,737
	한국 벅슬렌 유한회사	1,249	3,460	-	-	-	-
	기타	377	1,136	-	-	-	-
합 계		3,809	12,337	5,403	11,984	705	2,737

② 전분기

(단위: 백만원)							
구 분	회사명	매출 등		매입 등		자산취득	
		3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적
대규모기업집단소속회사	SK케미칼㈜	2,081	6,615	354	1,045	-	-
	SK바이오사이언스㈜	783	2,174	3	9	-	-
	㈜에이앤티에스	2	6	7,924	7,924	-	-
	에스엠코어㈜	2	14	4,064	4,575	4,791	38,746
	한국 벅슬렌 유한회사	1,307	3,413	-	-	-	-
	기타	493	1,265	463	1,274	-	-
합 계		4,668	13,487	12,808	14,827	4,791	38,746

(6) 당분기말과 전기말 현재 기업회계기준서 제1024호 '특수관계자 공시'에 따른 특수관계자 범위에 포함되지 않으나, 독점규제 및 공정거래법에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사에 대한 채권·채무 내역은 다음과 같습니다.

① 당분기말

(단위: 백만원)			
구 분	회사명	채 권	채 무
		매출채권 등	미지급금 등
대규모기업집단소속회사	SK케미칼(주)	571	-
	SK바이오사이언스(주)	130	1
	(주)에이앤티에스	1	-
	에스엠코어(주)	2	353
	한국 벅슬렌 유한회사	204	-
	기타	79	-
합 계		987	354

② 전기말

(단위: 백만원)			
구 분	회사명	채 권	채 무
		매출채권 등	미지급금 등
대규모기업집단소속회사	SK케미칼(주)	871	69
	SK바이오사이언스(주)	264	-
	(주)에이앤티에스	2	1,082
	에스엠코어(주)	-	18,644
	한국 벅슬렌 유한회사	512	-
	기타	234	18
합 계		1,883	19,813

(7) 당분기 공동기업인 HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.와 체결한 리스계약에 따라 인식한 사용권자산과 리스부채는 각각 77,732백만원(전분기 : 14,040백만원) 및 77,732백만원(전분기 : 14,040백만원)이며, 당분기 중 공동기업인 HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.에게 지급한 리스료 상당액은 59,752백만원(전분기 : 65,541백만원)입니다. 당분기 중 SK머티리얼즈 에어플러스(주) 등 기타특수관계자와 체결한 리스계약에 따라 인식한 사용권자산과 리스부채는 각각 143,053백만원(전분기 : 149,039백만원) 및 143,053백만원(전분기 : 220,046백만원)이며, 당분기 중 SK머티리얼즈 에어플러스(주) 등 기타특수관계자에게 지급한 리스료는 65,446백만원(전분기 : 39,624백만원)입니다.

(8) 연결회사는 공동기업인 Hystars Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.를 위하여 Wuxi Xinfu Group Co., Ltd. 에게 RMB 701백만의 지급보증을 제공하고 있습니다.

(9) 연결회사의 당분기 중 종속기업 설립은 주석 1에 설명되어 있으며, 관계기업에 대한 취득 및 추가 출자 거래는 주석 10에 설명되어 있습니다.

(10) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 자금거래는 다음과 같습니다.

① 당분기

(단위: 백만원)			
구 분	특수관계자 구분	배당금수익	배당금지급
관계기업	매그너스사모투자합자회사	262	-
공동기업	HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.	15,863	-
	반도체성장 전문투자형 사모투자신탁	153	-
기타특수관계자	SK스퀘어(주)	-	87,660
합 계		16,278	87,660

② 전분기

(단위: 백만원)				
구 분	특수관계자 구분	차입금의 상황	배당금수익	배당금지급
공동기업	Hystars Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.	37,409	-	-
	HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.	-	17,383	-
기타특수관계자	SK스퀘어(주)	-	-	312,654
합 계		37,409	17,383	312,654

30. 우발부채와 약정사항

(1) 당분기말 현재 연결회사와 관련하여 계류 중인 중요한 소송사건 및 클레임 등의 내역은 다음과 같습니다.

① 북미지역 내 가격 담합 집단소송

2018년 4월 27일에 지배기업 및 지배기업의 종속기업인 SK hynix America Inc.를 상대로 주요 DRAM 업체들의 가격 담합에 대한 집단소송(피해대상기간: 2016년 6월1일부터 2018년 2월 1일까지)이 미국 캘리포니아 북부 연방지방법원에 제기되었습니다. 이후 유사한 집단소송들이 미국 캘리포니아 북부 연방지방법원 및 캐나다 브리티시컬럼비아 대법원, 퀘벡 지방법원, 온타리오 연방 및 지방법원에 제기되었습니다.

2020년 12월과 2021년 9월 미국 캘리포니아 북부 연방지방법원은 미국지역의 직접 및 간접 구매자 집단이 제기한 주요 소송에 대해 1심 최종 기각 결정을 내렸고, 원고 측은 항소를 통해 이러한 결정에 불복하였으나, 당분기말 현재 미국 직접 구매자 및 간접 구매자 집단 소송은 모두 1심 기각 결정을 유지하는 것으로 최종 종료되었습니다.

한편 2021년 6월 및 2021년 11월 캐나다 퀘벡 지방법원 및 온타리오 연방법원이 캐나다 지역의 구매자 집단이 제기한 소송에 대해 1심 최종 기각 결정을 내렸으며 항소심에서도 1심 기각 결정 유지 판결이 내려졌습니다. 퀘벡 지방법원 소송은 항소심 판결을 끝으로 최종 종료되었고, 온타리오 연방법원 소송은 당분기 말 현재 대법원 상고 절차가 진행 중입니다.

② 중국 반독점법 위반 조사

2018년 5월 중국 국가시장감독관리총국은 주요 DRAM 업체들의 중국 내 매출거래와 관련하여, 중국 반독점법 위반이 있었는지에 대한 조사를 개시하였으며, 동 조사가 현재 진행 중에 있습니다. 당분기말 현재 연결회사는 동 조사의 최종결과를 예측할 수 없습니다.

③ 소송 및 특허 클레임 등

당분기말 현재 연결회사는 상기 소송 외에 지적재산권 등과 관련하여 여러 분쟁에 대응하고 있으며, 과거 사건에 의한 현재의무이고 향후 자원의 유출가능성이 높으며 손실금액을 신뢰성 있게 추정할 수 있는 경우 동 금액을 부채로 인식하고 있습니다.

(2) HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd. ("HITECH")와의 후공정서비스계약
 연결회사는 HITECH과 후공정서비스를 공급받는 계약을 체결하고 있으며 서비스 제공 범위는 Package, Package Test, Module 등 입니다. 연결회사는 동 계약에 따라 HITECH 장비 우선 사용권을 보유하고, 후공정서비스 대가로 HITECH에 일정액의 약정수익을 보장하는 가격을 지불하기로 하였습니다.

(3) 당분기말 현재 담보제공자산 등의 현황은 다음과 같습니다.

(원화단위: 백만원, 외화단위: 외화 백만단위)								
구 분	장부금액	담보설정액			담보채무액			비 고
		통 화	외화금액	원화금액	통 화	외화금액	원화금액	
토지 및 건물	104,972	USD	70	94,139	USD	23	30,662	시설자금대출관련
		KRW	-	14,854	KRW	-	3,766	
기계장치	3,760,483	USD	4,286	5,763,870	USD	2,007	2,699,348	시설자금대출 등
		KRW	-	450,000	KRW	-	533,333	
합 계	3,865,455	USD	4,356	5,858,009	USD	2,030	2,730,010	
		KRW	-	464,854	KRW	-	537,099	

(4) 당분기말 현재 연결회사가 금융기관과 체결하고 있는 여신한도 거래의 주요 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위: 백만원, 외화단위: 외화 백만단위)				
구 분	금융기관	약정사항	한도금액	
			통 화	금 액
지배기업	하나은행 등	Usance 등 수입금융약정	USD	830
		Usance 등 수입 · 수출 포괄한도 약정	USD	1,470
		당좌차월	KRW	20,000
		상환청구권이 없는 매출채권팩토링약정	KRW	70,000
SK hynix Semiconductor (China) Ltd.	중국농업은행 등	Usance 등 수입금융약정	RMB	950
			USD	490
SK hynix America Inc. 등 판매법인	씨티은행 등	상환청구권이 없는 매출채권팩토링약정	USD	947
국내종속기업	하나은행 등	수입금융 약정 등	KRW	7,500
		Usance 등 수입금융약정	USD	15

(5) 당분기말 현재 기표되지 않은 유형자산에 대한 구매 약정액은 12,221,144백만원(전기말 : 11,695,696백만원)입니다.

(6) KIOXIA Holdings Corporation(이하 "KIOXIA") 투자

장기투자자산에 포함된 BCPE Pangea Intermediate Holdings Cayman, L.P. 및 BCPE Pangea Cayman2 Limited에 대한 투자를 통한 KIOXIA 투자와 관련하여 지분취득일 이후 일정기간 동안 연결회사의 직·간접적인 KIOXIA 보유지분이 특정비율 이하로 제한됩니다. 또한, 연결회사는 동 기간동안 KIOXIA에 대한 이사임명권이 제한되며, 경영 및 영업 의사결정에 유의적인 영향력을 행사할 수 없습니다.

(7) 인텔 NAND 사업부문 인수

연결회사는 2020년 중 인텔의 Non-Volatile Memory Solutions Group의 옴테인 사업을 제외한 NAND 사업 전체(이하 "인텔NAND사업")를 인수하는 영업양수도 계약을 체결하였습니다. 해당 사업은 해외 종속기업들을 통해 두 번에 나누어 이전되며, 양수도금액은 USD8,844백만으로 1차 종결 시점에 USD6,609백만을 지급하였으며,잔금 USD2,235백만은 2차 종결이 예상되는 2025년 3월까지 지급될 예정입니다. 본거래의 2차 종결은 정부기관의 심의를 포함하여 계약에서 정한 선행조건 충족 여부에 따라 변경될 수 있으며, 특정 상황으로 계약 해지시 약정된 termination fee를 지급해야 합니다. 한편 연결회사는 2차 거래종결이 이루어지지 않을 가능성은 낮다고 판단하고 있습니다.

연결회사는 2021년 중 완료된 인텔 NAND 사업 인수 1차 종결과 관련하여 중국 경쟁당국(중국 국가시장감독관리총국)으로부터 해당 인수거래에 대한 기업결합승인을 취득하는 과정에서 향후 5년간 중국 eSSD 시장에서 합리적인 가격정책을 유지하고 생산량을 확대할 의무 및 중국 eSSD 시장에 제3의 경쟁사가 진입하는 것을 지원해 줄 의무 등을 주요 내용으로 하는 조건들을 부과받은 바 있습니다. 따라서, 연결회사는 향후 5년간 동 의무들을 준수하여야 하며, 5년 후 동 의무들을 면제해 줄 것을 신청할 수 있습니다. 연결회사가 이와 같은 신청을 할 경우 중국 경쟁당국은 중국 eSSD 시장에서의 경쟁상황을 고려하여 동 신청을 수용할지를 결정할 것입니다.

(8) 기업구매전용카드 약정계약

연결회사는 일부 금융기관과 체결한 기업구매전용카드 약정계약을 통해 국세 및 전기료를 결제하며, 해당 약정에 따른 신용 공여기간 종료일에 결제대금을 카드사에 지급하고 있습니다. 당분기말 현재 관련 미지급금은 1,241,831백만원입니다.

(9) 미국 상무부 산업안보국(BIS)은 2022년 10월 7일 고성능반도체의 중국 수출과 중국 내 반도체 생산 및 생산장비와 관련된 제한을 강화하는 신규 수출 규제를 발표하였습니다. 연결회사는 중국 내 반도체공장의 원활한 운영을 위해 미국 정부와 적극적으로 논의를 하였고, 2023년 10월 10일까지 1년 동안 위 수출규제의 적용을 유예 받았습니다. 이 후, 2023년 9월 29일 미국 상무부 산업안보국(BIS)은 현재 연결회사의 중국 내 반도체 공장을 VEU(Validated End-User, 검증된 사용자)로 지정하여 지정된 품목에 대하여는 별도의 허가절차 및 유효기간 없이 수입이 가능하도록 허가하였습니다.

31. 분기연결현금흐름표

(1) 당분기와 전분기 중 영업에서 창출된 현금흐름의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
분기순이익(손실)	(7,758,097)	5,976,256
조정항목:		

법인세비용(수익)	(2,024,950)	2,461,819
이자비용	1,068,155	332,288
감가상각비	9,726,469	9,567,757
무형자산상각비	429,812	622,465
사용권자산상각비	266,464	243,009
유형자산처분이익	(222,488)	(126,144)
투자부동산처분이익	-	(64,418)
무형자산손상차손	167,050	50,272
퇴직급여	110,320	187,742
외화환산이익	(872,709)	(2,148,669)
외화환산손실	1,648,377	3,250,032
지분법이익	(18,858)	(119,245)
단기투자자산처분이익	(55,538)	(44,529)
기 타	(27,915)	(3,952)
운전자본의 변동:		
매출채권의 감소(증가)	(15,552)	203,143
기타수취채권의 감소(증가)	(129,349)	10,162
재고자산의 감소(증가)	939,085	(4,957,386)
기타자산의 감소(증가)	198,981	(305,644)
매입채무의 증가(감소)	(227,937)	1,143,206
미지급금의 증가	188,526	1,393
기타지급채무의 증가(감소)	(1,406,975)	155,131
충당부채의 증가	13,858	441,159
기타부채의 증가(감소)	416,728	(51,493)
퇴직금의 지급	(3,976)	(710)
사외적립자산 납부	(133,009)	(60,314)
영업으로부터 창출된 현금	2,276,472	16,763,330

(2) 당분기와 전분기 중 유동성 대체를 제외한 중요한 현금의 유입·유출이 없는 거래는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
유형자산 관련 미지급금 증가	-	2,472,056
판매후리스계약 체결에 따른 차입금 감소	(342,070)	-

(3) 연결회사는 거래가 빈번하며 총금액이 크고 단기간에 만기가 도래하는 단기투자자산 등으로 인한 현금의 유입과 유출 항목을 순증감액으로 표시하였습니다.

32. 주식기준보상

(1) 지배기업은 지배기업이 임직원에게 부여한 현금결제방식이나 주식결제방식을 선택할 수 있는 선택형 주식기준보상에 대하여 실질에 따라 회계처리하고 있습니다. 당분기말 현재 주식선택권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 주)								
구 분	총부여수량	소멸수량	행사수량	미행사수량	부여일	약정용역제공기간	행사가능기간	행사가격
1차	99,600	-	99,600	-	2017-03-24	2017.03.24~2019.03.24	2019.03.25~2022.03.24	48,400원
2차(*1)	99,600	-	99,600	-	2017-03-24	2017.03.24~2020.03.24	2020.03.25~2023.03.24	52,280원
3차	99,600	-	-	99,600	2017-03-24	2017.03.24~2021.03.24	2021.03.25~2024.03.24	56,460원
4차	7,747	-	7,747	-	2018-01-01	2018.01.01~2019.12.31	2020.01.01~2022.12.31	77,440원
5차(*1)	7,223	-	7,223	-	2018-03-28	2018.03.28~2020.03.28	2020.03.29~2023.03.28	83,060원
6차	8,171	8,171	-	-	2019-02-28	2019.02.28~2021.02.28	2021.03.01~2024.02.29	73,430원
7차(*1)	61,487	-	61,487	-	2019-03-22	2019.03.22~2021.03.22	2021.03.23~2024.03.22	71,560원
8차(*1)	61,487	-	61,487	-	2019-03-22	2019.03.22~2021.03.22	2022.03.23~2025.03.22	77,290원
9차	61,487	-	-	61,487	2019-03-22	2019.03.22~2022.03.22	2023.03.23~2026.03.22	83,470원
10차(*2)	54,020	10,764	-	43,256	2020-03-20	2020.03.20~2023.03.20	2023.03.21~2027.03.20	84,730원
11차	6,397	-	-	6,397	2020-03-20	2020.03.20~2023.03.20	2023.03.21~2027.03.20	84,730원
12차	6,469	-	-	6,469	2021-03-30	2021.03.30~2023.03.30	2023.03.31~2026.03.30	136,060원
13차(*2)	75,163	29,851	-	45,312	2021-03-30	2021.03.30~2023.03.30	2023.03.31~2026.03.30	136,060원
14차(*2)	195,460	19,621	-	175,839	2022-03-30	2022.03.30~2024.03.30	2024.03.31~2027.03.30	121,610원
합계	843,911	68,407	337,144	438,360				

(*1) 당분기 중 현금결제 방식으로 행사되었습니다.

(*2) 당분기 중 15,001주의 주식선택권이 소멸되었습니다.

(2) 연결회사는 상기 주식선택권 외에 지배기업의 종속회사인 SK hynix NAND Product Solutions Corp. 및 그 종속기업의 종업원에게 해당 종속기업의 주식에 대한 양도제한 조건 부주식(RSU) 등을 부여하고 있습니다.

(단위 : 주)			
부여주기	총부여수량	소멸수량	행사수량
연간 또는 분기	46,878,674	6,546,258	8,749,649

(3) 당분기말 현재 주가차액보상권에 대하여 인식한 부채는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)	
구 분	금 액
주가차액보상권 부채 총장부금액(*)	40,219

(*) 주가차액보상권 부채에는 당분기 종속회사 주식에 대한 RSU 관련 금액 32,575백만원이 포함되어 있습니다.

(4) 공정가치 측정

이항모형을 적용하여 공정가액 접근법에 의한 보상원가를 산정하였으며, 주식기준보상제도의 당분기말 현재 공정가치를 측정하기 위하여 사용된 투입변수는 다음과 같습니다.

구 분	주가 (평가기준일 종가, 원)	기대주가변동성	주당공정가치(원)	배당수익률	무위험이자율 (국공채 수익률)
2차	85,000	33.00%	32,745	1.80%	3.51%
3차	85,000	33.00%	30,363	1.80%	3.77%
5차	85,000	33.00%	7,479	1.80%	3.55%
7차	85,000	33.00%	19,868	1.80%	3.77%
8차	85,000	33.00%	20,275	1.80%	3.69%
9차	85,000	33.00%	20,577	1.80%	3.74%
10차	85,000	33.00%	22,449	1.80%	3.75%
11차	85,000	33.00%	22,449	1.80%	3.75%
12차	85,000	33.00%	8,162	1.80%	3.75%
13차	85,000	33.00%	8,162	1.80%	3.75%
14차	85,000	33.00%	13,065	1.80%	3.75%

(5) 연결회사가 당분기 중 인식한 주식보상비용은 6,970백만원(전분기: 52,874백만원)입니다.

33. 사업결합

(1) 인텔 NAND 사업 인수

① 전분기 연결포괄손익계산서에 미치는 영향

(단위: 백만원)			
계정과목	종전 기준에 따른 금액	조 정(*)	전분기
매출	36,949,537	-	36,949,537
매출원가	21,324,758	20,342	21,345,100
매출총이익	15,624,779	(20,342)	15,604,437
판매비와관리비	6,916,988	(34,197)	6,882,791
영업이익	8,707,791	13,855	8,721,646
금융수익	4,178,889	-	4,178,889
금융비용	4,615,888	-	4,615,888
지분법투자 관련 손익	119,245	-	119,245
기타영업외수익	214,249	-	214,249
기타영업외비용	180,065	-	180,065
법인세비용차감전순이익	8,424,221	13,855	8,438,076
법인세비용	2,461,820	-	2,461,820
분기순이익	5,962,401	13,855	5,976,256
총포괄손익	8,025,820	15,666	8,041,486
기본주당순이익	8,663	20	8,683
희석주당순이익	8,661	20	8,681

(*) 사업결합에 대한 회계처리가 2021년말까지 완료되지 않았으며, 잠정금액으로 2021년 연결재무제표에 보고하였습니다. 2022년 중 취득일 현재 존재하던 사실과 상황에 대하여 새롭게 입수한 정보를 토대로 취득일에 인식된 잠정금액을 소급하여 조정함으로써 사업결합 회계처리를 완료하였습니다. 비교표시된 전분기연결포괄손익계산서는 동 조정사항이 반영되어 재작성된 분기연결포괄손익계산서입니다.

4. 재무제표

4-1. 재무상태표

재무상태표

제 76 기 3분기말 2023.09.30 현재

제 75 기말 2022.12.31 현재

(단위 : 백만원)

	제 76 기 3분기말	제 75 기말
자산		
유동자산	17,567,697	17,511,130
현금및현금성자산	1,704,678	1,637,350
단기금융상품	272,500	272,500
단기투자자산	363,670	505,532
매출채권	4,033,199	3,766,707

기타수취채권	219,316	297,630
재고자산	10,371,360	10,345,744
당기법인세자산	18,030	
기타유동자산	469,085	685,667
기타금융자산	115,859	
비유동자산	76,628,197	74,289,103
종속기업, 관계기업 및 공동기업투자	13,221,051	11,873,138
장기투자자산	5,142,835	5,421,102
기타수취채권	11,368,643	8,518,499
기타금융자산	121,657	113,945
유형자산	38,784,655	43,151,324
사용권자산	1,930,077	968,642
무형자산	2,940,218	2,897,769
투자부동산	214	223
이연법인세자산	1,671,547	
종업원급여자산	1,288,268	1,294,931
기타비유동자산	159,032	49,530
자산총계	94,195,894	91,800,233
부채		
유동부채	15,568,486	14,790,337
매입채무	2,475,950	2,300,219
미지급금	2,407,218	4,903,972
기타지급채무	1,239,102	2,150,541
차입금	7,718,086	3,927,142
기타금융부채	637,174	
총당부채	315,166	307,721
당기법인세부채	4,115	589,899
리스부채	481,187	183,840
기타유동부채	290,488	427,003
비유동부채	22,840,202	16,847,074
장기미지급금	1,753,166	1,419,447
기타지급채무	13,996	16,118
차입금	18,997,275	14,060,862
이연법인세부채		260,457
리스부채	1,887,554	918,244
기타비유동부채	188,211	171,946
부채총계	38,408,688	31,637,411
자본		
자본금	3,657,652	3,657,652

자본잉여금	4,388,412	4,375,998
기타자본	(2,285,869)	(2,311,408)
기타포괄손익누계액	(1,623)	27,370
이익잉여금	50,028,634	54,413,210
자본총계	55,787,206	60,162,822
부채및자본총계	94,195,894	91,800,233

4-2. 포괄손익계산서

포괄손익계산서

제 76 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지

제 75 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지

(단위 : 백만원)

	제 76 기 3분기		제 75 기 3분기	
	3개월	누적	3개월	누적
매출액	7,737,724	17,906,637	9,688,365	32,427,651
매출원가	7,121,459	19,270,633	5,890,624	17,899,030
매출총이익(손실)	616,265	(1,363,996)	3,797,741	14,528,621
판매비와관리비	1,391,004	3,747,264	1,495,873	4,983,378
영업이익(손실)	(774,739)	(5,111,260)	2,301,868	9,545,243
금융수익	687,344	2,100,782	1,938,979	3,765,788
금융비용	986,712	2,848,144	1,419,758	3,307,997
기타영업외수익	235,741	277,507	33,237	264,721
기타영업외비용	235,919	268,875	43,741	112,523
법인세비용차감전순이익(손실)	(1,074,285)	(5,849,990)	2,810,585	10,155,232
법인세비용(수익)	(334,632)	(2,107,076)	679,370	2,508,340
분기순이익(손실)	(739,653)	(3,742,914)	2,131,215	7,646,892
법인세차감후 기타포괄손익	(14,541)	(51,515)	(16,200)	(29,642)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익				
확정급여제도의 재측정요소	(8,092)	(22,521)	(14,391)	(36,439)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익				
파생상품평가손익	(6,449)	(28,994)	(1,809)	6,797
분기총포괄이익(손실)	(754,194)	(3,794,429)	2,115,015	7,617,250
주당손익				
기본주당분기순이익(손실) (단위 : 원)	(1,075)	(5,440)	3,099	11,120
희석주당분기순이익(손실) (단위 : 원)	(1,075)	(5,440)	3,099	11,118

4-3. 자본변동표

자본변동표

제 76 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지

제 75 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지

(단위 : 백만원)

	자본					
	자본금	자본잉여금	기타자본	기타포괄손익누계액	이익잉여금	자본 합계
2022.01.01 (기초자본)	3,657,652	4,374,471	(2,294,562)	23,181	52,976,872	58,737,614
분기순이익(손실)					7,646,892	7,646,892
확정급여제도의 재측정요소					(36,439)	(36,439)
파생상품평가손익				6,797		6,797
배당금의 지급					(1,471,525)	(1,471,525)
주식선택권의 부여/행사			4,586			4,586
주식선택권 조건변경			(26,927)			(26,927)
주식선택권의 변동						
자기주식의 처분		1,527	1,732			3,259
2022.09.30 (기말자본)	3,657,652	4,375,998	(2,315,171)	29,978	59,115,800	64,864,257
2023.01.01 (기초자본)	3,657,652	4,375,998	(2,311,408)	27,371	54,413,210	60,162,823
분기순이익(손실)					(3,742,914)	(3,742,914)
확정급여제도의 재측정요소					(22,521)	(22,521)
파생상품평가손익				(28,994)		(28,994)
배당금의 지급					(619,141)	(619,141)
주식선택권의 부여/행사						
주식선택권 조건변경						
주식선택권의 변동			(978)			(978)
자기주식의 처분		12,414	26,517			38,931
2023.09.30 (기말자본)	3,657,652	4,388,412	(2,285,869)	(1,623)	50,028,634	55,787,206

4-4. 현금흐름표 현금흐름표

제 76 기 3분기 2023.01.01 부터 2023.09.30 까지

제 75 기 3분기 2022.01.01 부터 2022.09.30 까지

(단위 : 백만원)

	제 76 기 3분기	제 75 기 3분기
영업활동 현금흐름	(326,021)	11,266,614
영업으로부터 창출된 현금흐름	768,217	14,001,277
이자의 수취	508,247	134,413
이자의 지급	(676,971)	(242,343)
배당금의 수취	118,033	124,135
법인세의 납부	(1,043,547)	(2,750,868)
투자활동 현금흐름	(7,428,623)	(11,160,661)
단기금융상품의 감소		332,500
단기금융상품의 증가		(272,500)
단기투자자산의 순증감	145,593	1,010,808
기타수취채권의 감소	163,597	609,844
기타수취채권의 증가	(2,328,803)	(440,672)
장기투자자산의 처분	865	3,412
장기투자자산의 취득	(4,755)	(31,261)

유형자산의 처분	1,391,714	436,078
유형자산의 취득	(5,161,775)	(12,093,304)
무형자산의 처분	196	1,016
무형자산의 취득	(336,559)	(465,554)
투자부동산의 처분		263,211
기타비유동자산의 감소		103,858
종속기업투자(MMT)의 순증감	(1,303,393)	490,206
종속기업투자(주식)의 취득		(1,300,681)
관계기업투자(주식)의 취득	(4,150)	(8,850)
관계기업투자(주식)의 처분	8,847	201,228
재무활동 현금흐름	7,797,182	(373,348)
차입금의 차입	14,714,101	4,202,239
차입금의 상환	(6,116,465)	(2,982,501)
리스부채의 상환	(194,051)	(131,079)
배당금의 지급	(619,140)	(1,471,525)
자기주식의 처분	12,737	9,518
현금및현금성자산의 환율변동효과	24,790	9,037
현금및현금성자산의 순증감	67,328	(258,358)
기초 현금및현금성자산	1,637,350	1,608,456
분기말 현금및현금성자산	1,704,678	1,350,098

5. 재무제표 주석

제 76 기 3분기 2023년 9월 30일 현재

제 75 기 3분기 2022년 9월 30일 현재

에스케이하이닉스 주식회사

1. 회사의 개요

에스케이하이닉스 주식회사(이하 "회사")는 1996년에 주식을 한국거래소에 상장한 공개법인으로, 1949년 10월 15일에 설립되어 메모리반도체의 제조 및 판매업을 주업으로 하고 있습니다. 회사는 경기도 이천시 부발읍 경춘대로 2091에 본사와 경기도 성남시 등에 사무소를 두고 있으며, 경기도 이천시와 충청북도 청주시에 생산공장을 설치·가동하고 있습니다.

2023년 9월 30일 현재 회사의 주주현황은 다음과 같습니다.

구 분	소유주식수(주)	지분율(%)
SK스퀘어	146,100,000	20.07
기타주주	542,016,189	74.45
자기주식	39,886,176	5.48
합 계	728,002,365	100.00

당분기말 현재 회사의 주식은 한국거래소가 개설하는 유가증권시장에, 주식예탁증서는 코스콤 증권거래소에 상장되어 있습니다.

2. 중요한 회계정책

2.1 분기재무제표 작성기준

회사의 2023년 9월 30일로 종료하는 9개월 보고기간에 대한 분기재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 분기재무제표는 보고기간말인 2023년 9월 30일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

2.1.1 회사가 채택한 제·개정 기준서 및 해석서

회사는 2023년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제·개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.

(1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' - '회계정책'의 공시

중요한 회계정책 정보를 정의하고 이를 공시하도록 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 분기재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(2) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' - 행사가격 조정 조건이 있는 금융부채 평가손익 공시

발행자의 주가 변동에 따라 행사가격이 조정되는 조건이 있는 금융상품의 전부나 일부가 금융부채로 분류되는 경우 그 금융부채의 장부금액과 관련 손익을 공시하도록 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 분기재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(3) 기업회계기준서 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' - '회계추정'의 정의

회계추정을 정의하고, 회계정책의 변경과 구별하는 방법을 명확히 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 분기재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(4) 기업회계기준서 제1012호 '법인세' - 단일거래에서 생기는 자산과 부채에 대한 이연법인세

자산 또는 부채가 최초로 인식되는 거래의 최초 인식 예외 요건에 거래시점 동일한 가산할 일시적차이와 차감할 일시적차이를 발생시키지 않는 거래라는 요건을 추가하였습니다. 해당 기준서의 개정이 분기재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(5) 기업회계기준서 제1117호 '보험계약' 제정

기업회계기준서 제1117호 '보험계약'은 기업회계기준서 제1104호 '보험계약'을 대체합니다. 보험계약에 따른 모든 현금흐름을 추정하고 보고시점의 가정과 위험을 반영한 할인율을 사용하여 보험부채를 측정하고, 매 회계연도별로 계약자에게 제공한 서비스(보험보장)를 반영하여 수익을 발생주의로 인식하도록 합니다. 또한, 보험사건과 관계없이 보험계약자에게 지급하는 투자요소(해약/만기환급금)는 보험수익에서 제외하며, 보험손익과 투자손익을 구분 표시하여 정보이용자가 손익의 원천을 확인할 수 있도록 하였습니다. 해당 기준서의 개정이 분기재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

2.1.2 회사가 적용하지 않은 제·개정 기준서 및 해석서

제정 또는 공포되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제·개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.

(1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류

보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된 경우는 제외됩니다. 또한, 기업이 보고기간말 후에 준수해야 하는 약정은 보고기간말에 해당 부채의 분류에 영향을 미치지 않으며, 보고기간 이후 12개월 이내 약정사항을 준수해야 하는 부채가 보고기간말 현재 비유동부채로 분류된 경우 보고기간 이후 12개월 이내 부채가 상환될 수 있는 위험에 관한 정보를 공시해야 합니다. 동 개정사항은 2024년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며,

조기적용이 허용됩니다. 회사는 동 개정으로 인한 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다.

2.2 회계정책

분기재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책과 계산방법은 주석 2.1.1에서 설명하는 제
· 개정 기준서 및 해석서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고
는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.

2.2.1 법인세비용

중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율,
즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.

3. 중요한 회계추정 및 가정

회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다.

분기재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 전기 재무제표 작성에 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.

4. 금융상품의 범주별 분류

(1) 당분기말과 전기말 현재 금융자산의 범주별 분류내역은 다음과 같습니다.

① 당분기말

(단위: 백만원)					
구 분	당기손익-공정가치로 측정하는 금융자산	기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융자산	상각후원가로 측정하는 금융자산	기타금융자산	합 계
현금및현금성자산	-	-	1,704,678	-	1,704,678
단기금융상품	222,500	-	50,000	-	272,500
단기투자자산	363,670	-	-	-	363,670
매출채권(*)	-	11,554	4,021,645	-	4,033,199
기타수취채권	-	-	11,587,959	-	11,587,959
기타금융자산	-	-	12	237,504	237,516
장기투자자산	5,142,835	-	-	-	5,142,835
합 계	5,729,005	11,554	17,364,294	237,504	23,342,357

(*) 회사는 특정 거래처에 대한 일부 매출채권을 양도하고 위험과 보상의 대부분을 이전하여 매출채권을 양도일에 재무제표에서 제거하고 매출채권처분손익을 인식하고 있습니다.

② 전기말

(단위: 백만원)					
구 분	당기손익-공정가치로 측정하는 금융자산	기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융자산	상각후원가로 측정하는 금융자산	기타금융자산	합 계
현금및현금성자산	-	-	1,637,350	-	1,637,350
단기금융상품	222,500	-	50,000	-	272,500
단기투자자산	505,532	-	-	-	505,532
매출채권(*)	-	5,562	3,761,145	-	3,766,707
기타수취채권	-	-	8,816,129	-	8,816,129
기타금융자산	-	-	11	113,934	113,945
장기투자자산	5,421,102	-	-	-	5,421,102
합 계	6,149,134	5,562	14,264,635	113,934	20,533,265

(*) 회사는 특정 거래처에 대한 일부 매출채권을 양도하고 위험과 보상의 대부분을 이전하여 매출채권을 양도일에 재무제표에서 제거하고 매출채권처분손익을 인식하고 있습니다.

(2) 당분기말과 전기말 현재 금융부채의 범주별 분류내역은 다음과 같습니다.

① 당분기말

(단위: 백만원)					
-----------	--	--	--	--	--

구 분	당기손익-공정가치로 측정하는 금융부채	상각후원가로 측정하는 금융부채	합 계
매입채무	-	2,475,950	2,475,950
미지급금	-	4,160,384	4,160,384
기타지급채무(*)	-	917,623	917,623
차입금	-	26,715,361	26,715,361
리스부채	-	2,368,741	2,368,741
기타금융부채	637,174	-	637,174
합 계	637,174	36,638,059	37,275,233

(*) 기타지급채무 중 종업원급여제도에 따른 회사의 의무에 대응하는 미지급급여 부채는 금융상품 공시 대상이 아니므로 제외되었습니다.

② 전기말

(단위: 백만원)	
구 분	상각후원가로 측정하는 금융부채
매입채무	2,300,219
미지급금	6,323,419
기타지급채무(*)	882,905
차입금	17,988,004
리스부채	1,102,084
합 계	28,596,631

(*) 기타지급채무 중 종업원급여제도에 따른 회사의 의무에 대응하는 미지급급여 부채는 금융상품 공시 대상이 아니므로 제외되었습니다.

5. 금융위험관리

(1) 금융위험관리

회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환율변동위험, 이자율위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 중간재무제표는 연차재무제표에서 요구되는 모든 재무위험관리와 공시사항을 포함하지 않으므로 2022년 12월 31일의 연차재무제표를 참고하시기 바랍니다. 회사의 위험관리부서 및 기타 위험관리정책에는 전기말 이후 중요한 변동사항이 없습니다.

① 시장위험

(가) 환율변동위험

회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 달러화, 유로화 및 엔화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산과 부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생합니다.

당분기말 현재 회사의 화폐성 외화자산 및 외화부채의 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위: 백만원, 외화단위: 외화 백만단위)				
구 분	자 산		부 채	
	현지통화	원화환산	현지통화	원화환산
USD	12,477	16,779,338	17,883	24,049,560
JPY	154	1,390	62,430	563,252
EUR	-	-	113	161,132

또한, 회사는 외화사채 및 차입금의 환위험을 회피하기 위하여 주석 18에서 설명하는 바와 같이 통화스왑계약 및 통화이자율스왑계약을 체결하고 있습니다.

당분기말 현재 각 외화에 대한 기능통화의 환율이 10% 변동시, 동 환율변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	10% 상승시	10% 하락시
USD	(505,278)	505,278
JPY	(56,186)	56,186
EUR	(16,113)	16,113

(나) 이자율위험

회사의 이자율위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 차입금에서 발생하는 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금에서 발생하고 있습니다. 변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 회사는 이자율위험에 노출되어 있으며 동 이자율위험의 일부는 변동이자부 현금성자산으로부터의 이자율위험과 상쇄됩니다.

회사는 현금흐름 이자율위험을 변동이자수취/고정이자지급 스왑을 이용하여 관리하고 있습니다. 이러한 이자율 스왑은 변동이자부 차입금을 고정이자부 차입금으로 바꾸는 경제적 효과가 있습니다. 일반적으로, 회사는 변동이자율로 차입금을 발생시킨 후 고정이자율로 스왑을 하게 됩니다. 스왑계약에 따라 회사는 거래상대방과 특정기간(주로 분기)마다, 합의된 원금에 따라 계산된 고정이자와 변동이자 차이를 결제하게 됩니다.

회사는 당분기말 현재 이자율 변동에 따라 순이자비용이 변동할 위험에 일부 노출되어 있습니다. 회사는 변동금리부 차입금 546,325백만원에 대해 통화이자율스왑 계약, 변동금리부 차입금 100,000백만원에 대해 이자율스왑계약을 체결하고 있습니다. 따라서, 이자율 변동에 따른 해당 차입금에 대한 이자비용 변동으로 인한 당분기 법인세비용차감전순이익은 변동하지 않습니다.

한편, 다른 변동금리부 차입금 및 변동금리부 금융자산에 대하여 당분기말 현재 다른모든 변수가 일정하고 이자율이 100bp 하락 또는 상승시, 향후 1년 간 회사의 변동금리부 차입금 및 금융자산으로부터의 순이자비용으로 인한 법인세비용차감전순이익은 22,802백만원(전분기 : 22,382백만원)만큼 증가 또는 감소할 것입니다.

(다) 가격위험

회사는 유동성관리 및 영업상의 필요 등으로 지분증권 및 채무증권에 투자하고 있습니다. 당분기말 현재 해당 지분증권 및 채무증권은 가격위험에 노출되어 있습니다.

② 신용위험

신용위험은 회사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약 조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 회사는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다.

(가) 매출채권 및 기타수취채권

회사는 신용거래를 희망하는 모든 거래상대방에 대하여 신용검증절차의 수행을 원칙으로 하여 신용상태가 건전한 거래상대방과의 거래만을 수행하고 있습니다. 또한, 대손위험에 대한 회사의 노출정도가 중요하지 않은 수준으로 유지될 수 있도록 지속적으로 신용도를 재평가하고 담보물을 확보하는 등 매출채권 및 기타수취채권 잔액에 대한 지속적인 관리업무를 수행하고 있습니다. 회사는 매출채권 및 기타수취채권에 대해 매 보고기간말에 개별적으로 손상여부를 검토하고 있으며, 해외 거래처에 대한 신용위험과 관련하여 신용보험계약을 체결하고 있습니다. 회사의 신용위험 노출정도는 거래상대방별 매출채권 등의 장부금액과 동일한 금액입니다.

(나) 기타의 자산

현금및현금성자산, 단기금융상품, 단기투자자산 및 장·단기대여금 등으로 구성되는회사의

기타의 자산으로부터 발생하는 신용위험은 거래상대방의 부도 등으로 발생합니다. 이러한 경우 회사의 신용위험 노출정도는 최대 해당 금융상품 장부금액과 동일한 금액이 될 것입니다. 한편, 회사는 다수의 금융기관에 현금및현금성자산과 단기금융상품 등을 예치하고 있으며, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다.

③ 유동성 위험

유동성위험은 만기까지 모든 금융계약상의 약정사항들을 이행하기 위한 필요자금을 조달하지 못할 위험입니다. 회사는 유동성 전략 및 계획을 통하여 자금부족에 따른 위험을 관리하고 있습니다.

회사는 상기에서 언급한 예측을 통해 결정된 대로 여유있는 유동성이 확보될 수 있도록 적절한 만기나 충분한 유동성을 제공해주는 이자부 당좌예금, 정기예금, 수시입출금식 예금 등의 금융상품을 선택하여 잉여자금을 투자하고 있습니다.

(2) 자본관리

회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.

자본구조를 유지 또는 조정하기 위하여 회사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 차입금 조달 및 상환, 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재의 부채비율과 순차입금비율은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
부 채 (A)	38,408,688	31,637,411
자 본 (B)	55,787,206	60,162,822
현금및현금성자산 등(C) (*)	2,340,848	2,415,382
차입금 (D)	26,715,361	17,988,004
부채비율 (A/B)	68.85%	52.59%
순차입금비율 (D-C)/B	43.69%	25.88%

(*) 현금및현금성자산, 단기금융상품 및 단기투자자산의 합계액입니다.

주요 차입금 계약상 회사는 일정 수준의 부채비율, 담보채무비율 등을 준수해야 하며, 회사는 당분기말 현재 이러한 조건을 준수하였습니다.

(3) 공정가치

공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.

- 수준 1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격
- 수준 2: 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수
- 수준 3: 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수

공정가치 서열체계를 포함한 금융자산과 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

① 당분기말

(단위: 백만원)					
구 분	장부금액	수준 1	수준 2	수준 3	합 계
공정가치로 측정되는 금융자산:					
단기금융상품	222,500	-	-	222,500	222,500
단기투자자산	363,670	-	363,670	-	363,670
매출채권(*1)	11,554	-	11,554	-	11,554
장기투자자산	5,142,835	-	-	5,142,835	5,142,835
기타금융자산	237,504	-	237,504	-	237,504
소 계	5,978,063	-	612,728	5,365,335	5,978,063
공정가치로 측정되지 않는 금융자산:					
현금및현금성자산(*2)	1,704,678	-	-	-	-
단기금융상품(*2)	50,000	-	-	-	-
매출채권(*2)	4,021,645	-	-	-	-
기타수취채권(*2)	11,587,959	-	-	-	-
기타금융자산(*2)	12	-	-	-	-
소 계	17,364,294	-	-	-	-
금융자산 합계	23,342,357	-	612,728	5,365,335	5,978,063
공정가치로 측정되는 금융부채:					
기타금융부채	637,174	-	637,174	-	637,174
소 계	637,174	-	637,174	-	637,174
공정가치로 측정되지 않는 금융부채:					
매입채무(*2)	2,475,950	-	-	-	-
미지급금(*2)	4,160,384	-	-	-	-
기타지급채무(*2)	917,623	-	-	-	-
차입금	26,715,361	-	25,578,731	-	25,578,731
리스부채(*2)	2,368,741	-	-	-	-
소 계	36,638,059	-	25,578,731	-	25,578,731
금융부채 합계	37,275,233	-	26,215,905	-	26,215,905

(*1) 회사는 특정 거래처에 대한 일부 매출채권을 양도하고 위험과 보상의 대부분을 이전하여 매출채권을 양도일에 재무제표에서 제거하고 매출채권처분손익을 인식하고 있습니다.

(*2) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치를 측정하지 않은 금융자산과 금융부채에 대한 공정가치는 포함하고 있지 않습니다.

② 전기말

(단위: 백만원)					
구 분	장부금액	수준 1	수준 2	수준 3	합 계
공정가치로 측정되는 금융자산:					
단기금융상품	222,500	-	-	222,500	222,500
단기투자자산	505,532	-	505,532	-	505,532
매출채권(*1)	5,562	-	5,562	-	5,562
장기투자자산	5,421,102	-	-	5,421,102	5,421,102
기타금융자산	113,934	-	113,934	-	113,934
소 계	6,268,630	-	625,028	5,643,602	6,268,630
공정가치로 측정되지 않는 금융자산:					
현금및현금성자산(*2)	1,637,350	-	-	-	-
단기금융상품(*2)	50,000	-	-	-	-
매출채권(*2)	3,761,145	-	-	-	-
기타수취채권(*2)	8,816,129	-	-	-	-
기타금융자산(*2)	11	-	-	-	-
소 계	14,264,635	-	-	-	-
금융자산 합계	20,533,265	-	625,028	5,643,602	6,268,630
공정가치로 측정되지 않는 금융부채:					
매입채무(*2)	2,300,219	-	-	-	-
미지급금(*2)	6,323,419	-	-	-	-
기타지급채무(*2)	882,905	-	-	-	-
차입금	17,988,004	-	16,850,627	-	16,850,627
리스부채(*2)	1,102,084	-	-	-	-
금융부채 합계	28,596,631	-	16,850,627	-	16,850,627

(*1) 회사는 특정 거래처에 대한 일부 매출채권을 양도하고 위험과 보상의 대부분을 이전하여 매출채권을 양도일에 재무제표에서 제거하고 매출채권처분손익을 인식하고 있습니다.

(*2) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치를 측정하지 않은 금융자산과 금융부채에 대한 공정가치는 포함하고 있지 않습니다.

③ 가치평가기법

수준 2와 수준 3의 공정가치 측정을 위해 사용된 평가기법은 전기말과 동일합니다.

④ 당분기 중 수준 1, 수준 2 및 수준 3간의 대체는 없으며, 수준 3 공정가치 측정으로 분류되는 금융자산의 당분기 중 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)						
구 분	기 초	취 득	처 분	평 가	환율변동	분기말
단기금융상품	222,500	-	-	-	-	222,500
장기투자자산	5,421,102	5,980	(864)	(716)	(282,667)	5,142,835

6. 매출채권 및 기타수취채권

(1) 당분기말과 전기말 현재 기타수취채권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
유 동:		
미수금	41,534	23,309
미수수익	135,869	102,709
단기대여금	5,920	133,888
단기보증금	35,993	37,724
소 계	219,316	297,630
비유동:		
장기대여금	11,174,251	8,460,320
보증금	194,392	58,179
소 계	11,368,643	8,518,499
합 계	11,587,959	8,816,129

(2) 대손충당금의 내역

당분기말과 전기말 현재 대손충당금 차감전 총액 기준에 의한 매출채권 및 기타수취채권과 관련 대손충당금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)						
구 분	당분기말			전기말		
	채권액	대손충당금	장부금액	채권액	대손충당금	장부금액
매출채권(*)	4,033,199	-	4,033,199	3,766,707	-	3,766,707
유동성 기타수취채권	220,629	(1,313)	219,316	298,943	(1,313)	297,630
비유동성 기타수취채권	11,368,745	(102)	11,368,643	8,518,601	(102)	8,518,499
합 계	15,622,573	(1,415)	15,621,158	12,584,251	(1,415)	12,582,836

(*) 회사는 당분기 중 은행과의 매출채권 할인 약정을 통해 일부 매출채권을 양도하였습니다. 회사는 해당 거래를 단기 차입으로 회계처리했으며(주석 14 참조), 매출 거래처의 부도가 발생하는 경우 은행에 해당 금액을 지급할 의무가 있습니다.

7. 재고자산

당분기말과 전기말 현재 재고자산 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)						
구 분	당분기말			전기말		
	취득원가	평가손실총당금	장부금액	취득원가	평가손실총당금	장부금액
제품	4,058,187	(694,625)	3,363,562	3,582,499	(593,507)	2,988,992
재공품	6,588,899	(1,004,415)	5,584,484	6,119,295	(203,741)	5,915,554
원재료	1,026,126	(35,815)	990,311	1,010,712	(48,282)	962,430
저장품	400,644	(34,816)	365,828	427,613	(29,206)	398,407
미착품	67,175	-	67,175	80,361	-	80,361
합 계	12,141,031	(1,769,671)	10,371,360	11,220,480	(874,736)	10,345,744

8. 기타유동자산 및 기타비유동자산

당분기말과 전기말 현재 기타유동자산 및 기타비유동자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
유 동:		
선급금	27,880	36,979
선급비용	194,313	152,587
부가세대급금	93,759	386,164
계약자산	112,971	109,937
기타	40,162	-
소 계	469,085	685,667
비유동:		
장기선급금	138,309	22,574
장기선급비용	20,723	26,956
소 계	159,032	49,530
합 계	628,117	735,197

9. 종속기업, 관계기업 및 공동기업

(1) 당분기말과 전기말 현재 종속기업, 관계기업 및 공동기업의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
종속기업	12,421,487	11,068,877
관계기업 및 공동기업	799,564	804,261
합 계	13,221,051	11,873,138

(2) 당분기말과 전기말 현재 종속기업의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)						
구 분	소재지	주요영업활동	당분기말		전기말	
			지분율(%)	장부금액	지분율(%)	장부금액
에스케이하이엔지㈜	국 내	건설공사 및 서비스	100.00	7,521	100.00	7,521
에스케이하이시스템즈㈜	국 내	사업지원 및 서비스	100.00	6,760	100.00	6,760
행복모아㈜	국 내	반도체 의료 제조, 제빵 및 서비스	100.00	37,400	100.00	37,400
에스케이하이닉스시스템아이씨㈜	국 내	반도체 연구개발 및 사업지원	100.00	404,928	100.00	404,928
행복나래㈜	국 내	산업자재 유통	100.00	63,147	100.00	63,147
㈜키파운드리	국 내	반도체 판매 및 생산 등	100.00	572,590	100.00	572,590
SK hynix America Inc.(*)1)	미 국	반도체 판매	100.00	31	97.74	31
SK hynix Deutschland GmbH	독 일	반도체 판매	100.00	22,011	100.00	22,011
SK hynix Asia Pte. Ltd.	싱가포르	반도체 판매	100.00	52,380	100.00	52,380
SK hynix Semiconductor HongKong Ltd.	홍 콩	반도체 판매	100.00	32,623	100.00	32,623
SK hynix U.K. Ltd.	영 국	반도체 판매	100.00	1,775	100.00	1,775
SK hynix Semiconductor Taiwan Inc.	대 만	반도체 판매	100.00	37,562	100.00	37,562
SK hynix Japan Inc.	일 본	반도체 판매	100.00	42,905	100.00	42,905
SK hynix Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd.	중 국	반도체 판매	100.00	4,938	100.00	4,938
SK hynix Semiconductor India Private Ltd.	인 도	반도체 판매	1.00	5	1.00	5
SK hynix (Wuxi) Semiconductor Sales Ltd.	중 국	반도체 판매	100.00	237	100.00	237
SK hynix Semiconductor (China) Ltd.	중 국	반도체 제조	100.00	4,811,147	100.00	4,811,147
SK hynix Italy S.r.l	이탈리아	반도체 연구개발	100.00	-	100.00	-
SK hynix memory solutions Taiwan Ltd.	대 만	반도체 연구개발	100.00	7,819	100.00	7,819
SK hynix memory solutions Eastern Europe, LLC.	벨라루스	반도체 연구개발	99.93	4,722	99.93	4,722
SK APTECH Ltd.	홍 콩	해외투자법인	100.00	440,770	100.00	440,770
SK hynix Ventures HongKong Ltd.	홍 콩	해외투자법인	100.00	66,762	100.00	66,762
Gauss Labs, Inc.	미 국	정보통신업	99.94	63,544	100.00	63,544
SK hynix NAND Product Solutions Corp.	미 국	반도체 판매, 연구개발 등	99.47	2,189,079	99.89	2,189,079
SK hynix Semiconductor (Dalian) Co., Ltd.	중 국	반도체 제조	100.00	1,045,419	100.00	1,045,419
SK hynix Ventures America LLC	미 국	해외투자법인	100.00	52,802	100.00	52,802
MMT 특정금전신탁(*2)	국 내	특정금전신탁	100.00	2,452,610	100.00	1,100,000
합 계				12,421,487		11,068,877

(*1) 당분기 중 Skhynix America Inc.는 자사의 비지배지분을 매입 후 소각하였습니다.

(*2) 당분기 중 MMT(특정금전신탁)를 일부 처분하고 신규 취득하였습니다.

(3) 당분기말과 전기말 현재 관계기업 및 공동기업의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)							
구 분	회사명	소재지	주요영업활동	당분기말		전기말	
				지분율(%)	장부금액	지분율(%)	장부금액
관계기업	Stratio, Inc.(※1)	미국	반도체 부품 개발 및 제조	9.35	395	9.35	395
	SK China Company Limited(※2)	중국	컨설팅 및 투자	11.87	257,169	11.87	257,169
	SK South East Asia Investment Pte. Ltd.	싱가포르	컨설팅	20.00	345,800	20.00	345,800
	농업회사법인 푸르메소셜팜㈜	국내	기타 작물 재배업	35.52	2,000	35.52	2,000
	매그너스사모투자합자회사(※4)	국내	투자	-	-	49.76	-
	엘앤에스 10호 Early Stage III 투자조합	국내	투자	24.39	5,000	24.39	5,000
	SiFive, Inc.(※1)	미국	반도체 설계 및 제조	7.28	35,709	7.28	35,709
	미래에셋위반도체 제1호창업벤처전문사모투자 합작회사	국내	투자	29.97	15,000	29.97	11,100
공동기업	Hitech Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.(※3)	중국	반도체 부품 제조	45.00	92,608	45.00	92,608
	반도체성장 전문투자형 사모 투자신탁(※3)	국내	투자	33.33	15,633	33.33	24,480
	시스템반도체 상생 전문투자형 사모투자신탁 (※3)	국내	투자	37.50	30,000	37.50	30,000
	반도체 생태계 일반 사모 투자신탁	국내	투자	33.33	250	-	-
합 계					799,564		804,261

(※1) 이사선임권을 통해 유의적인 영향력을 행사할 수 있으므로 관계기업으로 분류하였습니다.

(※2) 회사의 경영진이 이사회에 참여하여 유의적인 영향력을 행사할 수 있으므로 관계기업으로 분류하였습니다.

(※3) 계약에 의해 중요사항에 대해 만장일치로 의결되도록 규정되어 있어 공동기업으로 분류하였습니다.

(※4) 당분기 중 청산이 완료되었습니다.

10. 유형자산

(1) 당분기와 전분기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
기초장부금액	43,151,324	35,870,163
취득	3,053,636	11,495,608
처분 및 폐기	(1,282,831)	(183,889)
감가상각	(6,137,198)	(5,935,028)
대체	(276)	(12,659)
기말장부금액	38,784,655	41,234,195

(2) 당분기말 현재 회사의 일부 기계장치는 차입금과 관련하여 담보로 제공되어 있습니다(주석 29 참조).

11. 리스

(1) 당분기와 전분기 중 사용권자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
기초장부금액	968,642	838,853
증가	1,121,975	204,326
종료	-	(19,446)
감가상각	(160,540)	(135,523)
기말장부금액	1,930,077	888,210

(2) 당분기와 전분기 중 리스부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
기초장부금액	1,102,084	870,970
증가	1,414,157	275,332
종료	-	(19,446)
이자비용	30,489	15,625
지급	(199,949)	(136,013)
환율변동	21,960	37,901
기말장부금액	2,368,741	1,044,369

12. 무형자산

당분기와 전분기 중 무형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
기초장부금액	2,897,769	2,995,581
취득	607,045	515,614
처분 및 폐기	(5,841)	(4,084)
상각	(391,133)	(510,719)
손상차손 및 환입	(167,050)	(50,107)
대체	(572)	12,658
기말장부금액	2,940,218	2,958,943

13. 투자부동산

(1) 당분기와 전분기 중 투자부동산의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
기초장부금액	223	207,491
감가상각	(9)	(2,004)
처분	-	(161,925)
기말장부금액	214	43,562

(2) 당분기 중 발생한 투자부동산의 감가상각비 9백만원(전분기: 2,004백만원)은 전액 매출 원가에 포함되어 있습니다.

(3) 당분기 중 투자부동산과 관련하여 발생한 임대수익은 7백만원(전분기: 12,528백만원)입니다.

14. 차입금

당분기말과 전기말 현재 차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
유 동:		
단기차입금(*1)	3,152,797	2,203,122
유동성장기차입금	758,193	754,216
유동성사채(*2)	3,807,096	969,804
소 계	7,718,086	3,927,142
비유동:		
장기차입금	9,247,325	7,563,072
사채	9,749,950	6,497,790
소 계	18,997,275	14,060,862
합 계	26,715,361	17,988,004

(*1) 회사는 당분기 중 은행과의 매출채권 할인 약정을 통해 매출채권을 양도하였으며, 매출 거래처의 부도가 발생하는 경우 은행에 해당 금액을 지급할 의무가 있습니다. 회사는 해당 거래를 단기차입금에 포함하여 공시하고 있습니다(주석 6 참조).

(*2) 당분기 중 회사가 발행한 교환사채를 포함하고 있으며, 교환사채의 만기는 2030년이나 교환권의 행사가능성으로 인해 유동성사채로 분류하였습니다. 동 교환사채의 발행조건은 다음과 같습니다 .

구 분		내 역
1. 사채의 종류		외화 해외교환사채
2. 사채의 권면총액		USD 1,700,000,000
3. 사채의 이율	표면이자율	1.75%
	만기이자율	1.75%
4. 만기일		2030년 04월 11일
5. 원금상환방법		1) 만기상환 : 만기까지 교환권 및 조기상환권의 미행사 에 따른 잔존 사채원리금에 대해 만기 일시상환
		2) 조기상환 : 회사의 조기상환권(Call Option) 및 사채권 자의 조기상환권(Put Option) 존재
6. 교환에 관한사항	교환비율	사채원금의 100%
	교환가액	111,180원
	교환대상	SK하이닉스 주식회사 발행 기명식 보통 주식(자기주식)
	교환청구기간	2023년 5월 22일 ~ 2030년 4월 1일
	교환가액 조정사항	무상증자, 주식분할, 주식병합, 주식의 종류 변경, 주주 에 대한 옵션 또는 워런트의 추가발행, 주식배당, 현금배 당, 기타 자산의 배당, 시가 미만의 신주발행 등과 같은 교환가액 조정사유 발생시 사채조건에서 정한 바에 따라 조정
7. 투자자의 조기상환권(Put Option)		- 납일일로부터 4년 (2027. 04. 11)이 되는 날

8. 발행자의 조기상환권(Call Option)	- 당사의 지배권 변동(Change of Control)이 발생하는 경우
	- 당사 발행주식이 상장폐지되거나 20 연속 거래일 이상 거래정지되는 경우
	- 2028년 4월 25일 부터 사채만기일 30 영업일 전까지 30 연속거래일 중 20 거래일의 종가가 교환가격의 130% 이상인 경우
	- 미상환사채잔액이 총 발행총액의 10% 미만인 경우 (Clean Up Call)
	- 관련 법령의 개정 등으로 인한 추가 조세부담사유가 발생하는 경우

15. 기타유동부채 및 기타비유동부채

당분기말과 전기말 현재 기타유동부채 및 기타비유동부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
유 동:		
선수금	22	1,714
선수수익	16	2,468
예수금	56,530	69,780
계약부채	233,920	353,041
소 계	290,488	427,003
비유동:		
장기선수금	14,000	-
기타장기종업원급여부채	174,211	171,946
소 계	188,211	171,946
합 계	478,699	598,949

16. 충당부채

(1) 당분기와 전분기 중 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

① 당분기

(단위: 백만원)					
구 분	기 초	전 입	사 용	환 입	분기말
계약손실충당부채	64,555	-	-	(9,840)	54,715
판매보증충당부채	239,475	41,305	(22,156)	-	258,624
배출부채	1,864	-	(1,562)	(302)	-
복구충당부채	1,827	-	-	-	1,827
합 계	307,721	41,305	(23,718)	(10,142)	315,166

② 전분기

(단위: 백만원)					
구 분	기 초	전 입	사 용	환 입	분기말
계약손실충당부채	42,829	16,698	-	-	59,527
판매보증충당부채	3,119	481,456	(2,173)	-	482,402
배출부채	6,840	2,559	-	(6,840)	2,559
합 계	52,788	500,713	(2,173)	(6,840)	544,488

(2) 계약손실충당부채

회사는 회사의 종속기업인 SK hynix Semiconductor (China) Ltd.로부터 Wafer반제품을 구매하고 있으며, 당분기말 현재 동 종속기업이 생산중인 재공품에 대해서 구매후 추가 가공하여 판매할 경우 예상되는 매출손실을 계약손실충당부채전입액으로 하여 매출원가에 가산하고 충당부채로 인식하고 있습니다.

(3) 판매보증충당부채

회사는 무상 품질보증수리 등과 관련하여 장래에 지출될 것이 예상되는 금액을 과거 경험을 등을 기초로 추정하여 충당부채를 인식하고 있으며, 과거 특정 제품의 품질 저하 현상과 관련하여 제품 교환 등 회사가 부담할 것으로 예상되는 금액을 별도로 추정하여 충당부채로 계상하고 있습니다.

(4) 배출부채

회사는 '온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률'에 따라 장래에 지출될 것이 예상되는 금액을 추정하여 충당부채로 인식하고 있습니다.

① 당분기말 현재 당기 이행연도에 대한 무상할당 배출권과 온실가스 배출량 추정치는 다음과 같습니다.

(단위: 만톤(tCO ₂ -eq))	
구 분	당분기말
무상할당 배출권	548
배출량 추정치	542

② 당분기 중 배출권 증감 내용은 다음과 같습니다.

구 분	(단위: 만톤(tCO ₂ -eq))
	2022년도분
기초	6
무상할당	475
매입	17
정부제출	(498)
이월	—
매각	—
기말	—

17. 종업원급여

(1) 당분기말과 전기말 현재 확정급여부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
확정급여채무의 현재가치	2,205,965	2,032,555
사외적립자산의 공정가치	(3,494,233)	(3,327,486)
순확정급여부채(자산)	(1,288,268)	(1,294,931)
확정급여부채	—	—
확정급여자산(*)	1,288,268	1,294,931

(*) 당분기말과 전기말 현재 확정급여제도의 초과적립액 1,288,268백만원과 1,294,931백만원을 종업원급여자산으로 표시하였습니다.

(2) 당분기와 전분기 중 확정급여채무의 현재가치 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
기초장부금액	2,032,555	2,296,629
당기근무원가	155,274	187,301
이자원가	94,089	66,918
관계사전출입액	13,856	(90)
퇴직급여지급액	(89,809)	(67,754)
기말장부금액	2,205,965	2,483,004

(3) 당분기와 전분기 중 사외적립자산의 공정가치 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
기초장부금액	3,327,486	2,713,786
사용자 기여금	130,000	60,000
이자수익	157,002	79,438
관계사전출입액	12,524	784
퇴직급여지급액	(110,258)	(79,877)
재측정요소	(22,521)	(36,439)
기말장부금액	3,494,233	2,737,692

(4) 당분기와 전분기 중 확정급여제도와 관련하여 손익으로 인식된 비용은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)				
구 분	당분기		전분기	
	3개월	누적	3개월	누적
당기근무원가	51,744	155,274	62,441	187,301
순이자원가	(20,976)	(62,913)	(4,171)	(12,520)
합 계	30,768	92,361	58,270	174,781

(5) 당분기 중 확정기여형 퇴직연금제도와 관련하여 비용으로 인식된 금액은 7,425백만원 (전분기: 4,667백만원) 입니다.

18. 파생상품거래

(1) 통화스왑 및 이자율스왑

① 당분기말 현재 현금흐름위험회피회계를 적용한 통화스왑 및 이자율스왑 거래내역은 다음과 같습니다.

(원화단위: 백만원, 외화단위: 외화 천단위)					
위험회피대상			위험회피수단		
차입일	대상항목	대상위험	계약종류	채결기관	계약기간
2019.09.17	고정금리외화사채 (액면금액 USD 500,000)	환율변동위험	통화스왑계약	국민은행 등 2개은행	2019.09.17 ~ 2024.09.17
2019.10.02	변동금리외화시설대출 (액면금액 USD 406,250)	환율변동위험 및 이자율위험	통화이자율스왑계약	산업은행	2019.10.02 ~ 2026.10.02
2023.01.17	고정금리외화사채 (액면금액 USD 750,000)	환율변동위험	통화스왑계약	국민은행 등 4개은행	2023.01.17 ~ 2026.01.17
2023.04.04	변동금리시설대출 (액면금액 KRW 100,000)	이자율위험	이자율스왑계약	우리은행	2023.04.04 ~ 2028.04.04

② 회사가 보유하고 있는 파생금융자산의 당분기말 공정가치는 재무상태표의 기타금융자산 계정으로 계상되어 있으며, 그 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위: 백만원, 외화단위: 외화 천단위)			
구분	위험회피대상항목	현금흐름위험회피 회계적용	공정가치
통화스왑	고정금리외화사채 (액면금액 USD 1,250,000)	147,275	147,275
통화이자율스왑	변동금리외화시설대출 (액면금액 USD 406,250)	88,607	88,607
이자율스왑	변동금리시설대출 (액면금액 KRW 100,000)	1,622	1,622
파생금융자산 합계			237,504

당분기말 현재 위험회피수단으로 지정된 파생상품의 공정가치 변동은 모두 위험회피에 효과적이므로 전액 기타포괄손익으로 인식하였습니다.

(2) 내재파생상품

회사가 보유하고 있는 파생금융부채의 당분기말 공정가치는 재무상태표의 기타금융부채 계정으로 계상되어 있으며, 그 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)			
파생금융부채	당분기말	전기말	공정가치
내재파생상품(*)	637,174	-	637,174

(*) 회사가 2023년 4월 11일 발행한 교환사채에 부여된 교환권 및 콜옵션, 풋옵션입니다(주석 14 참조).

19. 자본금, 자본잉여금 및 기타자본

(1) 당분기말 현재 회사의 수권주식수는 9,000,000천주이고, 1주당 액면금액은 5,000원입니다. 한편, 당분기말과 전기말 현재 보통주 발행주식수, 보통주자본금, 자본잉여금 및 기타자본의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원, 천주)		
구 분	당분기말	전기말
보통주 발행주식수(*1)	731,530	731,530
보통주자본금	3,657,652	3,657,652
자본잉여금:		
주식발행초과금	3,625,797	3,625,797
기타	762,615	750,201
합 계	4,388,412	4,375,998
기타자본:		
자기주식(*2)	(2,273,870)	(2,300,387)
주식선택권	7,032	8,011
기타	(19,031)	(19,032)
합 계	(2,285,869)	(2,311,408)
자기주식수	39,886	40,351

(*1) 당분기말 현재 과거 이익소각의 영향으로 인하여 상장주식 총수 728,002천주와 발행주식 총수에 차이가 있습니다.

(*2) 당분기 중 회사는 자기주식 465,149주를 처분하여 자기주식처분이익 12,414백만원이 발생하였습니다.

(2) 당분기말 및 전기말 현재 회사의 유통주식수는 다음과 같습니다.

(단위: 주)						
구 분	당분기말			전기말		
	상장주식수	자기주식	유통주식수	상장주식수	자기주식	유통주식수
상장주식수	728,002,365	39,886,176	688,116,189	728,002,365	40,351,325	687,651,040

20. 이익잉여금

당분기말과 전기말 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기말	전기말
법정적립금(*1)	618,395	535,877
임의적립금(*2)	235,506	235,506
미처분이익잉여금(*3)	49,174,733	53,641,827
합 계	50,028,634	54,413,210

(*1) 회사는 상법의 규정에 따라, 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 현금에 의한 이익배당금의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하고 있습니다. 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전에 사용가능합니다.

(*2) 임의적립금은 기술개발준비금으로 구성되어 있습니다.

(*3) 2023년 3월 29일자 주주총회에서 결의된 배당금 206,295백만원, 2023년 4월 19일 이사회에서 결의된 배당금 206,418백만원 및 2023년 7월 26일 이사회에서 결의된 배당금 206,427백만원이 전액 지급되었습니다.

21. 매출액

(1) 당분기와 전분기 중 매출액의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)				
구 분	당분기		전분기	
	3개월	누적	3개월	누적
제품의 판매	7,693,242	17,773,154	9,650,648	32,297,741
용역의 제공	44,482	133,483	37,717	129,910
합 계	7,737,724	17,906,637	9,688,365	32,427,651

(2) 당분기와 전분기 중 매출액의 품목별 세부내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)				
구 분	당분기		전분기	
	3개월	누적	3개월	누적
DRAM	5,666,703	12,846,100	7,249,404	23,871,164
NAND Flash	1,855,201	4,561,251	2,309,833	8,049,638
기타	215,820	499,286	129,128	506,849
합 계	7,737,724	17,906,637	9,688,365	32,427,651

(3) 당분기와 전분기 중 매출액의 수익인식 시기에 대한 구분내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)				
구 분	당분기		전분기	
	3개월	누적	3개월	누적
한 시점에 이행	7,693,242	17,773,154	9,650,648	32,297,741
기간에 걸쳐 이행	44,482	133,483	37,717	129,910
합 계	7,737,724	17,906,637	9,688,365	32,427,651

22. 판매비와관리비

당분기와 전분기 중 발생한 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)				
구 분	당분기		전분기	
	3개월	누적	3개월	누적
급여	101,773	272,510	135,663	458,992
퇴직급여	7,628	22,662	10,306	30,514
복리후생비	30,702	96,280	38,595	105,793
지급수수료	90,025	294,042	142,744	356,478
감가상각비	49,821	148,011	44,762	131,985
무형자산상각비	77,717	205,076	73,749	321,302
광고선전비	23,765	47,931	23,672	61,901
소모품비	31,483	67,774	23,645	63,086
품질관리비	61,111	28,521	32,986	447,190
기타	49,065	151,326	61,588	172,899
소 계	523,090	1,334,133	587,710	2,150,140
경상개발비:				
연구개발비 총지출액	920,465	2,699,170	997,324	3,032,422
개발비 자산화	(52,551)	(286,039)	(89,161)	(199,184)
소 계	867,914	2,413,131	908,163	2,833,238

판매비와관리비 합계	1,391,004	3,747,264	1,495,873	4,983,378
------------	-----------	-----------	-----------	-----------

23. 비용의 성격별 분류

당분기와 전분기 중 발생한 비용의 성격별 분류는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)				
구 분	당분기		전분기	
	3개월	누적	3개월	누적
제품 및 재공품의 변동	881,603	(43,501)	(1,485,519)	(3,099,181)
원재료, 저장품 및 소모품 사용	2,692,185	8,241,155	3,428,454	9,437,305
종업원급여비용	836,671	2,386,963	1,105,576	3,614,194
감가상각비 등	2,138,382	6,659,836	2,233,936	6,569,184
지급수수료	543,400	1,697,769	638,475	1,787,331
동력 및 수도광열비	442,274	1,384,870	394,687	1,076,768
수선비	183,627	562,842	270,598	798,228
외주가공비	457,664	1,390,081	497,111	1,410,648
기타영업비용	391,219	1,033,247	398,903	1,506,808
대체: 개발비자산화 등	(54,562)	(295,365)	(95,724)	(218,877)
합 계(*)	8,512,463	23,017,897	7,386,497	22,882,408

(*) 분기포괄손익계산서상의 매출원가와 판매비와관리비를 합산한 금액입니다.

24. 금융수익 및 금융비용

당분기와 전분기 중 금융수익 및 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)				
구 분	당분기		전분기	
	3개월	누적	3개월	누적
금융수익 :				
이자수익	199,716	547,181	112,512	215,239
배당금수익	2,356	118,033	95,572	124,135
외환차이	484,742	1,422,803	1,721,082	3,402,584
기타	530	12,765	9,813	23,830
소 계	687,344	2,100,782	1,938,979	3,765,788
금융비용 :				
이자비용	314,874	822,407	97,561	214,702
외환차이(*)	671,838	1,966,036	1,318,721	3,089,750
파생상품거래손실	-	58,985	-	-
기타	-	716	3,476	3,545
소 계	986,712	2,848,144	1,419,758	3,307,997
순금융손익	(299,368)	(747,362)	519,221	457,791

(*) 당분기 중 발생한 장기투자자산의 환율변동효과 282,667백만원(전분기 227,494백만원)이 포함되어 있습니다.

25. 기타영업외수익과 기타영업외비용

(1) 당분기와 전분기 중 기타영업외수익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)				
구 분	당분기		전분기	
	3개월	누적	3개월	누적
유형자산처분이익	221,111	224,563	21,434	173,898
투자부동산처분이익	-	-	-	64,418
종속기업및관계기업투자처분이익	13,662	49,217	7,502	20,206
기타	968	3,727	4,301	6,199
합 계	235,741	277,507	33,237	264,721

(2) 당분기와 전분기 중 기타영업외비용의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)				
구 분	당분기		전분기	
	3개월	누적	3개월	누적
유형자산처분손실	62,430	64,367	1,464	3,883
무형자산처분손실	2,965	5,665	1,395	3,133
기부금	2,629	28,403	13,434	44,375
무형자산손상차손	167,050	167,050	24,621	50,272
기타	845	3,390	2,827	10,860
합 계	235,919	268,875	43,741	112,523

26. 법인세비용

법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 경영진의 가중평균연간법인세율에 대한 최선의 추정에 기초하여 인식하였습니다. 법인세비용에는 과거기간 당기법인세에 대하여 당분기에 인식한 조정사항이 포함되어 있습니다.

27. 주당이익

주당이익은 보통주 및 희석성 잠재적 보통주 1주에 대한 순이익을 계산한 것으로 그 내역은 다음과 같습니다.

(1) 기본주당이익

(단위: 백만원, 주)				
구 분	당분기		전분기	
	3개월	누적	3개월	누적
보통주분기순이익(손실)	(739,653)	(3,742,914)	2,131,215	7,646,892
가중평균유통보통주식수(*)	688,106,870	688,024,496	687,651,040	687,644,127
기본주당이익(손실)	(1,075) 원	(5,440) 원	3,099 원	11,120 원

(*) 주당이익을 계산하기 위한 가중평균유통보통주식수의 산출근거는 다음과 같습니다.

(단위: 주)				
구 분	당분기		전분기	
	3개월	누적	3개월	누적
발행주식수	728,002,365	728,002,365	728,002,365	728,002,365
자기주식 효과	(39,895,495)	(39,977,869)	(40,351,325)	(40,358,238)
가중평균유통보통주식수	688,106,870	688,024,496	687,651,040	687,644,127

(2) 희석주당이익

(단위: 백만원, 주)				
구 분	당분기		전분기	
	3개월	누적	3개월	누적
보통주희석분기순이익(손실)	(739,653)	(3,742,914)	2,131,215	7,646,892
가중평균희석유통보통주식수(*)	688,106,870	688,024,496	687,770,455	687,805,980
희석주당이익(손실)	(1,075) 원	(5,440) 원	3,099 원	11,118 원

(*) 희석주당이익을 계산하기 위한 가중평균희석유통보통주식수의 산출근거는 다음과 같습니다.

(단위: 주)				
구 분	당분기		전분기	
	3개월	누적	3개월	누적
가중평균유통보통주식수	688,106,870	688,024,496	687,651,040	687,644,127
주식선택권 효과	-	-	119,415	161,853
가중평균희석유통보통주식수	688,106,870	688,024,496	687,770,455	687,805,980

28. 특수관계자 및 대규모기업집단 소속회사와 거래

(1) 당분기말 현재 특수관계자의 내역은 다음과 같습니다.

구 분	회사명
종속기업	SK hynix America Inc.외 59사(*1)
관계기업(*2)	Stratio, Inc., SK China Company Limited, Gemini Partners Pte. Ltd., TCL Fund, SK South East Asia Investment Pte. Ltd., Hushan Xinju (Chengdu) Venture Investment Center(Smartsource), 농업회사법인 푸르메소셜팜㈜, 우시시신평직점회로산업원유한공사, 미래에셋 위반도체 제1호창업벤처전문사모투자합작회사, 엘엔에스 10호 Early Stage III 투자조합, SiFive Inc., YD-SK-KDB 소셜밸류, Ningbo Zhongxin Venture Capital Partnership (Limited Partnership), 강소KVTS반도체과학기술유한회사, SAPEON INC.
공동기업(*3)	HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd., Hystars Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd., 반도체성장 전문투자형 사모투자신탁, 시스템반도체 상생 전문투자형 사모투자신탁, 반도체 생태계 일반 사모투자신탁
기타특수관계자	회사에 유의적인 영향력을 행사하는 SK스퀘어(주) 및 그 종속기업과 SK스퀘어 (주)의 지배기업인 SK(주)와 그 종속기업

(*1) 종속기업의 종속기업 등이 포함되어 있으며, 종속기업인 MMT(특정금전신탁)는 제외하였습니다.

(*2) 종속기업의 관계기업이 포함되어 있습니다.

(*3) 종속기업의 공동기업이 포함되어 있습니다.

(2) 당분기말 현재 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

회 사 명	지배기업	비고
에스케이하이이엔지(주)	회사	국내종속기업
에스케이하이시스템(주)	회사	국내종속기업
행복모아(주)	회사	국내종속기업
에스케이하이닉스시스템아이씨(주)	회사	국내종속기업
행복나래(주)	회사	국내종속기업
SK hynix America Inc.	회사	해외판매법인
SK hynix Deutschland GmbH	회사	해외판매법인
SK hynix Asia Pte. Ltd.	회사	해외판매법인
SK hynix Semiconductor Hong Kong Ltd.	회사	해외판매법인
SK hynix U.K. Ltd.	회사	해외판매법인
SK hynix Semiconductor Taiwan Inc.	회사	해외판매법인
SK hynix Japan Inc.	회사	해외판매법인
SK hynix Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd.	회사	해외판매법인
SK hynix Semiconductor India Private Ltd.	SK hynix Asia Pte. Ltd.	해외판매법인
SK hynix (Wuxi) Semiconductor Sales Ltd.	회사	해외판매법인
SK hynix Semiconductor (China) Ltd.	회사	해외제조법인
SK hynix Semiconductor (Chongqing) Ltd.	SK APTECH Ltd.	해외제조법인

SK hynix Italy S.r.l	회사	해외연구개발법인
SK hynix memory solutions America Inc.	SK hynix NAND Product Solutions Corp.	해외연구개발법인
SK hynix memory solutions Taiwan Ltd.	회사	해외연구개발법인
SK hynix memory solutions Eastern Europe LLC.	회사	해외연구개발법인
SK APTECH Ltd.	회사	해외투자법인
SK hynix Ventures Hong Kong Ltd.	회사	해외투자법인
SK hynix (Wuxi) Investment Ltd.	SK hynix Semiconductor (China) Ltd.	해외투자법인
SK hynix (Wuxi) Industry Development Ltd.	SK hynix (Wuxi) Investment Ltd.	해외기타법인
SK hynix Happiness (Wuxi) Hospital Management Ltd.	SK hynix (Wuxi) Investment Ltd.	해외기타법인
SK hynix system ic (Wuxi) Co., Ltd.	에스케이하이닉스시스템아이씨㈜	해외제조법인
SK hynix cleaning (Wuxi) Ltd.	SK hynix (Wuxi) Investment Ltd.	해외기타법인
SUZHOU HAPPYNARAE Co., Ltd.	행복나래㈜	해외기타법인
CHONGQING HAPPYNARAE Co., Ltd.	SUZHOU HAPPYNARAE Co., Ltd.	해외기타법인
SkyHigh Memory Limited	에스케이하이닉스시스템아이씨㈜	해외제조법인
SK hynix (Wuxi) Education Technology Co., Ltd.	SK hynix (Wuxi) Investment Ltd.	해외기타법인
Gauss Labs Inc.	회사	해외연구개발법인
SkyHigh Memory China Limited	SkyHigh Memory Limited	반도체 판매지원
SkyHigh Memory Limited Japan	SkyHigh Memory Limited	반도체 판매지원
SK hynix NAND Product Solutions Corp.	회사	해외 판매 및 연구개발 등
SK hynix NAND Product Solutions Taiwan Co., Ltd.	SK hynix NAND Product Solutions Corp.	반도체 연구개발 및 판매
SK hynix NAND Product Solutions Canada Ltd.	SK hynix NAND Product Solutions Corp.	반도체 연구개발
SK hynix NAND Product Solutions Mexico, S. DE R.L. DE C.V.	SK hynix NAND Product Solutions Corp.	반도체 연구개발
SK hynix Semiconductor (Dalian) Co., Ltd.	회사	반도체 제조
SK hynix NAND Product Solutions UK Limited	SK hynix NAND Product Solutions Corp.	반도체 판매
SK hynix NAND Product Solutions Israel Ltd.	SK hynix NAND Product Solutions Corp.	반도체 판매
SK hynix NAND Product Solutions Japan	SK hynix NAND Product Solutions Corp.	반도체 판매
SK hynix NAND Product Solutions International LLC	SK hynix NAND Product Solutions Corp.	반도체 판매
SK hynix NAND Product Solutions Asia Pacific LLC	SK hynix NAND Product Solutions Corp.	반도체 판매
SK hynix NAND Product Solutions Singapore Pte. Ltd.	SK hynix NAND Product Solutions Corp.	반도체 연구개발 및 판매
SK hynix NAND Product Solutions Malaysia Sdn. Bhd.	SK hynix NAND Product Solutions Corp.	반도체 판매
SK hynix (Wuxi) Education Service Development Co., Ltd.	SK hynix (Wuxi) Education Technology Co., Ltd.	교육법인
SK HYNIX NAND PRODUCT SOLUTIONS POLAND sp. z o.o.	SK hynix NAND Product Solutions Corp.	반도체 연구개발
SK hynix NAND Product Solutions (Beijing) Co., Ltd.	SK hynix NAND Product Solutions Corp.	반도체 판매
SK hynix NAND Product Solutions (Shanghai) Co., Ltd.	SK hynix NAND Product Solutions Corp.	반도체 연구개발
HappyNarae America LLC	행복나래㈜	해외 산업자재유통
HappyNarae Hungary Kft	행복나래㈜	해외 산업자재유통
SK hynix Ventures America LLC	회사	해외투자법인
Intel NDTM US LLC (*)	SK hynix NAND Product Solutions Corp.	반도체 연구개발
Intel Semiconductor Storage Technology (Dalian) Ltd.(*)	SK hynix NAND Product Solutions Corp.	반도체 제조
주식회사 키파운드리	회사	반도체 제조 및 판매
KEY FOUNDRY, INC.	주식회사 키파운드리	반도체 판매
KEY FOUNDRY SHANGHAI CO.,LTD.	주식회사 키파운드리	반도체 판매
KEY FOUNDRY LTD.	주식회사 키파운드리	반도체 판매

(*) 당분기말 현재 법적소유권은 인텔에게 있으며 2025년으로 예상되는 인텔 NAND사업부 문 2차 종결을 통하여 소유권을 획득할 예정이나 당분기말 현재 회사의 종속회사인 SK hynix NAND Product Solutions Corp.가 지배력을 보유하고 있다고 판단하여 종속기업으로 편입하였습니다.

(3) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 주요 거래내역은 다음과 같습니다.

① 당분기

(단위: 백만원)							
구 분	회사명	매출 등		매입 등		자산취득	
		3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적
종속기업	국내종속기업(*1)	53,464	145,813	241,272	674,701	4,076	16,304
	해외판매법인	7,484,745	17,400,542	89,141	265,104	90,195	255,139
	해외제조법인(*2)	179,975	498,561	1,469,420	4,515,447	-	4,495
	해외연구개발법인	28	472	41,482	131,436	-	-
공동기업	HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.	1,674	4,574	186,866	555,301	22,149	81,896
관계기업	SK China Company Limited	-	-	3,804	9,741	-	-
기타 특수관계자	SK텔레콤㈜	35	88	10,550	33,223	4,760	4,827
	SK㈜(*3)	3,887	11,254	63,835	201,268	17,788	20,905
	SK에코플랜트㈜	1	3	170	170	131,385	190,167
	SK에너지㈜	440	1,697	17,259	111,825	-	18,700
	SK네트웍스㈜	-	-	1,487	5,836	-	-
	에스케이엔필스㈜(구, 에스케이 씨솔믹스㈜)	-	-	22,428	85,728	-	28
	충청에너지서비스㈜	-	-	5,711	42,555	-	-
	SK스페셜티㈜(구, SK머티리얼즈 ㈜)	8	22	32,603	103,946	-	-
	SK실트론㈜	1,941	5,741	70,241	228,110	-	-
	SK머티리얼즈 에어플러스㈜	7	38	18,255	45,069	-	88,105
	Techdream Co., Ltd	-	-	23,981	85,846	-	-
	SK트리켄㈜	-	-	18,440	73,283	-	-
	SK쉴더스	76	212	27,363	69,039	3,768	3,770
	SK이노베이션㈜	-	-	14,122	55,682	-	35
	에스케이위탁관리부동산투자회 사㈜	-	-	2,253	5,430	-	-
	클린인더스트리얼위탁관리부동 산투자회사 주식회사	1,120,315	1,120,315	-	-	-	-
	SK E&S㈜	-	-	3,960	12,142	128	1,217
	SK LNG Trading Pte., Ltd.	-	-	88,341	179,172	-	14,143
	기타	2	4	14,650	44,747	97,339	98,758
합 계		8,846,598	19,189,336	2,467,634	7,534,801	371,588	798,489

(*1) 국내종속기업에 대한 매출 등에는 회사가 에스케이하이닉스시스템아이씨(주) 등 자회사에서 사용한 전기료 등을 대납한 후에 수령한 비용보전 금액이 포함되어 있습니다.

(*2) 해외제조법인에 대한 누적 영업수익 등에는 자산 처분액 8,126백만원이 포함되어 있습니다.

(*3) 당분기 중 발생한 SK브랜드 사용료가 포함되어 있습니다.

② 전분기

(단위: 백만원)							
-----------	--	--	--	--	--	--	--

구 분	회사명	매출 등		매입 등		자산취득	
		3개월	누적	3개월	누적	3개월	누적
종속기업	국내종속기업(*1)	66,316	142,204	249,823	739,720	27,605	79,072
	해외판매법인	9,632,740	32,114,015	112,723	316,696	266,631	1,355,298
	해외제조법인(*2)	108,676	284,891	1,781,855	4,958,573	15,752	34,733
	해외연구개발법인	26	81	55,304	170,227	-	-
공동기업	HITECH Semiconductor (Wuxi) Co.,Ltd.	371	449	173,617	495,359	6,221	14,040
관계기업	SK China Company Limited	-	-	4,285	9,194	-	-
기타 특수관계자	SK텔레콤(주)	10	62	10,283	25,344	4,808	8,435
	SK(주)(*3)	3,673	10,930	69,571	212,267	22,328	106,742
	SK에코플랜트(주)	2	5	-	-	428,468	1,316,233
	SK에코엔지니어링(주)	-	-	-	-	22,977	111,215
	SK에너지(주)	319	1,235	24,039	96,880	-	-
	SK네트웍스(주)	-	-	2,693	6,264	-	-
	에스케이씨솔믹스(주)	1	1	32,212	90,073	82	257
	충청에너지서비스(주)	-	-	6,697	36,286	9	9
	SK머티리얼즈(주)	1	1	47,454	128,372	-	-
	SK실트론(주)	2,011	5,447	65,085	159,903	-	-
	SK머티리얼즈 에어플러스(주)	87	514	34,682	98,947	-	5,751
	Techdream Co., Ltd.	-	-	57,341	138,299	-	-
	SK트리켄(주)	-	-	40,470	99,776	-	-
	SK철더스	63	190	20,947	66,235	3,322	5,567
	SK이노베이션(주)	3	3	15,035	57,548	-	39
	에스케이위탁관리부동산투자회사(주)	-	507,200	1,763	1,763	-	113,377
	기타	2	40	37,406	103,632	3,264	42,351
합 계		9,814,301	33,067,268	2,843,285	8,011,358	801,467	3,193,119

(*1) 매출 등에는 회사가 에스케이하이닉스시스템아이씨(주) 등 자회사에서 사용한 전기료 등을 대납한 후에 수령한 비용보전 금액이 포함되어 있습니다.

(*2) 해외제조법인에 대한 누적 매출 등에는 자산 처분액 76,159백만원(3개월: 2,596백만원)이 포함되어 있습니다.

(*3) 전분기 중 발생한 SK브랜드 사용료가 포함되어 있습니다.

(4) 당분기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권·채무 내역은 다음과 같습니다.

① 당분기말

(단위: 백만원)			
구 분	회사명	채 권	채 무
		매출채권 등	미지급금 등
종속기업	국내종속기업	12,409	80,936
	해외판매법인(*)	6,533,940	188,094
	해외제조법인(*)	8,518,672	1,530,382
	해외연구개발법인	2,292	23,188
공동기업	HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.	1,632	441,325
관계기업	SK China Company Limited	-	10,335
기타특수관계자	SK텔레콤(주)	-	10,341
	SK(주)	1,423	139,496
	SK에코플랜트(주)	-	153,920
	SK에너지(주)	75	31,020
	SK네트웍스(주)	-	7,129
	에스케이엔펄스(주)(구, 에스케이씨솔믹스(주))	-	28,389
	충청에너지서비스(주)	-	1,798
	SK스페셜티(주)(구, SK머티리얼즈(주))	3	19,123
	SK실트론(주)	138,779	33,646
	SK머티리얼즈 에어플러스(주)	3	519,921
	Techdream Co., Ltd.	-	1,394
	SK트리켄(주)	-	11,237
	SK월더스	25	23,078
	SK이노베이션(주)	28	5,439
	에스케이위탁관리부동산투자회사(주)	17,330	166,323
	SK E&S(주)	41,245	-
	SK LNG Trading Pte., Ltd.	-	45,929
	기타	3,984	116,791
합 계		15,271,840	3,589,234

(*) 매출채권 등에는 SK hynix Semiconductor (Dalian) Co., Ltd.등 자회사에 대한 대여금 잔액이 포함되어 있습니다.

② 전기말

(단위: 백만원)			
구 분	회사명	채 권	채 무
		매출채권 등	미지급금 등
종속기업	국내종속기업(*)	130,963	127,351
	해외판매법인(*)	3,679,945	551,490
	해외제조법인(*)	8,377,986	1,233,658
	해외연구개발법인	63	36,100
공동기업	HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.	68	389,625
관계기업	SK China Company Limited	-	12,144
기타특수관계자	SK텔레콤(주)	213	15,292
	SK(주)	1,345	193,033
	SK에코플랜트(주)	-	1,167,535
	SK에코엔지니어링(주)	-	166,191
	SK에너지(주)	62	41,114
	SK네트웍스(주)	-	9,868
	에스케이엔펄스(주)(구, 에스케이씨솔믹스(주))	-	38,124
	충청에너지서비스(주)	-	10,540
	SK스페셜티(주)(구, SK머티리얼즈(주))	-	18,965
	SK실트론(주)	971	37,359
	SK머티리얼즈 에어플러스(주)	3	457,182
	Techdream Co., Ltd	-	8,153
	SK트리켄(주)	-	14,782
	SK쉴더스	13	29,875
	SK이노베이션(주)	202	7,124
	SK스퀘어(주)	-	1,175
	에스케이위탁관리부동산투자회사(주)	17,330	177,311
	기타	-	30,702
합 계		12,209,164	4,774,693

(*) 매출채권 등에는 SK hynix Semiconductor (Dalian) Co., Ltd.등 자회사에 대한 대여금 잔액이 포함되어 있습니다.

(5) 주요 경영진에 대한 보상

주요 경영진은 회사의 계획·운영·통제에 대해 중요한 권한과 책임을 가진 등기 임원입니다. 종업원 용역의 대가로서 주요 경영진에게 지급되었거나 지급될 보상금액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)				
구 분	당분기		전분기	
	3개월	누적	3개월	누적
급여	1,888	4,987	1,283	4,610
퇴직급여	100	368	75	336
주식보상비용	(6,202)	(970)	2,767	5,646
합 계	(4,214)	4,385	4,125	10,592

(6) 당분기와 전분기 중 기업회계기준서 제1024호 '특수관계자 공시'에 따른 특수관계자 범위에 포함되지 않으나, 독점규제 및 공정거래법에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사와의 주요 거래액은 다음과 같습니다.

① 당분기

(단위: 백만원)					
구 분	회사명	매입 등		자산취득	
		3개월	누적	3개월	누적
대규모기업집단소속회사	SK케미칼(주)	75	822	-	-
	에스엠코어(주)	201	2,424	-	296
	기타	3	8	-	-
합 계		279	3,254	-	296

② 전분기

(단위: 백만원)					
구 분	회사명	매입 등		자산취득	
		3개월	누적	3개월	누적
대규모기업집단소속회사	SK케미칼(주)	354	1,045	-	-
	에스엠코어(주)	4,052	4,563	4,456	38,411
합 계		4,406	5,608	4,456	38,411

(7) 당분기말과 전기말 현재 기업회계기준서 제1024호 '특수관계자 공시'에 따른 특수관계자 범위에 포함되지 않으나, 독점규제 및 공정거래법에 따른 동일한 대규모기업집단 소속회사에 대한 채권·채무 내역은 다음과 같습니다.

① 당분기말

(단위: 백만원)		
구 분	회사명	채 무
		미지급금 등

대규모기업집단소속회사	SK케미칼(주)	-
	에스엠코어(주)	353
	기타	-
합 계		353

② 전기말

(단위: 백만원)		
구 분	회사명	채 무
		미지급금 등
대규모기업집단소속회사	SK케미칼(주)	69
	에스엠코어(주)	18,285
합 계		18,354

(8) 당분기 중 공동기업인 HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.과 체결한 신규리스계약에 따라 인식한 사용권자산과 리스부채는 각각 77,732백만원(전분기: 14,040백만원) 및 77,732백만원(전분기: 14,040백만원)이며, 당분기 중 공동기업인 HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.에게 지급한 리스료는 59,752백만원(전분기: 65,541백만원)입니다. 당분기 SK머티리얼즈 에어플러스(주) 등 기타특수관계자와 체결한 신규리스계약에 따라 인식한 사용권자산과 리스부채는 각각 132,870백만원(전분기: 143,586백만원) 및 132,870백만원(전분기: 214,593백만원)이며, 당분기 중 SK머티리얼즈 에어플러스(주) 등 기타특수관계자에게 지급한 리스료는 59,739백만원(전분기: 32,622백만원)입니다.

(9) 회사는 종속기업인 SK hynix Nand Product Solutions Corp.에 건물 건설 보증 및 임대차 보증을 위하여 USD 169백만의 지급보증을 제공하고 있습니다.

(10) 회사의 당분기 중 종속기업과 관계·공동기업 설립 및 추가 출자거래는 주식 9에서 설명하고 있습니다.

(11) 당분기와 전분기 중 특수관계자와의 자금거래는 다음과 같습니다.

① 당분기

(단위: 백만원)					
구 분	특수관계자 구분	대여금의 대여(*)	대여금의 회수	배당금수익	배당금지급
종속기업	국내종속기업	-	124,080	93,014	-
	해외판매법인	2,158,480	-	2,253	-
	해외제조법인	-	-	-	-
	해외연구개발법인	-	-	3,074	-
공동기업	HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.	-	-	15,863	-
	반도체성장 전문투자형 사모투자신탁	-	-	153	-
관계기업	매그너스 사모펀드	-	-	262	-
기타특수관계자	SK스퀘어㈜	-	-	-	131,490
합 계		2,158,480	124,080	114,619	131,490

(*) 당분기 중 SK hynix Semiconductor (Dalian) Co., Ltd. 및 SK hynix Nand Product Solutions Corp에 대여하였습니다.

② 전분기

(단위: 백만원)					
구 분	특수관계자 구분	대여금의 대여(*1)	대여금의 회수(*2)	배당금수익	배당금지급
종속기업	국내종속기업	-	-	5,000	-
	해외판매법인	430,440	-	100,474	-
	해외제조법인	5,016,440	551,050	-	-
	해외연구개발법인	-	-	493	-
공동기업	HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.	-	-	17,383	-
기타특수관계자	SK스퀘어㈜	-	-	-	312,654
합 계		5,446,880	551,050	123,350	312,654

(*1) 전분기 중 SK hynix Semiconductor (Dalian) Co., Ltd. 및 SK hynix Nand Product Solutions Corp에 대여하였습니다.

(*2) 전분기 중 SK hynix Semiconductor (China) Ltd. 대여금 일부를 회수하였습니다.

29. 우발부채와 약정사항

(1) 당분기말 현재 회사와 관련하여 계류 중인 중요한 소송사건 및 클레임 등의 내역은 다음과 같습니다.

① 북미지역 내 가격 담합 집단소송

2018년 4월 27일에 회사 및 회사의 종속기업인 SK hynix America Inc.를 상대로 주요 DRAM 업체들의 가격 담합에 대한 집단소송(피해대상기간: 2016년 6월 1일부터 2018년 2월 1일까지)이 미국 캘리포니아 북부 연방지방법원에 제기되었습니다. 이후유사한 집단소송들이 미국 캘리포니아 북부 연방지방법원 및 캐나다 브리티시컬럼비아 대법원, 퀘벡 지방법원, 온타리오 연방 및 지방법원에 제기되었습니다. 2020년 12월과 2021년 9월 미국 캘리포니아 북부 연방지방법원은 미국지역의 직접 및 간접구매자 집단이 제기한 주요 소송에 대해 1심 최종 기각 결정을 내렸고, 원고 측은 항소를 통해 이러한 결정에 불복하였으나, 당분기말 현재 미국 직접 구매자 및 간접 구매자 집단 소송은 모두 1심 기각 결정을 유지하는 것으로 최종 종료되었습니다.

한편 2021년 6월 및 2021년 11월 캐나다 퀘벡 지방법원 및 온타리오 연방법원이 캐나다 지역의 구매자 집단이 제기한 소송에 대해 1심 최종 기각 결정을 내렸으며 항소심에서도 1심 기각 결정 유지 판결이 내려졌습니다. 퀘벡 지방법원 소송은 항소심 판결을 끝으로 최종 종료되었고, 온타리오 연방법원 소송은 당분기 말 현재 대법원 상고 절차가 진행 중입니다.

② 중국 반독점법 위반 조사

2018년 5월 중국 국가시장감독관리총국은 주요 DRAM 업체들의 중국 내 매출거래와 관련하여, 중국 반독점법 위반이 있었는지에 대한 조사를 개시하였으며, 동 조사가 현재 진행 중에 있습니다. 당분기말 현재 회사는 동 조사의 최종결과를 예측할 수 없습니다.

③ 소송 및 특허 클레임 등

당분기말 현재 회사는 상기 소송 외에 지적재산권 등과 관련하여 여러 분쟁에 대응하고 있으며, 향후 자원의 유출가능성이 높고 손실 금액을 신뢰성 있게 추정할 수 있는 경우 동 금액을 부채로 인식하고 있습니다.

(2) HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd. ("HITECH")와 후공정서비스계약

회사는 HITECH와 후공정서비스를 공급받는 계약을 체결하고 있으며 서비스 제공 범위는 Package, Package Test, Module 등 입니다. 회사는 동 계약에 따라 HITECH 장비 우선 사용권을 보유하고, 후공정서비스 대가로 HITECH에 일정액의 약정수익을 보장하는 금액을 지급하고 있습니다.

(3) 당분기말 현재 담보제공자산 등의 현황은 다음과 같습니다.

(원화단위: 백만원, 외화단위: 외화 백만원)								
구 분	장부금액	담보설정액			담보채무액			비 고
		통 화	외화금액	원화금액	통 화	외화금액	원화금액	
기계장치	1,146,414	USD	945	1,270,836	USD	706	949,765	시설자금대출 관련
		KRW	-	450,000	KRW	-	533,333	

(4) 당분기말 현재 회사가 금융기관과 체결하고 있는 여신한도 거래의 주요 내역은 다음과

같습니다.

(원화단위: 백만원, 외화단위: 외화 백만단위)			
금융기관	약정사항	한도금액	
		통 화	금 액
하나은행 등	Usance 등 수입금융약정	USD	830
	Usance 등 수입 · 수출 포괄한도 약정	USD	1,470
	당좌차월	KRW	20,000
	상환청구권이 없는 매출채권팩토링약정	KRW	70,000

(5) 당분기말 현재 기표되지 않은 유형자산에 대한 구매 약정액은 11,763,626백만원(전기말 : 9,673,747백만원)입니다.

(6) KIOXIA Holdings Corporation(이하 "KIOXIA") 투자
장기투자자산에 포함된 BCPE Pangea Intermediate Holdings Cayman, L.P. 및 BCPE Pangea Cayman2 Limited에 대한 투자를 통한 KIOXIA 투자와 관련하여 지분취득일 이후 일정기간 동안 회사의 직 · 간접적인 KIOXIA 보유지분이 특정비율 이하로 제한됩니다. 또한, 회사는 동 기간동안 KIOXIA에 대한 이사임명권이 제한되며, 경영 및 영업 의사결정에 유의적인 영향력을 행사할 수 없습니다.

(7) 인텔 NAND 사업부 인수
회사는 2020년 중 인텔의 Non-Volatile Memory Solutions Group의 읍테인 사업을 제외한 NAND 사업 전체(이하 "인텔NAND사업")를 인수하는 영업양수도 계약을 체결하였습니다. 해당 사업은 해외 중속기업들을 통해 두 번에 나뉘어 이전되며, 양수도금액은 USD8,844백만으로 1차 지급 종결 후, 잔금 USD2,235백만은 2차 종결이 예상되는 2025년 3월까지 지급될 예정입니다. 본 거래의 2차 종결은 정부기관의 심의를 포함하여 계약에서 정한 선행조건 충족 여부에 따라 변경될 수 있으며, 특정 상황으로 계약 해지시 약정된 termination fee를 지급해야 합니다. 한편 회사는 2차 거래종결이 이루어지지 않을 가능성은 낮다고 판단하고 있습니다.

회사는 2021년 중 완료된 인텔 NAND 사업부문 인수 1차 종결과 관련하여 중국 경쟁당국(중국 국가시장감독관리총국)으로부터 해당 인수거래에 대한 기업결합승인을 취득하는 과정에서 향후 5년간 중국 eSSD 시장에서 합리적인 가격정책을 유지하고 생산량을 확대할 의무 및 중국 eSSD 시장에 제3의 경쟁사가 진입하는 것을 지원해 줄 의무 등을 주요 내용으로 하는 조건들을 부과받은 바 있습니다. 따라서, 회사는 향후 5년간 동 의무들을 준수하여야 하며, 5년 후 동 의무들을 면제해 줄 것을 신청할 수 있습니다. 회사가 이와 같은 신청을 할 경우 중국 경쟁당국은 중국 eSSD 시장에서의 경쟁상황을 고려하여 동 신청을 수용할지를 결정할 것입니다.

(8) 기업구매전용카드 약정계약
회사는 일부 금융기관과 체결한 기업구매전용카드 약정계약을 통해 국세 및 전기료를 결제하며, 해당 약정에 따른 신용 공여기간 종료일에 결제대금을 카드사에 지급하고 있습니다. 당분기말 현재 관련 미지급금은 1,241,831백만원입니다.

(9) 미국 상무부 산업안보국(BIS)은 2022년 10월 7일 고성능반도체의 중국 수출과 중국 내 반도체 생산 및 생산장비와 관련된 제한을 강화하는 신규 수출 규제를 발표하였습니다. 회사는 중국 내 반도체공장의 원활한 운영을 위해 미국 정부와 적극적으로 논의를 하였고, 2023년 10월 10일까지 1년 동안 위 수출규제의 적용을 유예 받았습니다. 이 후, 2023년 9월 29일 미국 상무부 산업안보국(BIS)은 현재 회사의 중국 내 반도체 공장을 VEU(Validated End-User, 검증된 사용자)로 지정하여 지정된 품목에 대하여는 별도의 허가절차 및 유효기간 없이 수입이 가능하도록 허가하였습니다.

30. 현금흐름표

(1) 당분기와 전분기 중 영업으로부터 창출된 현금흐름의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
분기순이익(손실)	(3,742,914)	7,646,892
조정항목:		
법인세비용(수익)	(2,107,076)	2,508,340
이자비용	822,407	214,702
이자수익	(547,181)	(215,239)
감가상각비	6,297,747	6,072,555
무형자산상각비	391,133	510,719
무형자산손상차손	167,050	50,272
퇴직급여	92,361	174,781
외화환산손실	1,352,495	2,454,197
유형자산처분이익	(224,563)	(173,898)
외화환산이익	(664,673)	(1,984,869)
기타	(50,284)	(205,698)
운전자본의 변동:		
매출채권의 감소(증가)	(238,192)	30,353
기타수취채권의 증가	(16,589)	(1,654)
재고자산의 증가	(25,616)	(3,493,539)
기타자산의 감소(증가)	103,575	(220,407)
매입채무의 증가	138,322	190,503
미지급금의 증가	271,001	112,421
기타지급채무의 증가(감소)	(1,055,882)	38,612
충당부채의 증가	11,174	457,435
기타부채의 감소	(75,814)	(104,032)
퇴직금의 지급	(264)	(1,169)
사외적립자산 납부	(130,000)	(60,000)
영업으로부터 창출된 현금	768,217	14,001,277

(2) 당분기와 전분기 중 유동성 대체를 제외한 중요한 현금의 유입·유출이 없는 거래는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)		
구 분	당분기	전분기
유형자산 관련 미지급금의 증가	-	1,908,224
지분법적용투자주식 관련 미지급금의 증가	-	1,099,439
지분법적용투자주식 관련 장기선급금의 감소	-	1,101,784
판매후리스계약 체결에 따른 차입금 감소	(342,070)	-

(3) 회사는 거래가 빈번하며 총금액이 크고 단기간에 만기가 도래하는 단기투자자산 및 MMT관련 종속기업투자주식 등으로 인한 현금의 유입과 유출 항목을 순증감액으로 표시하였습니다.

31. 주식기준보상

(1) 회사는 회사가 임직원에게 부여한 현금결제방식이나 주식결제방식을 선택할 수 있는 선택형 주식기준보상에 대해서는 실질에 따라 회계처리하고 있습니다. 당분기말 현재 주식선택권의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 주)								
구 분	총부여수량	소멸수량	행사수량	미행사수량	부여일	약정용역제공기간	행사가능기간	행사가격
1차	99,600	-	99,600	-	2017-03-24	2017.03.24~2019.03.24	2019.03.25~2022.03.24	48,400원
2차(*1)	99,600	-	99,600	-	2017-03-24	2017.03.24~2020.03.24	2020.03.25~2023.03.24	52,280원
3차	99,600	-	-	99,600	2017-03-24	2017.03.24~2021.03.24	2021.03.25~2024.03.24	56,460원
4차	7,747	-	7,747	-	2018-01-01	2018.01.01~2019.12.31	2020.01.01~2022.12.31	77,440원
5차(*1)	7,223	-	7,223	-	2018-03-28	2018.03.28~2020.03.28	2020.03.29~2023.03.28	83,060원
6차	8,171	8,171	-	-	2019-02-28	2019.02.28~2021.02.28	2021.03.01~2024.02.29	73,430원
7차(*1)	61,487	-	61,487	-	2019-03-22	2019.03.22~2021.03.22	2021.03.23~2024.03.22	71,560원
8차(*1)	61,487	-	61,487	-	2019-03-22	2019.03.22~2021.03.22	2022.03.23~2025.03.22	77,290원
9차	61,487	-	-	61,487	2019-03-22	2019.03.22~2022.03.22	2023.03.23~2026.03.22	83,470원
10차(*2)	54,020	10,764	-	43,256	2020-03-20	2020.03.20~2023.03.20	2023.03.21~2027.03.20	84,730원
11차	6,397	-	-	6,397	2020-03-20	2020.03.20~2023.03.20	2023.03.21~2027.03.20	84,730원
12차	6,469	-	-	6,469	2021-03-30	2021.03.30~2023.03.30	2023.03.31~2026.03.30	136,060원
13차(*2)	75,163	29,851	-	45,312	2021-03-30	2021.03.30~2023.03.30	2023.03.31~2026.03.30	136,060원
14차(*2)	195,460	19,621	-	175,839	2022-03-30	2022.03.30~2024.03.30	2024.03.31~2027.03.30	121,610원
합 계	843,911	68,407	337,144	438,360				

(*1) 당분기 중 현금결제 방식으로 행사되었습니다.

(*2) 당분기 중 15,001주의 주식선택권이 소멸되었습니다.

(2) 당분기말 현재 주가차액보상권에 대하여 인식한 부채는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)	
구 분	금 액
주가차액보상권 부채 총장부금액	7,644

(3) 공정가치 측정

이항모형을 적용하여 공정가액 접근법에 의한 보상원가를 산정하였으며, 주식기준보상제도의 당분기말 현재 공정가치를 측정하기 위하여 사용된 투입변수는 다음과 같습니다.

구 분	주가 (평가기준일 종가, 원)	기대주가변동성	주당공정가치(원)	배당수익률	무위험이자율 (국공채 수익률)
2차	85,000	33.00%	32,745	1.80%	3.51%
3차	85,000	33.00%	30,363	1.80%	3.77%
5차	85,000	33.00%	7,479	1.80%	3.55%
7차	85,000	33.00%	19,868	1.80%	3.77%
8차	85,000	33.00%	20,275	1.80%	3.69%
9차	85,000	33.00%	20,577	1.80%	3.74%
10차	85,000	33.00%	22,449	1.80%	3.75%
11차	85,000	33.00%	22,449	1.80%	3.75%
12차	85,000	33.00%	8,162	1.80%	3.75%
13차	85,000	33.00%	8,162	1.80%	3.75%
14차	85,000	33.00%	13,065	1.80%	3.75%

(4) 회사가 당분기 중 인식한 주식보상비용은 2,090백만원(전분기: 15,635백만원)입니다.

6. 배당에 관한 사항

가. 배당에 관한 정책

- 정관에 의거한 배당에 관한 당사의 중요한 정책은 다음과 같습니다.

(1) 제52조(이익배당)

- ① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.
- ② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
- ③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 주주총회 결의로 그와 다른 종류의 주식으로 배당 할 수 있다.

(2) 제54조의2 (분기배당)

- ① 회사는 사업연도 개시일로부터 3월, 6월 및 9월 말일의 주주에게 자본시장과 금융투자에 관한 법률의 규정에 의한 분기배당을 금전으로 할 수 있다.
- ② 제1항의 분기배당은 이사회결의로 하되, 분기배당의 구체적인 방법, 한도 등에 대해서는 자본시장과 금융투자에 관한 법률, 상법 등 관련 법령에서 정하는 바에 따른다.
- ③ 사업연도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권행사를 포함한다.) 해당 신주에 대한 분기배당에 관하여는 신주가 발행한 때가 속하는 분기의 직전 분기 말에 발행된 것으로 본다.
- ④ 분기배당에 대해서는 제10조의3이 적용되지 않고 본조 제3항이 우선하여 적용된다.
- ⑤ 분기배당을 할 때에는 종류주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.
- ⑥ 제53조는 분기배당의 경우에 준용한다.

당사는 제74기 정기주주총회를 통해 분기 배당 실시를 위한 상기 정관을 신설하였습니다.
(제54조의2 (분기배당) 신설)

- 당사는 2022년 1월 이사회를 통해 2022년부터 2024년까지 적용될 신규 주주환원정책을 다음과 같이 수립하였습니다.

당사는 배당의 예측 가능성을 확보하고, 실적의 변동성을 반영하기 위한 「2022~2024년 주주환원정책」을 다음과 같이 수립하여 공시하였습니다.

* 관련 공시 : 2022년 1월 28일 수시공시의무관련사항(공정공시)

[2022~2024 사업연도의 연간 현금배당 산식]

주당 1,200원 (고정배당금) + 연간 Free Cash Flow의 5% 지급
(연간 Free Cash Flow가 마이너스(-)일 경우, 고정배당금만 지급)

[Free Cash Flow 산식]

결산기 연결기준 현금흐름표 상의 영업현금흐름 - 유형자산취득금액

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

※ 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기
		제76기 3분기	제75기	제74기
주당액면가액(원)		5,000	5,000	5,000
(연결)당기순이익(백만원)		-7,755,323	2,229,560	9,602,316
(별도)당기순이익(백만원)		-3,742,914	2,790,457	9,567,226
(연결)주당순이익(원)		-11,272	3,242	13,989
현금배당금총액(백만원)		619,280	825,181	1,058,936
주식배당금총액(백만원)		-	-	-
(연결)현금배당성향(%)		-	37.0	11.0
현금배당수익률(%)	보통주	0.8	1.5	1.2
	우선주	-	-	-
주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-
	우선주	-	-	-
주당 현금배당금(원)	보통주	900	1,200	1,540
	우선주	-	-	-
주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-
	우선주	-	-	-

주1) 상기 금액은 연결 재무제표 기준이며, 연결 당기순이익 및 연결 현금배당성향은 지배기업소유주 지분 귀속 당기순이익으로 산정하였습니다.

주2) 제76기 3분기 (연결)현금배당성향(%)의 경우, 지배기업소유주지분 연결당기순손실을 기록함에 따라 음수가 산출되어 기재를 생략하였습니다.

주3) 분기배당금은 제76기 1분기 206,418백만원(주당 300원), 2분기 206,427백만원(주당 300원), 3분기 206,435백만원(주당 300원)입니다.

다. 과거 배당 이력

(단위: 회, %)

연속 배당횟수		평균 배당수익률	
분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간
6	9	1.3	1.5

주1) 배당수익률 : 제75기 1.5%, 제74기 1.2%, 제73기 1.0%, 제72기 1.1%, 제71기 2.5%주2) 평균 배당수익률은 단순 평균법으로 계산하였으며, 최근 3년간은 제73기(2020년)부터 제75기(2022년)까지, 최근 5년간은 제71기(2018년)부터 제75기(2022년)까지 기간입니다.

주3) 연속 배당 횟수는 당기 분기배당 및 최근사업연도 결산배당을 포함하고 있습니다.

주4) 당사 결산배당은 제67기(2014년)부터 연속 결산배당 중이며, 분기배당은 제75기(2022년) 1분기부터 시작하였습니다.

7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항

7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 09월 30일) (단위 : 원, 주)

주식발행 (감소)일자	발행(감소) 형태	발행(감소)한 주식의 내용				
		종류	수량	주당 액면가액	주당발행 (감소)가액	비고
-	-	-	-	-	-	-

※ 당사는 최근 5년간 자본금 변동사항이 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

나. 채무증권 발행실적 등

※ 연결 기준이며, 개별 기준은 연결 기준과 동일

(1) 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 09월 30일) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자 등록)총액	이자율	평가등급 (평가기관)	만기일	상환 여부	주관회사
SK하이닉스(주)	회사채	사모	2023년 01월 17일	1,008,600	6.25	BBB-(S&P) Baa2 (Moody's)	2026년 01월 17일	미상환	BNP Paribas, Merrill Lynch, Citigroup, Credit Agricole, HSBC, MUFG, Standard Chartered
SK하이닉스(주)	회사채	사모	2023년 01월 17일	1,344,800	6.38	BBB-(S&P) Baa2 (Moody's)	2028년 01월 17일	미상환	BNP Paribas, Merrill Lynch, Citigroup, Credit Agricole, HSBC, MUFG, Standard Chartered
SK하이닉스(주)	회사채	사모	2023년 01월 17일	1,008,600	6.50	BBB-(S&P) Baa2 (Moody's)	2033년 01월 17일	미상환	BNP Paribas, Merrill Lynch, Citigroup, Credit Agricole, HSBC, MUFG, Standard Chartered
SK하이닉스(주)	회사채	공모	2023년 02월 14일	430,000	3.83	AA0 (NICE신평/한기평/한신평)	2026년 02월 13일	미상환	에스케이증권, 한국투자증권, 엔에이치투자증권
SK하이닉스(주)	회사채	공모	2023년 02월 14일	780,000	4.27	AA0 (NICE신평/한기평/한신평)	2028년 02월 14일	미상환	에스케이증권, 한국투자증권, 엔에이치투자증권
SK하이닉스(주)	회사채	공모	2023년 02월 14일	100,000	4.52	AA0 (NICE신평/한기평/한신평)	2030년 02월 14일	미상환	에스케이증권, 한국투자증권, 엔에이치투자증권
SK하이닉스(주)	회사채	공모	2023년 02월 14일	80,000	4.90	AA0 (NICE신평/한기평/한신평)	2033년 02월 14일	미상환	에스케이증권, 한국투자증권, 엔에이치투자증권
SK하이닉스(주)	회사채	사모	2023년 02월 17일	403,440	3M Sofr +1.70%	Baa2 (Moody's)	2025년 11월 17일	미상환	HSBC
SK하이닉스(주)	기업어음증권	사모	2023년 02월 20일	150,000	4.19	A1 (NICE신평/한기평/한신평)	2023년 03월 31일	상환	신한은행
SK하이닉스(주)	기업어음증권	사모	2023년 04월 03일	150,000	4.26	A1 (NICE신평/한기평/한신평)	2023년 06월 30일	상환	신한은행
SK하이닉스(주)	기업어음증권	사모	2023년 04월 03일	150,000	4.26	A1 (NICE신평/한기평/한신평)	2023년 06월 30일	상환	신한은행

SK하이닉스(주)	회사채	사모	2023년 04월 11일	2,286,160	1.75	Baa2 (Moody's)	2030년 04월 11일	미상환	Merrill Lynch International
SK하이닉스(주)	기업어음증권	사모	2023년 06월 30일	150,000	4.42	A1 (NICE신평/한기평/한신평)	2023년 09월 27일	상환	신한은행
SK하이닉스(주)	기업어음증권	사모	2023년 06월 30일	150,000	4.42	A1 (NICE신평/한기평/한신평)	2023년 09월 27일	상환	신한은행
SK하이닉스(주)	기업어음증권	사모	2023년 07월 26일	120,000	4.41	A1 (NICE신평/한기평/한신평)	2024년 07월 24일	미상환	에스케이증권
SK하이닉스(주)	기업어음증권	사모	2023년 07월 26일	50,000	4.31	A1 (NICE신평/한기평/한신평)	2024년 01월 25일	미상환	에스케이증권
SK하이닉스(주)	기업어음증권	사모	2023년 07월 26일	130,000	4.40	A1 (NICE신평/한기평/한신평)	2024년 06월 26일	미상환	에스케이증권
SK하이닉스(주)	기업어음증권	사모	2023년 07월 27일	100,000	4.40	A1 (NICE신평/한기평/한신평)	2024년 06월 27일	미상환	에스케이증권
SK하이닉스(주)	기업어음증권	사모	2023년 08월 16일	100,000	4.43	A1 (NICE신평/한기평/한신평)	2024년 08월 12일	미상환	에스케이증권
SK하이닉스(주)	기업어음증권	사모	2023년 09월 07일	150,000	4.86	A1 (NICE신평/한기평/한신평)	2023년 10월 16일	미상환	신한은행
SK하이닉스(주)	기업어음증권	사모	2023년 09월 07일	150,000	4.86	A1 (NICE신평/한기평/한신평)	2023년 12월 07일	미상환	신한은행
합 계	-	-	-	8,991,600	-	-	-	-	-

※ 2023년 1월 17일, 2023년 2월 17일, 2023년 4월 11일 발행한 회사채는 외화표시사채이며, 2023년 9월 말 환율(\$1 = 1,344.80원)을 적용하여 환산하였습니다.

※ 2023년 2월 17일 발행한 회사채는 변동금리채권으로 약정서 상의 금리 조건을 기재하였습니다.

(2) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2023년 09월 30일)

(단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사
제219-2회 무보증원화 공모사채	2018년 08월 27일	2025년 08월 27일	90,000	2018년 08월 14일	DB금융투자주식회사 CM금융2팀 (02-369-3384)

(이행현황기준일 : 2023년 09월 30일)

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지
	이행현황	이행
담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하
	이행현황	이행
자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 이상의 자산 처분 금지
	이행현황	이행
지배구조변경제한	계약내용	지배구조 변경사유 발생 금지
	이행현황	발생 없음
이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023.09.12 제출

(작성기준일 : 2023년 09월 30일)

(단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리	사채관리회사
-----	-----	-----	-----	------	--------

				계약체결일	
제220-2회 무보증원화 공모사채	2019년 05월 09일	2024년 05월 09일	200,000	2019년 04월 25일	DB금융투자주식회사 CM금융2팀 (02-369-3384)
제220-3회 무보증원화 공모사채	2019년 05월 09일	2026년 05월 09일	120,000	2019년 04월 25일	DB금융투자주식회사 CM금융2팀 (02-369-3384)
제220-4회 무보증원화 공모사채	2019년 05월 09일	2029년 05월 09일	250,000	2019년 04월 25일	DB금융투자주식회사 CM금융2팀 (02-369-3384)

(이행현황기준일 : 2023년 09월 30일)

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지
	이행현황	이행
담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하
	이행현황	이행
자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 이상의 자산 처분 금지
	이행현황	이행
지배구조변경제한	계약내용	지배구조 변경사유 발생 금지
	이행현황	발생 없음
이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023.09.12 제출

(작성기준일 : 2023년 09월 30일)

(단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사
제221-2회 무보증원화 공모사채	2020년 02월 14일	2025년 02월 14일	360,000	2020년 02월 04일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)
제221-3회 무보증원화 공모사채	2020년 02월 14일	2027년 02월 14일	130,000	2020년 02월 04일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)
제221-4회 무보증원화 공모사채	2020년 02월 14일	2030년 02월 14일	230,000	2020년 02월 04일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

(이행현황기준일 : 2023년 09월 30일)

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지
	이행현황	이행
담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하
	이행현황	이행
자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 이상의 자산 처분 금지
	이행현황	이행
지배구조변경제한	계약내용	지배구조 변경사유 발생 금지
	이행현황	발생 없음
이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023.09.12 제출

(작성기준일 : 2023년 09월 30일)

(단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사
제223-1회 무보증원화 공모사채	2021년 04월 13일	2024년 04월 12일	550,000	2021년 04월 01일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)
제223-2회 무보증원화 공모사채	2021년 04월 13일	2026년 04월 13일	360,000	2021년 04월 01일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)
제223-3회 무보증원화 공모사채	2021년 04월 13일	2028년 04월 13일	80,000	2021년 04월 01일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)
제223-4회 무보증원화 공모사채	2021년 04월 13일	2031년 04월 13일	190,000	2021년 04월 01일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

(이행현황기준일 : 2023년 09월 30일)

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지
	이행현황	이행
담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하
	이행현황	이행
자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 이상의 자산 처분 금지
	이행현황	이행
지배구조변경제한	계약내용	지배구조 변경사유 발생 금지
	이행현황	발생 없음
이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023.09.12 제출

(작성기준일 : 2023년 09월 30일)

(단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사
제224-1회 무보증원화 공모사채	2023년 02월 14일	2026년 02월 13일	430,000	2023년 02월 02일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)
제224-2회 무보증원화 공모사채	2023년 02월 14일	2028년 02월 14일	780,000	2023년 02월 02일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)
제224-3회 무보증원화 공모사채	2023년 02월 14일	2030년 02월 14일	100,000	2023년 02월 02일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)
제224-4회 무보증원화 공모사채	2023년 02월 14일	2033년 02월 14일	80,000	2023년 02월 02일	한국증권금융(주) 신탁부문 회사채관리팀 (02-3770-8556)

(이행현황기준일 : 2023년 09월 30일)

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지
	이행현황	이행
담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하
	이행현황	이행
자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 100% 이상의 자산 처분 금지
	이행현황	이행
지배구조변경제한	계약내용	지배구조 변경사유 발생 금지
	이행현황	발생 없음

(3) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일)

(단위 : 백만원)

잔여만기		10일 이하	10일초과 30일이하	30일초과 90일이하	90일초과 180일이하	180일초과 1년이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년 초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	0
	사모	-	250,000	150,000	50,000	450,000	-	-	-	900,000
	합계	-	250,000	150,000	50,000	450,000	-	-	-	900,000

(4) 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일)

(단위 : 백만원)

잔여만기		10일 이하	10일초과 30일이하	30일초과 90일이하	90일초과 180일이하	180일초과 1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(5) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일)

(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과	합 계
미상환 잔액	공모	750,000	450,000	910,000	130,000	860,000	850,000	-	3,950,000
	사모	1,344,800	-	2,756,840	-	1,344,800	4,709,560	100,000	10,256,000
	합계	2,094,800	450,000	3,666,840	130,000	2,204,800	5,559,560	100,000	14,206,000

※ 외화표시사채는 2023년 9월말 환율(\$1 = 1,344.80원) 적용하여 환산하였습니다.

(6) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일)

(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과 15년이하	15년초과 20년이하	20년초과 30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(7) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일)

(단위 : 백만원)

잔여만기		1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과 20년이하	20년초과 30년이하	30년초과	합 계
미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

[공모자금의 사용내역]

(기준일 : 2023년 09월 30일)

(단위 : 백만원)

구 분	회사	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획		실제 자금사용 내역		차이발생 사유 등
			사용용도	조달금액	내용	금액	
회사채	제223-1회	2021년 04월 13일	운영자금	350,000	운영자금	350,000	-
회사채	제223-1회	2021년 04월 13일	채무상환자금	200,000	채무상환자금	200,000	-
회사채 (사회적채권)	제223-2회	2021년 04월 13일	운영자금 (취약계층, 지역사회 지원 / 중 소·중견 협력사 동반성장을 위 한 금융, 운영 지원)	360,000	운영자금 (취약계층, 지역사회 지원 / 중 소·중견 협력사 동반성장을 위 한 금융, 운영 지원)	360,000	-
회사채 (사회적채권)	제223-3회	2021년 04월 13일	시설자금 (산업재해 예방 시설투자)	80,000	시설자금 (산업재해 예방 시설투자)	80,000	-
회사채	제223-4회	2021년 04월 13일	운영자금	60,000	운영자금	60,000	-
회사채	제223-4회	2021년 04월 13일	채무상환자금	130,000	채무상환자금	130,000	-
회사채	제224-1회	2023년 02월 14일	채무상환자금	430,000	채무상환자금	430,000	-
회사채	제224-2회	2023년 02월 14일	채무상환자금	780,000	채무상환자금	691,350	상환기일 미도래, 은행예금, MMT 등 안정성 높은 금융상품 통해 운용
회사채	제224-3회	2023년 02월 14일	채무상환자금	100,000	채무상환자금	100,000	-
회사채	제224-4회	2023년 02월 14일	채무상환자금	80,000	채무상환자금	80,000	-

※ 증권신고서 등의 자금사용 계획: 증권신고서 공시 기준 명칭으로 기재

※ 국내 증권신고서를 제출하지 않은 해외사채는 기재 제외함

※ 2021.4.13 발행된 제223-2회 회사채는 ESG채권(사회적채권)으로, 취약계층, 지역사회 지원 및 중소·중견 협력사 동반 성장을 위한 금융, 운영 지원 등을 위하여 발행되었으며, 당초 계획대로 취약계층, 지역사회 지원 및 중소·중견 협력사 동반 성장을 위한 금융, 운영 지원 목적으로 사용되었습니다. 본 ESG채권의 구체적인 자금사용내역은 한국거래소의 사회적책임투자(SRI) 채권 전용세그먼트에 게시된 ESG채권 사후보고서를 참고하시기 바랍니다.

※ 2021.4.13 발행된 제223-3회 회사채는 ESG채권(사회적채권)으로, 방호/소방 시설, 화학물질 관리 등 안전·보건 시설 투자 등을 위해 발행되었으며, 당초 계획대로 방호/소방 시설, 화학물질 관리 등 안전·보건 시설 투자 목적으로 사용되었습니다. 본 ESG채권의 구체적인 자금사용내역은 한국거래소의 사회적책임투자(SRI) 채권 전용세그먼트에 게시된 ESG채권 사후보고서를 참고하시기 바랍니다.

(2) 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2023년 09월 30일)

(단위 : 백만원)

구 분	회사	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획		실제 자금사용 내역		차이발생 사유 등
			사용용도	조달금액	내용	금액	
회사채	-	2023년 04월 11일	운영자금	2,237,710	웨이퍼 등 원부자재 구매	2,237,710	-

8. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항

(1) 재무제표 재작성

당사는 제74기(2021년) 중 인텔 NAND사업 인수 관련 자산과 부채의 공정가치 평가를 완료할 수 없었으므로 평가액을 잠정치로 보고하였으며, 제75기(2022년) 중 재측정한 공정가치 결과를 반영하여 비교표시된 연결재무제표를 재작성한 바 있습니다. 자세한 내용은 다음과 같습니다.

① 전년 동기(제75기 3분기) 연결포괄손익계산서에 미치는 영향

(단위: 백만원)			
계정과목	종전 기준에 따른 금액	조 정(*)	제75기 3분기
매출	36,949,537	-	36,949,537
매출원가	21,324,758	20,342	21,345,100
매출총이익	15,624,779	(20,342)	15,604,437
판매비와관리비	6,916,988	(34,197)	6,882,791
영업이익	8,707,791	13,855	8,721,646
금융수익	4,178,889	-	4,178,889
금융비용	4,615,888	-	4,615,888
지분법투자 관련 손익	119,245	-	119,245
기타영업외수익	214,249	-	214,249
기타영업외비용	180,065	-	180,065
법인세비용차감전순이익	8,424,221	13,855	8,438,076
법인세비용	2,461,820	-	2,461,820
분기순이익	5,962,401	13,855	5,976,256
총포괄손익	8,025,820	15,666	8,041,486
기본주당순이익	8,663	20	8,683
희석주당순이익	8,661	20	8,681

(*) 사업결합에 대한 회계처리가 2021년말까지 완료되지 않았으며, 잠정금액으로 2021년 연결재무제표에 보고하였습니다. 2022년 중 취득일 현재 존재하던 사실과 상황에 대하여 새롭게 입수한 정보를 토대로 취득일에 인식된 잠정금액을 소급하여 조정함으로써 사업결합 회계처리를 완료하였습니다. 비교표시된 전분기연결포괄손익계산서는 동 조정사항이 반영되어 재작성된 분기연결포괄손익계산서입니다.

(2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도에 관한 사항

당사는 2020년 10월, 인텔의 Non-Volatile Memory Solutions Group의 읍테인 사업부를 제외한 NAND 사업 부문 전체를 인수하는 영업양수도 계약을 체결한 바 있으며, 2021년 12월 중 NAND 사업부문 인수 1단계 절차를 완료하였습니다.

재무제표에 미치는 영향은 'III. 재무에 관한 사항'의 '5. 재무제표 주석' 등을 참조하시기 바랍니다.

거래상대방	Intel Corporation
계약 유형	영업양수도
계약 체결일	2020년 10월 20일 체결
목적 및 내용	Intel의 NAND 사업 영업양수
기타 주요내용	계약금액은 US\$90억이며, 2차에 걸쳐 지급될 예정

※ 상기 영업양수도에 관한 상세한 내용은 2020년 10월 22일 정정공시된 '주요사항보고서(영업양수 결정)'를 참고하시기 바랍니다.

(3) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항

- 당사는 2022년 6월 30일 에스케이위탁관리부동산투자회사에 분당 SK-U타워를 5,072억 원에 매각하고 책임임대차 전환을 완료하였습니다. 임대차 기간은 2022년 6월 30일부터 2027년 6월 30일까지 5년이며 (임대차 보증금 17,330백만원, 월 임차료 1,733백만원), 계약 종료 전 임대차 계약을 5년 연장할 수 있는 연장 선택권을 보유하고 있습니다. 한편, 당사는 임대인의 건물 매각 시 공정가액에 매입할 수 있는 우선매수협상권을 보유하고 있습니다.

- 당사는 2023년 9월 25일 클린인더스트리얼위탁관리부동산투자회사에 수처리센터를 1,120,315백만원에 매각하고 책임임대차 전환을 완료하였습니다. 임대차 기간은 2023년 9월 25일부터 2033년 9월 25일까지 10년(임대차 보증금 143,448백만원, 월 임차료 5,977백만원)이며, 계약 종료 전 임대차 계약을 10년 연장할 수 있는 연장 선택권을 보유하고 있습니다. 한편, 당사는 임대인의 건물 매각 시 공정가액에 매입할 수 있는 우선매수협상권을 보유하고 있습니다.

당사의 중요한 소송사건 및 채무보증 현황은 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항' 중 '2. 우발부채 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

(4) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항

※ 감사보고서(검토보고서)상 강조사항과 핵심감사사항

구분	강조사항 등	핵심감사사항
----	--------	--------

제76기 3분기	(연결재무제표) 연결회사의 인텔 NAND사업 인수에 대한 사업결합 회계처리를 잠정금액으로 2021년 연결재무제표에 보고하였으며, 2022년 중 취득일에 인식된 잠정금액을 소급하여 조정함 비교표시된 2022년 9월 30일로 종료되는 3개월 및 9개월 보고기간의 요약 반기연결포괄손익계산서와 6개월 보고기간의 요약 분기연결포괄손익계산서와 9개월 보고기간의 요약 분기연결자본변동표, 요약 분기 연결현금흐름표는 동 조정사항이 반영되어 재작성됨	-
제75기	(연결재무제표) 연결회사는 전기 중 인텔 NAND사업 인수 관련 자산과 부채의 공정가치 평가를 완료할 수 없었으므로 평가액을 잠정치로 보고하였으며, 당기 중 재측정한 공정가치 결과를 반영하여 비교표시된 전기 연결재무제표를 재작성함	가. (별도·연결재무제표) 장기투자자산에 포함된 KIOXIA Holdings Corporation 투자관련 금융자산의 공정가치 평가 나. (별도·연결재무제표) 기계장치의 감가상각개시시점에 대한 적정성 검토 다. (연결재무제표) 현금창출단위의 손상평가 라. (별도재무제표) 종속기업, 관계기업 및 공동기업투자에 포함된 SK hynix NAND Product Solution Corp. 및 SK hynix Semiconductor (Dalian) Co., Ltd. 주식 회수가능액 검토
제74기	해당사항 없음	(별도·연결 재무제표) 가. 장기투자자산에 포함된 KIOXIA Holdings Corporation 투자관련 금융자산의 공정가치 평가 나. 기계장치의 감가상각개시시점에 대한 적정성 검토

나. 부문별 연결재무정보

(1) 사업부문별 연결재무정보

당사는 반도체 제조업 부문의 매출액과 자산 총액이 전체 부문의 90%를 초과하여 지배적 단일 사업부문으로써 부문별 기재를 생략합니다.

(2) 지역별 재무 정보 (법인소재지 기준)

(단위 : 백만원)

구 분	제 76기 3분기	제 75기	제 74기
본국(대한민국)			
1. 매출액			
외부매출액	1,462,284	1,225,765	1,461,982
지역간내부매출액	18,062,363	39,010,691	42,417,947
계	19,524,647	40,236,456	43,879,929
2. 영업이익	(5,134,546)	7,814,247	12,405,136
3. 자산	96,259,924	94,335,798	86,619,108
중국			
1. 매출액			
외부매출액	6,621,007	12,210,470	15,730,223
지역간내부매출액	4,858,896	7,326,957	6,014,342
계	11,479,903	19,537,427	21,744,565

2. 영업이익	18,505	414,142	9,387
3. 자산	29,556,317	30,480,233	31,499,237
아시아			
1. 매출액			
외부매출액	3,059,423	5,615,384	7,022,929
지역간내부매출액	70,081	77,878	75,745
계	3,129,504	5,693,262	7,098,674
2. 영업이익	15,366	22,319	15,473
3. 자산	1,278,827	1,025,339	1,863,747
미국			
1. 매출액			
외부매출액	9,735,746	23,960,980	17,144,323
지역간내부매출액	302,873	545,219	219,806
계	10,038,619	24,506,199	17,364,129
2. 영업이익	(3,050,831)	(1,552,573)	91,944
3. 자산	3,444,509	3,659,967	4,583,865
유럽			
1. 매출액			
외부매출액	581,754	1,608,969	1,638,335
지역간내부매출액	97,318	58,923	54,164
계	679,072	1,667,892	1,692,499
2. 영업이익	1,837	7,827	3,536
3. 자산	396,487	417,649	554,592
합계			
1. 매출액			
외부매출액	21,460,214	44,621,568	42,997,792
지역간내부매출액	23,391,531	47,019,668	48,782,004
계	44,851,745	91,641,236	91,779,796
2. 영업이익			
연결조정	73,322	103,456	(115,136)
계	(8,076,347)	6,809,417	12,410,340
3. 자산			
연결조정	(28,886,615)	(26,047,474)	(28,774,024)
계	102,049,449	103,871,512	96,346,525

다. 대손충당금 설정현황

(1) 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위 : 백만원, %)

구 분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금 설정비율
제76기 3분기	매출채권	5,523,874	8,577	0.16%
	장·단기 대여금	290,057	0	0.00%
	장·단기 미수금	284,067	1,313	0.46%
	장·단기 미수수익	9,645	0	0.00%
	장·단기 보증금	269,231	102	0.04%
	장단기성 예치금	1,272	1,018	80.01%
	계	6,378,146	11,010	0.17%
제75기 연간	매출채권	5,187,164	1,110	0.02%
	장·단기 대여금	294,904	0	0.00%
	장·단기 미수금	195,831	1,313	0.67%
	장·단기 미수수익	5,352	0	0.00%
	장·단기 보증금	131,766	102	0.08%
	장단기성 예치금	1,200	959	79.92%
	계	5,816,217	3,484	0.06%
제74기 연간	매출채권	8,268,072	961	0.01%
	장·단기 대여금	303,404	0	0.00%
	장·단기 미수금	119,398	1,275	1.07%
	장·단기 미수수익	2,252	0	0.00%
	장·단기 보증금	87,073	101	0.12%
	장단기성 예치금	1,259	1,029	81.72%
	계	8,781,458	3,366	0.04%

※ 한국채택국제회계기준에 따라 연결기준으로 작성되었습니다.

(2) 대손충당금 변동현황

(단위 : 백만원)

구 분	제76기 3분기	제75기	제74기
1. 기초 대손충당금 잔액 합계	3,484	3,366	2,476
2. 순대손처리액(①-②±③)	-	-	-
① 대손처리액(상각채권액)	-	-	-
② 상각채권 회수액	-	-	-
③ 기타증감액	-	-	-
3. 대손상각비 계상(환입)액	7,526	118	890
4. 기말 대손충당금 잔액 합계	11,010	3,484	3,366

(3) 매출채권 관련 대손충당금 설정방침

- 거래선별 실제 회수가능성을 검토하여 개별 설정

구분		설정 기준
매출채권	1)정상채권	-과거 경험율을 바탕으로 설정
	2)장기채권	-거래선별 실제 회수가능성을 검토하여 개별 설정 -담보 설정금액 有 => 회수가능성이 불확실한 경우 담보 미설정 부분 100% 설정 -담보 설정금액 無 => 회수가능성이 불확실한 경우 100% 설정

※ 연결대상회사 매출채권 충당금 설정 제외

(4) 당 보고기간말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	6월 이하	6월 초과 1년 이하	1년 초과 3년 이하	3년 초과	계
금액	5,523,874	-	-	-	5,523,874
구성비율	100%	0.0%	0.0%	0.0%	100%

라. 재고자산 현황 등

(1) 재고자산의 사업부문별 보유현황

(단위 : 백만원)

사업부문	계정과목	제76기 3분기	제75기	제74기	비고
반도체	상 품	3,489	3,401	2,602	-
	제 품	3,912,946	3,838,715	1,279,290	-
	재 공 품	8,542,947	9,094,152	5,812,302	-
	원 재 료	1,619,732	1,817,376	1,031,293	-
	저 장 품	757,239	785,825	715,302	-
	미 착 품	111,542	125,238	109,298	-
	합 계	14,947,895	15,664,707	8,950,087	-
총자산대비 재고자산 구성비율(%) [재고자산합계÷기말자산총계*100]		14.6%	15.1%	9.3%	-
재고자산회전율{회수} [연환산 매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}]		2.1회	2.4회	3.2회	-

※ 한국채택국제회계기준에 따라 연결기준으로 작성되었습니다.

(2) 재고자산의 실사내역

실사내역	실사 일자	입회자	비고
제품	2023-01-01	삼일회계법인	
FAB재공, B/E재공, MODULE재공,외주업체			
원부자재			

제품	2022-01-01	삼일회계법인	-
FAB재공, B/E재공, MODULE재공, 외주업체			-
원부자재			-
제품	2021-01-01	삼일회계법인	-
FAB재공, B/E재공, MODULE재공, 외주업체			-
원부자재			-

(3) 장기체화재고 등 내역

재고자산의 시가가 취득원가보다 하락한 경우에는 저가법을 사용하여 재고자산의 재무상태표가액을 결정하고 있으며, 2023년 3분기말 현재 재고자산에 대한 평가 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

계정과목	취득원가	보유금액	평가충당금	당기말잔액	비고
상 품	3,672	3,672	(183)	3,489	-
제 품	5,142,176	5,142,176	(1,229,230)	3,912,946	-
재 공 품	10,034,958	10,034,958	(1,492,011)	8,542,947	-
원 재 료	1,726,984	1,726,984	(107,252)	1,619,732	-
저 장 품	837,281	837,281	(80,042)	757,239	-
미 착 품	111,542	111,542	-	111,542	-
합 계	17,856,613	17,856,613	(2,908,718)	14,947,895	

※ 한국채택국제회계기준에 따라 연결기준으로 작성되었습니다.

마. 공정가치

공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다.

- 수준 1: 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격
- 수준 2: 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한 투입변수
- 수준 3: 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수

공정가치 서열체계를 포함한 금융자산과 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

① 당분기말

(단위: 백만원)					
구 분	장부금액	수준 1	수준 2	수준 3	합 계
공정가치로 측정되는 금융자산:					
단기금융상품	222,500	-	-	222,500	222,500
단기투자자산	893,670	-	893,670	-	893,670

매출채권(*1)	332,432	-	332,432	-	332,432
장기투자자산	5,485,715	-	-	5,485,715	5,485,715
기타금융자산	237,504	-	237,504	-	237,504
소 계	7,171,821	-	1,463,606	5,708,215	7,171,821
공정가치로 측정되지 않는 금융자산:					
현금및현금성자산(*2)	7,122,306	-	-	-	-
단기금융상품(*2)	292,846	-	-	-	-
매출채권(*2)	5,182,865	-	-	-	-
기타수취채권(*2)	851,839	-	-	-	-
기타금융자산(*2)	706	-	-	-	-
소 계	13,450,562	-	-	-	-
금융자산 합계	20,622,383	-	1,463,606	5,708,215	7,171,821
공정가치로 측정되는 금융부채:					
기타금융부채	637,174	-	637,174	-	637,174
소 계	637,174	-	637,174	-	637,174
공정가치로 측정되지 않는 금융부채:					
매입채무(*2)	1,916,761	-	-	-	-
미지급금(*2)	6,102,978	-	-	-	-
기타지급채무(*2)	1,352,420	-	-	-	-
차입금	31,558,615	-	30,357,466	-	30,357,466
리스부채(*2)	3,023,818	-	-	-	-
기타금융부채(*2)	4,600	-	-	-	-
소 계	43,959,192	-	30,357,466	-	30,357,466
금융부채 합계	44,596,366	-	30,994,640	-	30,994,640

(*1) 연결회사는 특정 거래처에 대한 일부 매출채권을 양도하고 위험과 보상의 대부분을 이전하여 매출채권을 양도일에 연결재무제표에서 제거하고 매출채권처분손익을 인식하고 있습니다.

(*2) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치를 측정하지 않은금융자산과 금융부채에 대한 공정가치는 포함하고 있지 않습니다.

② 전기말

(단위: 백만원)					
구 분	장부금액	수준 1	수준 2	수준 3	합 계
공정가치로 측정되는 금융자산:					
단기금융상품	222,500	-	-	222,500	222,500
단기투자자산	1,016,360	-	1,016,360	-	1,016,360
매출채권(*1)	207,072	-	207,072	-	207,072
장기투자자산	5,733,544	-	-	5,733,544	5,733,544
기타금융자산	115,017	-	115,017	-	115,017
소 계	7,294,493	-	1,338,449	5,956,044	7,294,493
공정가치로 측정되지 않는 금융자산:					
현금및현금성자산(*2)	4,977,007	-	-	-	-
단기금융상품(*2)	193,125	-	-	-	-

매출채권(*2)	4,978,982	-	-	-	-
기타수취채권(*2)	626,679	-	-	-	-
기타금융자산(*2)	695	-	-	-	-
소 계	10,776,488	-	-	-	-
금융자산 합계	18,070,981	-	1,338,449	5,956,044	7,294,493
공정가치로 측정되지 않는 금융부채:					
매입채무(*2)	2,186,230	-	-	-	-
미지급금(*2)	8,403,994	-	-	-	-
기타지급채무(*2)	1,415,197	-	-	-	-
차입금	22,994,604	-	21,809,209	-	21,809,209
리스부채(*2)	1,797,081	-	-	-	-
기타금융부채(*2)	4,876	-	-	-	-
금융부채 합계	36,801,982	-	21,809,209	-	21,809,209

(*1) 연결회사는 특정 거래처에 대한 일부 매출채권을 양도하고 위험과 보상의 대부분을 이전하여 매출채권을 양도일에 연결재무제표에서 제거하고 매출채권처분손익을 인식하고 있습니다.

(*2) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치에 해당하여 공정가치를 측정하지 않은금융자산과 금융부채에 대한 공정가치는 포함하고 있지 않습니다.

③ 가치평가기법

수준 2 및 수준 3의 공정가치 측정을 위해 사용된 평가기법은 전기말과 동일합니다.

④ 당분기 중 수준 1, 수준 2 및 수준 3간의 대체는 없으며, 수준 3 공정가치 측정으로 분류되는 금융자산의 당분기 중 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)						
구 분	기 초	취 득	처 분	평 가	환율변동	분기말
단기금융상품	222,500	-	-	-	-	222,500
장기투자자산	5,733,544	30,149	(3,101)	(741)	(274,136)	5,485,715

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.

V. 회계감사인의 감사의견 등

1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항
제76기 3분기 (당기)	삼정 회계법인	-	(연결재무제표) 연결회사의 인텔 NAND사업 인수에 대한 사업결합 회계처리를 잠정금액으로 2021년 연결재무제표에 보고하였으며, 2022년 중 취득일에 인식된 잠정금액을 소급하여 조정함 비교표시된 2022년 9월 30일로 종료되는 3개월 및 9개월 보고기간의 요약 반기연결포괄손익계산서와 6개월 보고기간의 요약 분기연결포괄손익계산서와 9개월 보고기간의 요약 분기연결자본변동표, 요약 분기연결현금흐름표는 동 조정사항이 반영되어 재작성됨	해당사항 없음
제75기 (전기)	삼일 회계법인	적정	(연결재무제표) 연결회사는 전기 중 인텔 NAND사업 인수 관련 자산과 부채의 공정가치 평가를 완료할 수 없었으므로 평가액을 잠정치로 보고하였으며, 당기 중 재측정한 공정가치 결과를 반영하여 비교표시된 전기 연결재무제표를 재작성함	가. (별도·연결재무제표) 장기투자자산에 포함된 KIOXIA Holdings Corporation 투자관련 금융자산의 공정가치 평가 나. (별도·연결재무제표) 기계장치의 감가상각개시시점에 대한 적정성 검토 다. (연결재무제표) 현금창출단위의 손상평가 라. (별도재무제표) 종속기업, 관계기업 및 공동기업투자에 포함된 SK hynix NAND Product Solution Corp. 및 SK hynix Semiconductor (Dalian) Co., Ltd. 주식 회수가능액 검토
제74기 (전전기)	삼일 회계법인	적정	해당사항 없음	(별도·연결재무제표) 가. 장기투자자산에 포함된 KIOXIA Holdings Corporation 투자관련 금융자산의 공정가치 평가 나. 기계장치의 감가상각개시시점에 대한 적정성 검토

※ 감사의견은 별도·연결 재무제표에 대한 감사의견입니다.

나. 회계감사인과의 감사용역계약 체결현황

(단위 :백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역		실제수행내역	
			보수	시간	보수	시간
제76기 3분기 (당기)	삼정 회계법인	분반기검토 별도재무제표감사 연결재무제표감사 내부회계제도 감사	2,800	28,000	1,670	16,700

제75기 (전기)	삼일 회계법인	분반기검토 별도재무제표감사 연결재무제표감사 내부회계제도 감사	3,200	27,800	3,200	27,120
제74기 (전전기)	삼일 회계법인	분반기검토 별도재무제표감사 연결재무제표감사 내부회계제도 감사	2,975	26,500	2,975	26,249

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 :백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고
제76기 3분기 (당기)	2023.07.26	전락물자 관리 체계 고도화	2023.07.26~2023.12.2 9	712	삼정회계법인
	2023.07.17	국제거래에 대한 세무 자료 제출 용역	2023.07.17~2023.12.3 1	272	삼정회계법인
	2023.04.01	준법경영체계 인증지원 자문	2023.04.01~2023.06.1 5	134	삼정회계법인
	2023.03.29	외주가공 용역 이전가격 자문	2023.03.29~2023.12.3 1	25	삼정회계법인
	2023.01.31	법인세 및 지방소득세 세무조정업무 용역계약서	2023.01.31~2023.04.3 0	45	삼일회계법인
	2023.01.03	사채발행 업무 용역	2023.01.03~2023.01.3 1	200	삼일회계법인
제75기 (전기)	2022.12.19	TCFD 기준 기후변화 시나리오 및 재무영향 분석 고도화	2022.12.19~2023.05.1 8	145	삼일회계법인
	2022.10.31	세무 자문 용역 계약	2022.10.31~2023.03.3 1	100	삼일회계법인
	2022.09.30	사채수탁 용역 계약	2022.09.30~2023.03.3 1	10	삼일회계법인
	2022.09.30	경정청구 및 조세불복업무 용역	2022.09.30~2024.09.2 4	(주1)	삼일회계법인
	2022.09.01	사채관리계약이행상황 보고 관련 확인서 작성	2022.09.01~2023.03.3 1	10	삼일회계법인
	2022.03.02	2022년 지방세 세무조사 관련 대응	2022.03.02~최종확정 시	65	삼일회계법인
제74기 (전전기)	2021.12.10	법인세 세무조정 업무 용역계약서	2021.08.10~2022.03.3 1	40	삼일회계법인
	2021.09.17	Intel NAND 사업부 인수에 따른 Tax PPA 검토 및 거래세 신고 자문	2021.07.15~2021.08.3 1	200	삼일회계법인
	2021.09.03	사채관리계약이행상황 보고 관련 감사인 확인서 작성	2021.09.03~2022.04.3 0	9	삼일회계법인
	2021.04.30	해외투자법인 설립 관련 검토 용역	2021.05.03~2021.06.0 7	60	삼일회계법인

주1) 환급금 비례 성공 보수

라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용
1	2023년 03월 08일	회사측: 감사위원회 위원 전원 (사외이사 윤태화, 하영구, 신창환, 한애라) 감사인측: 삼일회계법인 (업무수행이사 외 3명)	화상회의	1. 기말 감사 주요 사항 2. 핵심 감사 사항 3. 연간 감사일정과 Communication Agenda, 투입시간 현황 4. 그 밖의 Communication 사항 5. 내부회계관리제도 운영평가 결과보고
2	2023년 05월 10일	회사측: 감사위원회 위원 전원 (사외이사 윤태화, 하영구, 한애라, 김정원) 감사인측: 삼정회계법인 (업무수행이사 외 2명)	화상회의	1. 1분기 주요 검토 사항 2. 연간 감사일정 및 감사투입계획 3. 연간 감사 계획 4. 기타사항
3	2023년 08월 09일	회사측: 감사위원회 위원 전원 (사외이사 윤태화, 하영구, 한애라, 김정원) 감사인측: 삼정회계법인 (업무수행이사 외 2명)	대면회의	1. 2분기 검토 주요사항 2. 연간감사 계획 업데이트 3. 내부회계관리제도 진행경과 4. 기타사항

[조정협의회의내용 및 재무제표 불일치정보]

- 해당사항 없음

마. 회계 감사인의 변경

(1) 변경 사유

당사는 2014년부터 2019년까지 연속 6개 사업연도에 대하여 삼정회계법인을 감사인으로 선임하였습니다. 이에 따라, 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제11조 제2항 및 시행령 제15조에 적용 대상이 되어 2020년부터 주기적 감사인 지정제의 대상이 되었으며, 증권선물 위원회로부터 지정받은 삼일회계법인을 2020년부터 2022년까지 연속 3개 사업연도의 외부 감사인으로 선임하였습니다. 지정감사 기간 종료로 2023년 신규 감사인 선임이 필요하여, 당사는 삼정회계법인을 2023년부터 2025년까지 연속 3개 사업연도의 외부감사인으로 선임 하였습니다.

(2) 감사위원회의 의결

당사는 감사업무의 수행능력 및 국내외 관련 법규에 대한 전문성 등을 종합적으로 고려하여 2022년 9월 26일 제9차 감사위원회에서 2023년부터 2025년까지 (제76기~제78기) 사업연 도에 대한 외부감사인으로 삼정회계법인을 선임하였습니다.

2. 내부통제에 관한 사항

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.

2. 감사제도에 관한 사항

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.

3. 주주총회 등에 관한 사항

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.

VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 등에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2023년 09월 30일)

(단위 : 주, %)

성명	관계	주식의 종류	소유주식수 및 지분율				비고
			기초		기말		
			주식수	지분율	주식수	지분율	
SK스퀘어(주)	최대주주	의결권 있는 주식	146,100,000	20.07	146,100,000	20.07	-
박정호	특수관계인	의결권 있는 주식	18,023	0.00	22,114	0.00	자사주 상여금(Stock Grant 지급)
곽노정	특수관계인	의결권 있는 주식	2,211	0.00	4,016	0.00	자사주 상여금(Stock Grant 지급)
하영구	특수관계인	의결권 있는 주식	920	0.00	1,586	0.00	자사주 상여금(Stock Grant 지급)
송호근	특수관계인	의결권 있는 주식	785	0.00	1,326	0.00	자사주 상여금(Stock Grant 지급)
윤대화	특수관계인	의결권 있는 주식	785	0.00	1,326	0.00	자사주 상여금(Stock Grant 지급)
조현재	특수관계인	의결권 있는 주식	650	0.00	1,066	0.00	자사주 상여금(Stock Grant 지급)
한애라	특수관계인	의결권 있는 주식	650	0.00	1,066	0.00	자사주 상여금(Stock Grant 지급)
김정원	특수관계인	의결권 있는 주식	0	0.00	416	0.00	자사주 상여금(Stock Grant 지급)
정덕균	특수관계인	의결권 있는 주식	0	0.00	416	0.00	자사주 상여금(Stock Grant 지급)
노종원	특수관계인	의결권 있는 주식	1,000	0.00	0	0.00	임원 사임
신창환	특수관계인	의결권 있는 주식	650	0.00	0	0.00	임기 만료
계		의결권 있는 주식	146,125,674	20.07	146,133,332	20.07	-
		기타	-	-	-	-	-

* 의결권 있는 주식은 보통주임

** 기초는 2023년 1월 1일 기준이며, 기말은 2023년 9월 30일 기준임

2. 최대주주의 주요 경력 및 개요

가. 최대주주 개요 및 지분율(2023년 9월 30일 기준)

당사의 최대주주는 SK스퀘어 주식회사이며, 그 소유주식수는 146,100,000주(지분율 20.07%)로서 특수관계인을 포함하여 146,133,332주(지분율 20.07%)입니다.

나. 최대주주의 기본 정보

(1) 최대주주의 대표자 (2023년 09월 30일 기준)

성명	직위	상근여부	출생년도
박성하	대표이사/사장	상근	1965년

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조합원)	업무집행자 (업무집행조합원)	최대주주 (최대출자자)

		성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
SK스퀘어 주식회사	148,416	박성하	0.00	-	-	SK(주)	30.06
		-	-	-	-	-	-

(3) 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역

변동일	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)	
	성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
2021년 11월 29일	박정호	0.00	-	-	에스케이(주)	30.56
2022년 02월 25일	박정호	0.00	-	-	에스케이(주)	30.57
2022년 07월 22일	박정호	0.00	-	-	에스케이(주)	30.03
2023년 02월 17일	박정호	0.00	-	-	에스케이(주)	30.05
2023년 04월 05일	박성하	0.00	-	-	에스케이(주)	30.06

* SK스퀘어(주)는 SK텔레콤으로부터 인적분할하여 2021년 11월29일 신규 상장하였습니다.

(4) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

당사의 최대주주인 SK스퀘어 주식회사의 제3기 3분기 재무현황입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	
법인 또는 단체의 명칭	SK스퀘어 주식회사
자산총계	18,468,594
부채총계	1,860,662
자본총계	16,607,932
매출액	-75,758
영업이익	-1,934,286
당기순이익	-780,362

* SK스퀘어(주)의 제3기 3분기 연결재무제표기준

(5) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

당사 최대주주인 SK스퀘어 주식회사는 2021년 11월 SK텔레콤으로부터 인적분할을 통해 설립 되었으며, 동월 유가증권시장에 재상장되었습니다.이후 2022년 1월 SK그룹 계열사로 편입되었습니다.

보고서 작성 기준일 현재, 영위하고 있는 주요 사업은 (1) 투자사업, (2) 커머스사업, (3) 플랫폼사업, (4) 모빌리티 사업, (5) 기타사업(온라인 음악, 디지털 광고 등) 입니다

(6) 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정거래 여부

- 해당사항 없음

3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

가. 최대주주 개요

(1) 최대주주 개요 (2023년 09월 30일 기준)당사의 최대주주는 에스케이 주식회사이며 기본 정보 등은 아래와 같습니다.

구분	내용	비고
설립일	1991년 4월 13일	-
주소	서울특별시 종로구 종로 26	-
전화번호	02-2121-5114	-
홈페이지	https://www.sk-inc.com/	-
연결실체 내 종속기업수	694개사	국내 206개사, 해외 488개사

(2) 회사의 주권상장(또는 등록·지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장 (또는 등록·지정)여부	주권상장 (또는 등록·지정)일자	종목코드	특례상장 등 여부	특례상장 등 적용법규
유가증권시장	2009년 11월 11일	034730	-	-

(3) 국내 상장 종속회사수

작성기준일 현재 연결실체 내의 상장회사는 아래와 같습니다.

상장여부	회사명	법인등록번호
상장사(14)	SK(주)	110111-0769583
	SK이노베이션(주)	110111-3710385
	SK텔레콤(주)	110111-0371346
	SK스퀘어(주)	110111-8077821
	SK네트웍스(주)	130111-0005199
	SKC(주)	130111-0001585
	SK위탁관리부동산투자회사(주)	110111-7815446
	SK시그넷(주)	205811-0018148
	SK렌터카(주)	110111-0577233
	SK바이오팜(주)	110111-4570720
	(주)드림어스컴퍼니	110111-1637383
	인크로스(주)	110111-3734955
	SK아이이테크놀로지(주)	110111-7064217
	SK오션플랜트(주) (舊, 삼강M&T(주))	191311-0003485

1) SK(주), SK이노베이션(주), SK텔레콤(주), SK스퀘어(주), SK네트웍스(주), SKC(주), SK위탁관리부동산투자회사(주), SK렌터카(주), SK바이오팜(주), SK아이이테크놀로지(주), SK오션플랜트(주) (舊, 삼강M&T(주)) 이상 11개사는 유가 증권시장에 상장되어 있으며, (주)드림어스컴퍼니, 인크로스(주) 이상 2개사는 코스닥 시장, SK시그넷(주) (舊, (주)시그넷이브이)는 코넥스 시장에 상장되어 있음 (2023.09.30 기준)

2) SK오션플랜트(주)(舊, 삼강M&T(주))는 2023년 4월 19일자로 코스닥 시장에서 유가증권시장으로 주식을 이전
상장하였음

나. 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

(1) 최대주주의 대표자

(2023년 9월 30일 기준)

성명	직위	상근여부	출생년도
최태원	대표이사 회장	상근	1960년
장동현	대표이사 부회장	상근	1963년

* 2022년 3월 29일 제31차 정기주주총회 및 같은 날 개최된 제3차 이사회를 통해 최태원 이사는 사내이사 및
대표이사로 재선임되었음

** 2023년 3월 29일 제32차 정기주주총회 및 같은 날 개최된 제3차 이사회를 통해 장동현 이사는 사내이사 및
대표이사로 재선임되었음

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수 (명)	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)	
		성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
SK(주)	196,861	최태원	17.73	-	-	최태원	17.73
		장동현	0.01	-	-	-	-

* 대표이사와 최대주주는 동일인이며, 지분율은 보통주 기준으로 기재하였음

** 2023년 4월 5일 신탁계약으로 취득한 자사주 951,000주를 이익소각하여 총발행주식수가 감소함에 따라 최
대주주의 지분율이 17.73%로 증가함

(3) 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역

변동일	대표이사 (대표조합원)		업무집행자 (업무집행조합원)		최대주주 (최대출자자)	
	성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
2021년 12월 09일	최태원	17.50	-	-	최태원	17.50
2023년 04월 05일	최태원	17.73	-	-	최태원	17.73

* 공시대상기간 이전의 변동현황은 기재를 생략하였음

** 2023년 4월 5일 신탁계약으로 취득한 자사주 951,000주를 이익소각하여 총발행주식수가 감소함에 따라 최
대주주의 지분율이 17.73%로 증가함

※ 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율 변동내역 상세

(기준일 : 2023년 9월 30일)

(단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고
-----	-------	-------	-----	------	-----

2021년 12월 09일	최태원	12,975,472	17.50	-	(舊)SK머티리얼즈 주식회사 합병 시 총발행주식수 증가에 따른 지분율 하락
2023년 04월 05일	최태원	12,975,472	17.73	-	신탁계약으로 취득한 자기주식 소각으 로 총발행주식수 감소에 따른 지분율 증가

* 상기 지분율은 보통주 기준임

(4) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분	
법인 또는 단체의 명칭	SK주식회사
자산총계	207,676,347
부채총계	128,364,598
자본총계	79,311,749
매출액	98,584,040
영업이익	4,631,674
당기순이익	1,172,106

* SK(주)의 제33기 3분기 연결 재무제표 기준

1) 요약 연결 재무정보

(단위 : 백만원)

구 분	제33기 3분기 (2023.09.30)
[유동자산]	68,881,728
현금및현금성자산	23,187,990
재고자산	16,845,996
기타의유동자산	28,847,742
[비유동자산]	138,794,619
관계기업및공동기업투자	26,497,579
유형자산	69,361,374
무형자산및영업권	18,741,581
기타의비유동자산	24,194,085
자산총계	207,676,347
[유동부채]	65,581,930
[비유동부채]	62,782,668
부채총계	128,364,598
[지배기업소유주지분]	22,672,858
자본금	16,143

기타불입자본	6,911,158
이익잉여금	14,817,781
기타자본구성요소	927,776
[비지배지분]	56,638,891
자본총계	79,311,749
부채와자본총계	207,676,347
연결에 포함된 회사 수	694개사
	제33기 3분기 (2023.01.01~2023.09.30)
I. 매출액	98,584,040
II. 영업이익(손실)	4,631,674
III. 법인세비용차감전계속영업이익(손실)	910,113
IV. 계속영업당기연결순이익(손실)	203,725
V. 당기순이익(손실)	1,172,106
지배기업소유주지분순이익(손실)	307,873
비지배지분순이익(손실)	864,233
VI. 지배기업 소유주 지분에 대한 주당이익	
보통주기본주당이익(손실)	5,460 원
우선주기본주당이익(손실)	5,510 원
보통주희석주당이익(손실)	5,341 원
보통주기본주당계속영업이익(손실)	206 원
우선주기본주당계속영업이익(손실)	206 원
보통주희석주당계속영업이익(손실)	93 원

2) 요약 별도 재무정보

(단위 : 백만원)

구 분	제33기 3분기 (2023.09.30)
[유동자산]	1,719,782
현금및현금성자산	236,199
재고자산	230
기타유동자산	1,483,353
[비유동자산]	27,442,537
종속·관계·공동기업 투자	22,490,165
유형자산	593,172
사용권자산	120,091
무형자산	2,146,712
기타비유동자산	2,092,397

자산총계	29,162,319
[유동부채]	5,337,961
[비유동부채]	7,373,937
부채총계	12,711,898
자본금	16,143
기타불입자본	3,256,868
이익잉여금	12,947,139
기타자본구성요소	230,271
자본총계	16,450,421
부채와자본총계	29,162,319
종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	원가법
	제33기 3분기 (2023.01.01~2023.09.30)
I. 매출액(영업수익)	3,197,574
II. 영업이익	1,422,558
III. 법인세비용차감전계속영업이익	791,700
IV. 당기순이익	818,924
V. 주당이익	
보통주기본주당이익	14,524 원
우선주기본주당이익	14,574 원
보통주희석주당이익	14,397 원

(5) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

1) 사업의 내용

SK주식회사는 지속적인 사업 포트폴리오 혁신과 미래 성장동력을 발굴 및 육성하는 '투자 부문'(舊, 지주부문)과 Digital 기술을 기반으로 종합 IT 서비스 사업 등을 영위하는 '사업부문'으로 구분되어 있습니다. SK주식회사는 SK그룹의 지주회사로서, 2023년 3분기말 현재 연결대상 종속회사는 SK이노베이션, SK텔레콤, SK스퀘어, SK네트웍스 등 총 694개사입니다.

2) 회사가 영위하는 목적사업(정관)

목 적 사 업

1. 자회사의 주식 또는 지분을 취득·소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배·경영지도·정리·육성하는 지주사업
2. 브랜드, 상표권 등의 지적재산권의 관리 및 라이선스업
3. 건설업과 부동산 매매 및 임대업
- 3의 2. 주택건설사업 및 국내외 부동산의 개발, 투자, 자문, 운용업
- 3의 3. 마리나항만시설의 설치, 운영, 관리 및 이에 수반되는 부대사업
4. 국내외 자원의 탐사, 채취, 개발사업
5. 수출입대행업, 무역대리업을 포함한 수출입사업
6. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업
7. 신기술사업 관련 투자, 관리, 운영사업 및 창업지원사업
8. 운송, 보관, 하역 및 이와 관련된 정보, 서비스를 제공하는 물류관련 사업
9. 의약 및 생명과학 관련 사업
10. 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발·판매 및 설비·전산시스템의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업
11. 정보처리 내지 정보통신기술을 이용한 정보의 조사용역, 생산, 판매, 유통, 컨설팅, 교육, 수출사업 및 이에 필요한 소재, 기기설비의 제공
12. 정보통신사업 및 뉴미디어사업과 관련된 연구, 기술개발, 수출, 수입, 제조, 유통사업
13. 환경관련 사업
14. 회사가 보유하고 있는 지식·정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업
15. 전기통신업
16. 컴퓨터프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업
17. 정보서비스업
18. 소프트웨어 개발 및 공급업
19. 콘텐츠 제작, 유통, 이용 및 관련 부대사업
20. 서적, 잡지, 기타 인쇄물 출판업
21. 전기장비, 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업
22. 전기, 가스공급업 등 에너지사업
23. 전기공사업, 정보통신공사업 및 소방시설공사업 등 소방시설업
24. 토목건축공사업, 산업·환경설비공사업 등 종합시공업
25. 통신판매업, 전자상거래업, 도·소매업 및 상품중개업을 포함한 각종 판매 유통사업
26. 등록번호판발급대행, 검사대행, 지정정비사업 및 자동차관리사업
27. 전자지급결제대행업 등 전자금융업
28. 보험대리점 영업
29. 시설대여업
30. 자동차대여사업
31. 여론조사업
32. 연구개발업
33. 경영컨설팅업
34. 광고대행업을 포함한 광고업
35. 교육서비스업
36. 경비 및 보안시스템 서비스업
37. 검사, 측정 및 분석업
38. 기계·장비 제조업 및 임대업
39. 기타 위 각호에 부대되는 생산·판매 및 유통·컨설팅·교육·수출입 등 제반 사업 일체

3) 주요 자회사가 영위하는 주요 목적사업

자회사	주요 목적사업
SK이노베이션(주)	지주사업 및 석유/ 화학/ 배터리 관련 사업
SK텔레콤(주)	정보통신사업
SK스퀘어(주)	지주사업
SK네트웍스(주)	상사, 에너지 및 정보통신 유통, 렌터카 및 가전렌탈 사업
SKC(주)	지주사업 및 2차전지 소재사업, 화학사업, 반도체 소재 사업
SK에코플랜트(주)	환경사업, 에너지사업, 솔루션사업
SK E&S(주)	가스사 소유 및 복합화력발전 사업
SK바이오팜(주)	신약개발사업
SK Pharmteco, Inc.	의약품 중간체 제조업
SK실트론(주)	전자산업용 규소박판 제조업
SK스페셜티(주) (舊, SK머티리얼즈(주))	특수가스 제조 및 판매
에스케이머티리얼즈 에어플러스(주)	산업가스 제조 및 판매
에스케이트리켄(주)	프리커서 제조 및 판매
에스케이레조낙(주) (舊, 에스케이쇼와덴코(주))	특수가스 제조 및 판매
에스케이머티리얼즈 그룹포틴(주)	배터리 소재 제조 및 판매업
에스케이위탁관리 부동산투자회사(주)	부동산임대업
SK시그넷(주) (舊, (주)시그넷이브이)	전기자동차 충전시스템 설치 및 관련장비 제조, 판매업
SK China Company, Ltd.	컨설팅 및 투자
SK임업(주)	조림사업, 조경사업, 복합임업사업
(주)휘찬	휴양콘도 운영업
에스케이파워텍(주) (舊, (주)에스파워테크닉스)	반도체 제조업

▷ 최대주주에 대한 자세한 사항은 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시된 SK(주)의 사업(분·반기)보고서를 참조하시기 바랍니다.

다. 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정 거래

- 해당사항 없습니다.

라. 최대주주의 최대주주 관련 사항

성명	학력	직위	기간	경력사항
최태원	고려대학교 물리학과 졸업 (1983)	대표이사 회장	2016.03 ~ 현재	SK주식회사 대표이사 회장

	미국 시카고대학교 대학원 경제학 석사 및 박사 과정 수료 (1989)	(등기임원)	2015.08 ~ 2016.03	SK주식회사 회장
			2022.02 ~ 현재	SK텔레콤 주식회사 회장
			2012.02 ~ 현재	SK하이닉스 주식회사 회장
			2007.07 ~ 현재	SK이노베이션 주식회사 회장
			1997.12 ~ 2015.07	(舊) SK주식회사 회장

* 상기 최대주주는 2016년 3월 18일 제25기 정기주주총회 및 제3차 이사회를 통해 SK주식회사 등기이사 및 대표이사로 선임되었으며 2019년 3월 27일 제28기 정기주주총회 및 제4차 이사회, 2022년 3월 29일 제31기 정기주주총회 및 제3차 이사회에서 등기이사 및 대표이사로 재선임 되었음

4. 최대주주 변동내역

(기준일 : 2023년 09월 30일)

(단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고
2019년 03월 22일	SK텔레콤(주)	146,101,132	20.07	특수관계자 제외 (박성욱 사내이사)	-
2020년 10월 22일	SK텔레콤(주)	146,102,132	20.07	장내매수 (박정호 사내이사)	-
2021년 05월 03일	SK텔레콤(주)	146,103,332	20.07	자사주 상여금 (사외이사 6인)	-
2021년 06월 11일	SK텔레콤(주)	146,104,332	20.07	장내매수 (오종훈 사내이사)	-
2021년 08월 20일	SK텔레콤(주)	146,104,782	20.07	장내매수 (오종훈 사내이사)	-
2021년 11월 02일	SK스퀘어(주)	146,104,782	20.07	최대주주 변경	(주1)
2022년 02월 25일	SK스퀘어(주)	146,131,909	20.07	자사주 상여금 (박정호 사내이사, 이석희 사내이사)	-
2022년 03월 30일	SK스퀘어(주)	146,121,434	20.07	특수관계자 제외(이석희 사내이사, 오종훈 사내이사) 특수관계자 추가(곽노정 사내이사, 노종원 사내이사)	-
2022년 05월 02일	SK스퀘어(주)	146,124,674	20.07	자사주 상여금 (사외이사 6인)	-
2022년 05월 03일	SK스퀘어(주)	146,125,674	20.07	장내매수 (곽노정 사내이사)	-
2023년 02월 24일	SK스퀘어(주)	146,132,237	20.07	자사주 상여금 (박정호 사내이사, 곽노정 사내이사, 노종원 사내이사)	-
2023년 03월 28일	SK스퀘어(주)	146,130,570	20.07	특수관계자 제외(노종원 사내이사)	-
2023년 03월 29일	SK스퀘어(주)	146,129,920	20.07	특수관계자 제외(신창환 사외이사)	-
2023년 08월 04일	SK스퀘어(주)	146,133,332	20.07	자사주 상여금 (사외이사 7인)	(주2)

※ 최근 5년간의 최대주주 변동내역 기준

(주1) 상기 에스케이스퀘어(주)의 보유내역은 2021년 11월 2일부로 에스케이텔레콤(주)의 회사 인적분할에 따라 신설된 분할신설법인인 에스케이스퀘어(주)가 기존 에스케이텔레콤(주)가 보유하던 회사의 지분 전량을 승계한 146,100,000주와 특수관계인의 보유주식 4,782주를 합산한 것임

(주2) 상기 에스케이스퀘어(주)의 보유내역은 2021년 11월 2일부로 에스케이텔레콤(주)의 회사 인적분할에 따라 신설된 분할신설법인인 에스케이스퀘어(주)가 기존 에스케이텔레콤(주)가 보유하던 회사의 지분 전량을 승계한 146,100,000주와 특수관계인의 보유주식 33,332주를 합산한 것임

5. 주식의 분포

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.

6. 주가 및 주식 거래실적

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2023년 09월 30일)

(단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원 여부	상근 여부	담당 업무	주요경력	소유주식수		최대주주와의 관계	재직기간	임기 만료일
								의결권 있는 주식	의결권 없는 주식			
박정호	남	1963년 05월	대표이사 부회장	사내이사	상근	대표이사 미래전략위원회 위원	조지워싱턴대 대학원 석사 SK주 C&C 대표이사/사장 SK텔레콤 대표이사/사장 SK텔레콤 부회장 SK스퀘어 부회장 (現) SK하이닉스 대표이사/부회장 (現)	22,114	-	계열회사 임원 (SK스퀘어)	7년 7개월 종임('21.03.30)	-
곽노정	남	1965년 11월	대표이사 사장	사내이사	상근	대표이사 지속경영위원회 위원	고려대학교 대학원 박사 SK하이닉스 미래기술연구원 상무 SK하이닉스 청주 FAB담당 전무 SK하이닉스 제조/기술 담당 부사장 SK하이닉스 안전개발제조총괄 사장 한국 반도체산업협회 13대 회장 (現) SK하이닉스 대표이사/사장 (現)	4,016	-	-	1년 7개월 선임('22.03.30)	-
박성하	남	1965년 10월	이사	기타비상 무이사	비상근	기타비상무이사 인사·보상위원회 위원	MIT 경영학 석사 SK주 Portfolio Mgmt. 부문장 SUPEX추구협의회 전략지원팀장 SK C&C 대표이사/사장 SK스퀘어 대표이사/사장 (現)	-	-	계열회사 임원 (SK스퀘어)	7개월 선임('23.03.29)	-
송호근	남	1956년 01월	이사	사외이사	비상근	사외이사 사외이사후보추천위원회 위 원 지속경영위원회 위원 인사·보상위원회 위원	미국 하버드대 대학원 박사 서울대 사회과학대 교수 서울대 석좌교수 포항공단 인문사회학부 석좌교수 유민재단 이사 (現) 한림대학교 석좌교수 (現)	1,326	-	-	5년 7개월 종임('21.03.30)	-
조현재	남	1958년 01월	이사	사외이사	비상근	사외이사 사외이사후보추천위원회 위 원 지속경영위원회 위원 인사·보상위원회 위원 미래전략위원회 위원	한국외국어대 학사 MBN 대표이사 한국법무보호복지공단 비상임이사 광주대 초빙교수	1,066	-	-	5년 7개월 종임('21.03.30)	-

윤대화	남	1960년 10월	이사	사외이사	비상근	사외이사 감사위원회 위원 인사·보상위원회 위원	연세대학교 대학원 박사 안권회계법인 공인회계사 국무총리 조세심판원 비상임심판관 한국세무학회 회장 한국회계정보학회 회장 한국고용정보원 감사 한국자산관리공사 감사자문위원회 위원장 한국거래소 코스닥시장 공시위원회 위원장 국세청 대표시민감사관 (現) 학교법인 포항공과대학교 감사 (現) 가천대학교 경영학과 교수, 경영대학원장 (現)	1,326	-	-	5년 7개월 종임('21.03.30)	-
하영구	남	1953년 11월	이사	사외이사	비상근	사외이사 이사회 의장 감사위원회 위원 사외이사후보추천위원회 위 원 인사·보상위원회 위원 미래전략위원회 위원	미국 노스웨스턴대 석사 전국은행연합회장 금융개혁협의회 위원 블랙스톤어드바이저스코리아 대표이사 (現) SK하이닉스 이사회 의장 (現)	1,586	-	-	4년 7개월 종임('22.03.30)	-
한애라	여	1972년 02월	이사	사외이사	비상근	사외이사 감사위원회 위원 지속경영위원회 위원 인사·보상위원회 위원	하버드대학교 대학원 석사 대법원 재판연구관 김연장 법률사무소 성균관대 법학전문대학원 교수 (現)	1,066	-	-	3년 7개월 종임('23.03.29)	-
정덕균	남	1958년 08월	이사	사외이사	비상근	사외이사 인사·보상위원회 위원 미래전략위원회 위원	UC 버클리대 전기컴퓨터공학 박사 서울대 전기정보공학부 교수 서울대 반도체공동연구소장 서울대 전기정보공학부 석좌교수 (現)	416	-	-	7개월 선임('23.03.29)	-
김정원	여	1968년 11월	이사	사외이사	비상근	사외이사 감사위원회 위원 인사·보상위원회 위원	시카고대 경영학 석사 한국씨티은행 재무기획그룹 부행장 美 Citi은행 Treasury GPO/Managing Director 김연장 법률사무소 고문 (現)	416	-	-	7개월 선임('23.03.29)	-

- ※ 상기 재직기간은 최초 선임일 기준이며, 일자는 최근 선임일임
- ※ 임기 만료일은 취임 후 개최되는 제3차 정기주주총회 종료시임
- ※ 2023년 3월 29일 제75기 정기주주총회를 통해 정덕균, 김정원 사외이사 및 박성하 기타비상무이사 신규 선임, 한애라 사외이사 겸 감사위원회위원이 재선임됨
- ※ 노종원 사내이사는 2023년 3월 28일자로 사임함

나. 등기임원의 겸직 현황

[기준일: 2023년 9월 30일]

겸직임원		겸직회사		비 고
성 명	직 위	회 사 명	직 위	
박정호	대표이사 부회장	SK스퀘어	부회장	-
		SK China Company Limited	이사	-
		SK South East Asia Investment Pte. Ltd.	이사	-
		SK Square Americas, Inc	이사	-
		SK hynix NAND Product Solutions Corp. (해외법인)	의장	

곽노정	대표이사 사장	SK hynix Semiconductor (China) Ltd. (해외법인)	대표이사	-
		SK hynix NAND Product Solutions Corp. (해외법인)	이사	-
박성하	기타비상무이사	SK스퀘어	대표이사	-
하영구	사외이사	블랙스톤어드바이저스코리아(유)	대표이사	-
송호근	사외이사	(주)DN오토모티브	사외이사	-
윤태화	사외이사	(주)이노션	사외이사	-
한애라	사외이사	CJ(주)	사외이사	-
정덕균	사외이사	효성중공업(주)	사외이사	-

다. 미등기 임원 현황

(가) 미등기 임원

[기준일: 2023년 9월 30일]

직위 (상근여부)	등기임원 여부	성명	성별	출생년월	담당 업무	주요 경력	최대주주와의 관계	재직기간
회장 (상근)	미등기	최태원	남	1960.12	회장	회장	계열회사 임원 (SK(주))	
사장 (상근)	미등기	김동섭	남	1963.01	대외협력 담당	대외협력총괄		
담당 (상근)	미등기	강선국	남	1969.02	GSM 담당임원	GSM		
담당 (상근)	미등기	강욱성	남	1969.01	GSM 담당임원	GSM		57개월
담당 (상근)	미등기	강유종	남	1970.12	GSM 담당임원	미래기술&성장 담당임원		
담당 (상근)	미등기	강진수	남	1967.07	CEO직속 담당임원	GSM 담당임원		
담당 (상근)	미등기	고은정	여	1979.01	미래기술연구원 담당임원	미래기술연구원		
담당 (상근)	미등기	권기창	남	1969.11	NAND개발 담당임원	NAND개발		
담당 (상근)	미등기	권오혁	남	1970.03	대외협력 담당임원	SK주식회사		9개월
담당 (상근)	미등기	권재순	남	1969.12	제조/기술 담당임원	bswidud qusehd		
담당 (상근)	미등기	김규현	남	1971.07	GSM 담당임원	GSM		
담당 (상근)	미등기	김기현	남	1968.10	GSM 담당임원	CIS Business 담당임원		
담당 (상근)	미등기	김능구	남	1967.03	BE구매 담당	CEO직속 담당임원		45개월
담당 (상근)	미등기	김동규	남	1972.08	미래전략 담당임원	재무 담당임원		
담당 (상근)	미등기	김만섭	남	1970.11	제조/기술 담당임원	제조/기술		

담당 (상근)	미등기	김상덕	남	1968.02	Global QRA 담당임원	미래기술연구원 담당임원		
담당 (상근)	미등기	김상호	남	1967.12	기업문화 담당임원	CEO직속 담당임원		33개월
담당 (상근)	미등기	김상훈	남	1973.04	Global QRA 담당임원	품질보증		
담당 (상근)	미등기	김석	남	1970.11	GSM 담당임원	GSM		
담당 (상근)	미등기	김선순	남	1970.06	미래기술연구원 담당임원	DRAM개발 담당임원		
담당 (상근)	미등기	김성한	남	1968.12	FE구매 담당	구매 담당		
담당 (상근)	미등기	김영식	남	1967.12	제조/기술 담당	제조/기술 담당임원		
담당 (상근)	미등기	김우현	남	1967.01	재무 담당	SK브로드밴드		21개월
담당 (상근)	미등기	김운용	남	1967.09	미래기술연구원 담당임원	개발제조총괄		
담당 (상근)	미등기	김윤욱	남	1969.01	대외협력 담당임원	SK이노베이션		45개월
담당 (상근)	미등기	김점수	남	1972.01	NAND개발 담당임원	미래기술연구원 담당임원		
담당 (상근)	미등기	김정배	남	1971.01	제조/기술 담당임원	제조/기술		23개월
담당 (상근)	미등기	김정수	남	1969.07	DRAM개발 담당임원	미래기술연구원 담당임원		
담당 (상근)	미등기	김정태	남	1969.07	GSM 담당임원	GSM		
담당 (상근)	미등기	김종환	남	1972.09	DRAM개발 담당	미래기술연구원 담당임원		
담당 (상근)	미등기	김주선	남	1966.06	GSM 담당	GSM 담당임원		
담당 (상근)	미등기	김준한	남	1972.06	CEO직속 담당임원	사업 담당임원		57개월
담당 (상근)	미등기	김진혁	남	1975.09	CEO직속 담당임원	미래전략 담당		57개월
담당 (상근)	미등기	김천성	남	1973.05	Solution개발 담당임원	Solution개발		
담당 (상근)	미등기	김춘환	남	1967.04	제조/기술 담당임원	미래기술연구원		
담당 (상근)	미등기	김태훈	남	1970.02	미래기술연구원 담당임원	미래기술연구원		
담당 (상근)	미등기	김현규	남	1969.09	NAND개발 담당임원	NAND개발		
담당 (상근)	미등기	김현중	남	1970.11	P&T 담당임원	P&T		
담당 (상근)	미등기	김형수	남	1965.02	제조/기술 담당임원	안전개발제조 담당임원		

담당 (상근)	미등기	김형수	남	1974.06	DRAM개발 담당임원	기업문화 담당임원		
담당 (상근)	미등기	김형환	남	1970.03	기업문화 담당임원	미래기술연구원 담당임원		
담당 (상근)	미등기	나명희	여	1970.08	미래기술연구원 담당임원	IMEC		31개월
담당 (상근)	미등기	도승용	남	1973.02	DT 담당	DT 담당임원		34개월
담당 (상근)	미등기	도창호	남	1970.01	DT 담당임원	안전개발제조 담당임원		
담당 (상근)	미등기	류병훈	남	1980.10	미래전략 담당	SK스퀘어		9개월
담당 (상근)	미등기	류성수	남	1972.03	GSM 담당임원	GSM		
담당 (상근)	미등기	마금선	남	1968.11	대외협력 담당임원	대외협력총괄		
담당 (상근)	미등기	문기일	남	1969.10	P&T 담당임원	안전개발제조 담당임원		
담당 (상근)	미등기	문순기	남	1971.03	P&T 담당임원	P&T		
담당 (상근)	미등기	문승훈	남	1969.08	제조/기술 담당임원	제조/기술		
담당 (상근)	미등기	문양기	남	1971.12	Solution개발 담당임원	Solution개발		
담당 (상근)	미등기	문지웅	남	1966.10	대외협력 담당임원	CEO직속 담당임원		45개월
담당 (상근)	미등기	민경현	남	1966.01	대외협력 담당임원	미래전략 담당임원		
담당 (상근)	미등기	민원배	남	1971.12	Global QRA 담당임원	품질보증		29개월
담당 (상근)	미등기	박경	남	1968.07	CEO직속 담당임원	Solution개발 담당임원		
담당 (상근)	미등기	박명수	남	1970.04	GSM 담당임원	GSM		
담당 (상근)	미등기	박명재	남	1980.07	DRAM개발 담당임원	DRAM개발		
담당 (상근)	미등기	박문필	남	1973.05	DRAM개발 담당임원	DRAM개발		
담당 (상근)	미등기	박민철	남	1971.10	미래전략 담당임원	미래전략		52개월
담당 (상근)	미등기	박병채	남	1970.03	P&T 담당임원	재무 담당임원		
담당 (상근)	미등기	박상범	남	1969.10	제조/기술 담당임원	제조/기술		
담당 (상근)	미등기	박성계	남	1967.06	미래기술연구원 담당임원	NAND개발 담당임원		
담당 (상근)	미등기	박성조	남	1970.09	NAND개발 담당임원	NAND개발		

담당 (상근)	미등기	박성환	남	1968.11	재무 담당임원	재무		
담당 (상근)	미등기	박수만	남	1972.05	CEO직속 담당임원	SUPLEX추구협의회		33개월
담당 (상근)	미등기	박용근	남	1969.07	대외협력 담당임원	대외협력총괄		
담당 (상근)	미등기	박준식	남	1969.11	CEO직속 담당임원	안전개발제조 담당임원		
담당 (상근)	미등기	박진규	남	1968.06	P&T 담당임원	P&T		
담당 (상근)	미등기	박찬동	남	1968.03	GSM 담당임원	GSM		
담당 (상근)	미등기	박찬하	남	1969.01	미래기술연구원 담당임원	미래기술연구원		
담당 (상근)	미등기	박창현	남	1968.09	미래기술연구원 담당임원	DRAM개발 담당임원		
담당 (상근)	미등기	박철규	남	1966.06	Global QRA 담당임원	DRAM개발 담당임원		
담당 (상근)	미등기	박철범	남	1971.10	대외협력 담당임원	CEO직속 담당임원		
담당 (상근)	미등기	박태진	남	1969.10	제조/기술 담당임원	안전개발제조 담당임원		
담당 (상근)	미등기	박현	남	1969.06	대외협력 담당임원	대외협력총괄		
담당 (상근)	미등기	박훈	남	1976.01	대외협력 담당임원	산업통상자원부		26개월
담당 (상근)	미등기	배극인	남	1969.08	대외협력 담당임원	동아일보		15개월
담당 (상근)	미등기	백현철	남	1965.03	미래기술연구원 담당임원	제조/기술 담당임원		
담당 (상근)	미등기	서재욱	남	1973.08	미래기술연구원 담당임원	미래기술연구원		
담당 (상근)	미등기	설광수	남	1970.01	미래기술연구원 담당임원	제조/기술 담당임원		59개월
담당 (상근)	미등기	손동휘	남	1970.06	재무 담당임원	재무		
담당 (상근)	미등기	손상수	남	1968.10	CEO직속 담당임원	대외협력 담당임원		
담당 (상근)	미등기	손상호	남	1972.03	제조/기술 담당임원	제조/기술		
담당 (상근)	미등기	손석우	남	1968.01	제조/기술 담당임원	제조/기술		
담당 (상근)	미등기	손수용	남	1970.03	DRAM개발 담당임원	DRAM개발		
담당 (상근)	미등기	손승훈	남	1974.01	미래기술연구원 담당임원	미래기술연구원		
담당 (상근)	미등기	송준호	남	1970.05	Global QRA 담당임원	Intel		43개월

담당 (상근)	미등기	송창록	남	1969.01	CIS개발 담당	CIS Business 담당		
담당 (상근)	미등기	송창석	남	1971.07	GSM 담당임원	GSM		
담당 (상근)	미등기	송치화	남	1969.01	NAND개발 담당임원	제조/기술 담당임원		
담당 (상근)	미등기	송현중	남	1965.11	기업문화 담당임원	CEO직속 담당임원		
담당 (상근)	미등기	신상규	남	1970.11	기업문화 담당	SK텔레콤		21개월
담당 (상근)	미등기	신승아	여	1977.12	미래기술연구원 담당임원	DRAM개발		
담당 (상근)	미등기	신정호	남	1968.10	제조/기술 담당임원	제조/기술		
담당 (상근)	미등기	신현수	남	1971.03	재무 담당임원	경영지원		33개월
담당 (상근)	미등기	심규찬	남	1971.01	미래기술연구원 담당임원	미래기술연구원		
담당 (상근)	미등기	안대웅	남	1974.09	DT 담당임원	DT		
담당 (상근)	미등기	안정열	남	1972.11	미래기술연구원 담당임원	미래기술연구원		
담당 (상근)	미등기	안현	남	1967.06	Solution개발 담당	미래기술&성장 담당임원		
담당 (상근)	미등기	안현준	남	1971.12	P&T 담당임원	P&T		
담당 (상근)	미등기	양형모	남	1975.04	재무 담당임원	SUPLEX추구협의회		33개월
담당 (상근)	미등기	여동준	남	1969.05	GSM 담당임원	GSM		
담당 (상근)	미등기	오동연	남	1974.09	미래기술연구원 담당임원	미래기술연구원		
담당 (상근)	미등기	오정환	남	1969.01	GSM 담당임원	GSM		
담당 (상근)	미등기	오종훈	남	1964.08	CEO직속 담당임원	사업 담당임원		
담당 (상근)	미등기	오태경	남	1974.05	미래기술연구원 담당임원	DRAM개발		
담당 (상근)	미등기	오훈상	남	1969.07	CIS개발 담당임원	CIS Business 담당임원		
담당 (상근)	미등기	윤경렬	남	1971.03	미래기술연구원 담당임원	DRAM개발		50개월
담당 (상근)	미등기	윤재연	남	1976.10	GSM 담당임원	GSM		
담당 (상근)	미등기	윤홍성	남	1971.01	FE구매 담당임원	구매 담당임원		
담당 (상근)	미등기	이강민	남	1968.12	제조/기술 담당임원	제조/기술		

담당 (상근)	미등기	이강욱	남	1968.03	P&T 담당임원	안전개발제조 담당임원		
담당 (상근)	미등기	이광욱	남	1970.09	CEO직속 담당임원	제조/기술 담당임원		
담당 (상근)	미등기	이규제	남	1972.11	P&T 담당임원	안전개발제조 담당임원		
담당 (상근)	미등기	이기화	남	1968.12	P&T 담당임원	P&T		
담당 (상근)	미등기	이동호	남	1968.06	미래전략 담당임원	CEO직속 담당임원		21개월
담당 (상근)	미등기	이문환	남	1967.09	FE구매 담당임원	미래기술연구원 담당임원		
담당 (상근)	미등기	이민형	남	1968.10	제조/기술 담당임원	제조/기술		
담당 (상근)	미등기	이방실	여	1975.02	대외협력 담당임원	CEO직속 담당임원		33개월
담당 (상근)	미등기	이병기	남	1972.02	미래기술연구원 담당임원	기업문화 담당임원		
담당 (상근)	미등기	이병찬	남	1965.03	FE구매 담당임원	구매 담당임원		58개월
담당 (상근)	미등기	이상권	남	1974.12	DRAM개발 담당임원	DRAM개발		
담당 (상근)	미등기	이상락	남	1968.01	GSM 담당임원	GSM		
담당 (상근)	미등기	이상엽	남	1969.03	BE구매 담당임원	구매 담당임원		
담당 (상근)	미등기	이상영	남	1969.01	GSM 담당임원	GSM		
담당 (상근)	미등기	이상철	남	1965.02	DT 담당임원	기업문화 담당임원		
담당 (상근)	미등기	이상환	남	1971.02	DRAM개발 담당임원	DRAM개발		
담당 (상근)	미등기	이성재	남	1969.07	Solution개발 담당임원	GSM 담당임원		
담당 (상근)	미등기	이성훈	남	1972.02	미래기술연구원 담당임원	미래기술연구원		
담당 (상근)	미등기	이승필	남	1970.03	NAND개발 담당임원	NAND개발		45개월
담당 (상근)	미등기	이웅선	남	1969.02	P&T 담당임원	P&T		
담당 (상근)	미등기	이인노	남	1971.04	제조/기술 담당임원	미래기술연구원		
담당 (상근)	미등기	이일우	남	1971.07	기업문화 담당임원	기업문화		
담당 (상근)	미등기	이재서	남	1982.06	재무 담당임원	미래전략 담당임원		57개월
담당 (상근)	미등기	이재준	남	1978.05	대외협력 담당임원	대외협력총괄		

담당 (상근)	미등기	이정석	남	1968.02	제조/기술 담당임원	제조/기술		
담당 (상근)	미등기	이창수	남	1974.12	DT 담당임원	DT		
담당 (상근)	미등기	이태학	남	1973.05	Solution개발 담당임원	Solution개발		
담당 (상근)	미등기	이현민	남	1973.10	미래기술연구원 담당임원	미래기술연구원		
담당 (상근)	미등기	이호석	남	1969.09	제조/기술 담당임원	NAND개발 담당임원		
담당 (상근)	미등기	이홍덕	남	1970.01	BE구매 담당임원	구매 담당임원		
담당 (상근)	미등기	임성혁	남	1970.08	제조/기술 담당임원	제조/기술		
담당 (상근)	미등기	임형도	남	1968.06	CEO직속 담당임원	SK텔레콤		9개월
담당 (상근)	미등기	장승호	남	1970.11	Global QRA 담당임원	Solution개발 담당임원		
담당 (상근)	미등기	장지은	여	1974.06	DRAM개발 담당임원	DRAM개발		
담당 (상근)	미등기	전원철	남	1968.03	DRAM개발 담당임원	DRAM개발		
담당 (상근)	미등기	전유남	남	1974.01	NAND개발 담당임원	NAND개발		
담당 (상근)	미등기	전종민	남	1970.05	기업문화 담당임원	CEO직속 담당임원		
담당 (상근)	미등기	전준현	남	1966.05	Solution개발 담당임원	DRAM개발 담당임원		
담당 (상근)	미등기	정상규	남	1967.12	Solution개발 담당임원	NAND개발 담당임원		
담당 (상근)	미등기	정성용	남	1972.12	미래기술연구원 담당임원	미래기술연구원		
담당 (상근)	미등기	정우표	남	1967.05	NAND개발 담당임원	Intel		51개월
담당 (상근)	미등기	정유인	남	1969.11	DT 담당임원	DT		
담당 (상근)	미등기	정윤식	남	1975.01	재무 담당임원	SUPLEX추구협의회		21개월
담당 (상근)	미등기	정은태	남	1969.07	제조/기술 담당임원	CEO직속 담당임원		
담당 (상근)	미등기	정인철	남	1972.01	DRAM개발 담당임원	DRAM개발		
담당 (상근)	미등기	정제모	남	1976.09	기업문화 담당임원	기업문화		
담당 (상근)	미등기	정진수	남	1970.10	제조/기술 담당임원	품질보증 담당임원		
담당 (상근)	미등기	정창교	남	1972.02	DRAM개발 담당임원	DRAM개발		

담당 (상근)	미등기	정철우	남	1965.04	CIS개발 담당임원	안전개발제조 담당임원		
담당 (상근)	미등기	정태우	남	1965.05	제조/기술 담당임원	미래기술연구원 담당임원		
담당 (상근)	미등기	정해강	남	1979.12	DRAM개발 담당임원	DRAM개발		
담당 (상근)	미등기	정희삼	남	1978.02	CIS개발 담당임원	CIS Business 담당임원		
담당 (상근)	미등기	조명관	남	1966.05	Global QRA 담당임원	NAND개발 담당임원		
담당 (상근)	미등기	조민상	남	1968.09	P&T 담당임원	P&T		
담당 (상근)	미등기	조영만	남	1968.09	DRAM개발 담당임원	미래기술연구원 담당임원		
담당 (상근)	미등기	조주현	남	1972.04	CIS개발 담당임원	CIS Business 담당임원		23개월
담당 (상근)	미등기	조주환	남	1968.01	DRAM개발 담당임원	DRAM개발		
담당 (상근)	미등기	조호진	남	1968.11	DRAM개발 담당임원	미래기술연구원 담당임원		
담당 (상근)	미등기	조훈	남	1972.08	Solution개발 담당임원	Solution개발		45개월
담당 (상근)	미등기	주재욱	남	1971.10	제조/기술 담당임원	제조/기술		
담당 (상근)	미등기	지운혁	남	1976.08	Solution개발 담당임원	Solution개발		
담당 (상근)	미등기	진보건	남	1974.12	기업문화 담당임원	SK텔레콤		21개월
담당 (상근)	미등기	진성곤	남	1968.07	제조/기술 담당임원	미래기술연구원 담당임원		
담당 (상근)	미등기	진일섭	남	1971.05	미래기술연구원 담당임원	DRAM개발 담당임원		
담당 (상근)	미등기	차상엽	남	1967.02	재무 담당임원	안전개발제조 담당임원		48개월
담당 (상근)	미등기	차선용	남	1967.08	미래기술연구원 담당	DRAM개발 담당		
담당 (상근)	미등기	천영일	남	1966.10	미래기술연구원 담당임원	NAND개발 담당임원		
담당 (상근)	미등기	최광문	남	1968.01	제조/기술 담당임원	안전개발제조 담당임원		
담당 (상근)	미등기	최명섭	남	1972.07	제조/기술 담당임원	제조/기술		
담당 (상근)	미등기	최상훈	남	1972.02	기업문화 담당임원	SK하이텍		9개월
담당 (상근)	미등기	최영현	남	1971.06	제조/기술 담당임원	제조/기술		
담당 (상근)	미등기	최용수	남	1969.02	GSM 담당임원	품질보증		

담당 (상근)	미등기	최우진	남	1971.11	P&T 담당임원	개발제조총괄 담당임원		
담당 (상근)	미등기	최정달	남	1964.07	NAND개발 담당	NAND개발 담당임원		
담당 (상근)	미등기	최정산	남	1967.01	Global QRA 담당	Global QRA 담당임원		
담당 (상근)	미등기	최준	남	1968.07	CEO직속 담당임원	GSM 담당임원		21개월
담당 (상근)	미등기	최준기	남	1968.02	제조/기술 담당임원	제조/기술		
담당 (상근)	미등기	최창언	남	1972.01	Solution개발 담당임원	NAND개발 담당임원		53개월
담당 (상근)	미등기	최홍석	남	1968.11	NAND개발 담당임원	NAND개발		
담당 (상근)	미등기	한상신	남	1971.07	P&T 담당임원	P&T		
담당 (상근)	미등기	한은석	남	1973.06	Corporate Development 담 당	SK윌더스		2개월
담당 (상근)	미등기	한영수	남	1969.11	NAND개발 담당임원	NAND개발		
담당 (상근)	미등기	허황	남	1973.01	NAND개발 담당임원	NAND개발		
담당 (상근)	미등기	홍상후	남	1963.02	P&T 담당	NAND개발 담당임원		
담당 (상근)	미등기	홍성관	남	1976.10	Solution개발 담당임원	Solution개발		
담당 (상근)	미등기	홍진희	남	1972.12	P&T 담당임원	P&T		

(나) 미등기 임원의 변동

최근 보고일 이후 제출일 현재까지 변동된 미등기임원의 현황은 다음과 같습니다.

구분	직위 (상근여부)	등기임원 여부	성명	성별	출생년월	담당 업무	주요 경력	비고
전입	담당 (상근)	미등기	한은석	남	1973.06	Corporate Development 담당	SK윌더스	관계사 전입

라. 직원 등 현황

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.

마. 미등기임원 보수 현황

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.

2. 임원의 보수 등

가. 임원의 보수

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.

나. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.

IX. 계열회사 등에 관한 사항

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.

X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등

가. 가지급금 및 대여금 내역

(기준일: 2023년 9월 30일)

(단위: USD 백만)

대상자의 이름	관계	종류	시작일	만기일	목적	대여 금액	기말 잔액	이자율
SK hynix Semiconductor(China) Ltd.	해외법인	장기대여	2020-04-16	2024-10-15	운영자금	600	600	3M Sofr+0.75%
SK hynix Semiconductor(China) Ltd.	해외법인	장기대여	2020-08-18	2025-02-17	운영자금	600	600	3M Sofr+0.75%
SK hynix Semiconductor(China) Ltd.	해외법인	장기대여	2020-10-20	2025-04-19	운영자금	550	550	3M Sofr+0.75%
SK hynix Semiconductor(China) Ltd.	해외법인	장기대여	2021-04-20	2025-10-19	운영자금	200	200	3M Sofr+0.75%
SK hynix Semiconductor(Dalian) Co., Ltd.	해외법인	장기대여	2022-01-19	2025-07-12	운영자금	1,000	1,000	3M Sofr+1.30%
SK hynix Semiconductor(Dalian) Co., Ltd.	해외법인	장기대여	2022-02-09	2025-07-12	운영자금	1,000	1,000	3M Sofr+1.30%
SK hynix Semiconductor(Dalian) Co., Ltd.	해외법인	장기대여	2022-02-15	2025-07-12	운영자금	1,000	1,000	3M Sofr+1.30%
SK hynix Semiconductor(Dalian) Co., Ltd.	해외법인	장기대여	2022-02-23	2025-07-12	운영자금	1,000	1,000	3M Sofr+1.30%
SK hynix Semiconductor(Dalian) Co., Ltd.	해외법인	장기대여	2022-03-03	2025-07-12	운영자금	229	229	3M Sofr+1.30%
SK hynix NAND Product Solutions Corp.	해외법인	장기대여	2022-08-11	2025-08-11	운영자금	300	300	3M Sofr+0.45%
SK hynix NAND Product Solutions Corp.	해외법인	단기대여	2023-02-15	2024-02-15	운영자금	300	300	3M Sofr+1.10%
SK hynix NAND Product Solutions Corp.	해외법인	단기대여	2023-03-15	2024-02-15	운영자금	200	200	3M Sofr+1.10%
SK hynix NAND Product Solutions Corp.	해외법인	장기대여	2023-05-31	2025-05-31	운영자금	400	400	3M Sofr+0.45%
SK hynix NAND Product Solutions Corp.	해외법인	장기대여	2023-07-10	2025-05-31	운영자금	400	400	3M Sofr+0.45%
SK hynix NAND Product Solutions Corp.	해외법인	장기대여	2023-09-14	2025-09-14	운영자금	350	350	3M Sofr+0.45%

※ 회사의 대여에 대하여 종속기업이 회사에 제공한 담보는 없습니다.

※ 상법 제542조의9에 따라 건별 대여 금액이 직전 사업연도 매출액의 100분의 1을 초과하거나, 당사 이사회 내부 규정을 충족하는 경우 이사회 또는 감사위원회 의결을 통해 결정됩니다.

나. 채무보증 현황

이해관계자와의 채무보증 현황은 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항' 중 '2. 우발부채 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등

가. 자산양수도 내역

(기준일: 2023년 9월 30일)

(단위 : 백만원)

거래 상대방	관계	거래 대상물	거래일자	거래금액	거래종류	목적	처분손익
HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.	해외법인	기계장치류	2023년 1월	629	매각	생산 효율화	(146)
HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.	해외법인	기계장치류	2023년 2월	1,610	매각	생산 효율화	433

HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.	해외법인	기계장치류	2023년 4월	128	매각	생산 효율화	128
SK hynix Semiconductor (Chongqing) Ltd.	해외법인	기계장치류	2023년 4월	2,889	매각	생산 효율화	(160)
HITECH Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.	해외법인	기계장치류	2023년 5월	297	매각	생산 효율화	202
SK hynix Semiconductor (Chongqing) Ltd.	해외법인	기계장치류	2023년 5월	882	매각	생산 효율화	79
SK hynix Semiconductor(China) Ltd.	해외법인	기계장치류	2023년 8월	1,772	매각	생산 효율화	1,772
SK hynix Semiconductor (Chongqing) Ltd.	해외법인	기계장치류	2023년 9월	1,387	매각	생산 효율화	460
SK hynix Semiconductor(China) Ltd.	해외법인	기계장치류	2023년 9월	1,195	매각	생산 효율화	1,153
SK hynix Semiconductor(China) Ltd.	해외법인	기계장치류	2023년 1월	423	매입	생산 효율화	-
SK hynix Semiconductor(China) Ltd.	해외법인	기계장치류	2023년 3월	1,844	매입	생산 효율화	-
SK hynix Semiconductor (Chongqing) Ltd.	해외법인	기계장치류	2023년 3월	1,648	매입	생산 효율화	-
SK hynix Semiconductor (Chongqing) Ltd.	해외법인	기계장치류	2023년 5월	692	매입	생산 효율화	-

※ 본사 별도 기준입니다.

※ 법인간 매매금액 산정 기준 : 거래금액+ 부대비용

- 거래금액은 감정평가 및 시장가치를 고려하여 적절히 산정되었습니다.

※ 거래일자는 매각의 경우 매각일자, 매입의 경우 매입일자 기준입니다.

나. 부동산 매매 내역

(기준일: 2023년 9월 30일)

(단위 : 백만원)

성명 (법인명)	관계	거래일자	거래일자 기준	거래목적	거래금액	거래내용	비고
클린인더스트리얼위탁관리 부동산투자회사 주식회사	계열회사	2023년 9월	매각대금 입금일	자산의 효율성 제고 및 재무구조의 개선	1,120,315	(건물) 경기도 이천시 부발읍 아미리 712-7 외 189필지 23동, 35동, 43동, 49동 폐수처리 및 온도저감동 (토지) 경기도 이천시 부발읍 신하리 584-28 외 35필지, 46,144.00㎡ (부속설비) 건물 및 토지에 속하는 부속설비, 동산, 조형물, 구축물 일체	-

3. 대주주와의 영업거래

(기준일: 2023년 9월 30일)

(단위 : 백만원)

거래 상대방	관계	거래종류	거래기간	거래금액
SK hynix America Inc.	해외판매법인	매출·매입 등	2023.01.01~2023.09.30	7,797,231
SK hynix(Wuxi) Semiconductor Sales Ltd.	해외판매법인	매출·매입 등	2023.01.01~2023.09.30	5,124,041
SK hynix Semiconductor (China) Ltd.	해외생산법인	매출·매입 등	2023.01.01~2023.09.30	4,001,645

※ 상기 내역은 최근사업연도 별도 매출액의 5% 이상을 대상으로 하였습니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

- . 해당사항 없음

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용 진행 및 변경사항

가. 공시사항의 진행 · 변경사항

신고일자	보고서명	신고 내용	신고사항의 진행사항
2022.09.06	장래사업 · 경영 계획 (공정공시)	1. 제목 : 생산기반 확충을 위한 투자계획 2. 내용 : 2022년 10월부터 청주 테크노폴리스 산업단지 내 기존 확보된 부지에 M15의 확장 팍인 M15X(eXtension)를 건설할 계획임. 향후 5년에 걸쳐 공장 건설 및 생산 설비 구축에 총 15조원 규모를 투자할 계획임	진행중

2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건

① 북미지역 내 가격 담합 집단소송

2018년 4월 27일에 지배기업 및 지배기업의 종속기업인 SK hynix America Inc.를 상대로 주요 DRAM 업체들의 가격 담합에 대한 집단소송(피해대상기간: 2016년 6월1일부터 2018년 2월 1일까지)이 미국 캘리포니아 북부 연방지방법원에 제기되었습니다. 이후 유사한 집단소송들이 미국 캘리포니아 북부 연방지방법원 및 캐나다 브리티시컬럼비아 대법원, 퀘벡 지방법원, 온타리오 연방 및 지방법원에 제기되었습니다.

2020년 12월과 2021년 9월 미국 캘리포니아 북부 연방지방법원은 미국지역의 직접 및 간접 구매자 집단이 제기한 주요 소송에 대해 1심 최종 기각 결정을 내렸고, 원고 측은 항소를 통해 이러한 결정에 불복하였으나, 당분기말 현재 미국 직접 구매자 및 간접 구매자 집단 소송은 모두 1심 기각 결정을 유지하는 것으로 최종 종료되었습니다.

한편 2021년 6월 및 2021년 11월 캐나다 퀘벡 지방법원 및 온타리오 연방법원이 캐나다 지역의 구매자 집단이 제기한 소송에 대해 1심 최종 기각 결정을 내렸으며 항소심에서도 1심 기각 결정 유지 판결이 내려졌습니다. 퀘벡 지방법원 소송은 항소심 판결을 끝으로 최종 종료되었고, 온타리오 연방법원 소송은 당분기 말 현재 대법원 상고 절차가 진행 중입니다.

② 중국 반독점법 위반 조사

2018년 5월 중국 국가시장감독관리총국은 주요 DRAM 업체들의 중국 내 매출거래와 관련하여, 중국 반독점법 위반이 있었는지에 대한 조사를 개시하였으며, 동 조사가 현재 진행 중에 있습니다. 당분기말 현재 연결회사는 동 조사의 최종결과를 예측할 수 없습니다.

③ 소송 및 특허 클레임 등

당분기말 현재 연결회사는 상기 소송 외에 지적재산권 등과 관련하여 여러 분쟁에 대응하고 있으며, 과거 사건에 의한 현재의무이고 향후 자원의 유출가능성이 높으며 손실금액을 신뢰

성 있게 추정할 수 있는 경우 동 금액을 부채로 인식하고 있습니다.

나. 채무보증 현황

(1) 연결회사는 공동기업인 Hystars Semiconductor (Wuxi) Co., Ltd.를 위하여 Wuxi Xinfu Group Co., Ltd. 에게 RMB 701백만의 지급보증을 제공하고 있습니다.

(2) 회사는 종속기업인 SK hynix Nand Product Solutions Corp.에 건물 건설 보증 및 임대차 보증을 위하여 USD 169백만의 지급보증을 제공하고 있습니다.

3. 제재 등과 관련된 사항

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.

4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항

(1)당사는 2023년 10월 25일자 이사회에서 자기주식 처분을 결의하였으며, 처분예정기간 중 총 22,460주의 자기주식을 처분하였습니다. 주요 내용은 다음과 같습니다.

구분	내역
처분예정주식	보통주 22,279주
처분주식 총수	보통주 22,460주
1주당 처분가액	1주당 125,800원
처분예정기간	2023.11.03
처분목적	임직원에 대한 자기주식 상여 지급

※ 자세한 내용은 2023.11.08.에 공시된 "자기주식처분결과보고서"를 참고하시기 바랍니다.

상기 주요 사항을 반영하여, 제출일 현재 당사가 보유한 자기주식수는 총 39,863,716주입니다. 이는 2023년 4월 11일 당사가 발행한 교환사채의 교환대상 자기주식 20,126,911주를 포함하여 산정되었으며, 해당 교환대상 자기주식은 교환사채의 교환권 행사시점에 처분이 확정되며 현재 한국예탁결제원에 예탁되어 있습니다.

XII. 상세표

1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.

2. 계열회사 현황(상세)

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.

3. 타법인출자 현황(상세)

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에는 본 항목을 기재하지 아니하였습니다.

【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음

2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음